



msi[™]

XPower series

MS-7666 (v1.x) Mainboard

G52-76661X3

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of ATI Technologies, Inc.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.0	For PCB v1.x, Asia version	April 2010

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- ☐ Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <http://www.msi.com/index.php?func=service>
- ☐ Contact our technical staff at: <http://ocss.msi.com>

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. **DO NOT COVER THE OPENINGS.**
- Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
 - The power cord or plug is damaged.
 - Liquid has penetrated into the equipment.
 - The equipment has been exposed to moisture.
 - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
 - The equipment has dropped and damaged.
 - The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60° C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling special disposal.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...



Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda: Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rígor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat...

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electriche en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas pedesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne” nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektrických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói köteleessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkánév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

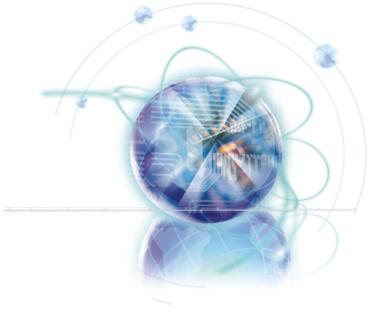
Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adegnerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

CONTENTS

Copyright Notice.....	ii
Trademarks	ii
Revision History.....	ii
Technical Support.....	ii
Safety Instructions.....	iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement.....	iv
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement	v
English.....	En-1
Mainboard Specifications	En-2
Quick Components Guide	En-4
CPU (Central Processing Unit)	En-5
Memory	En-9
Power Supply	En-12
Back Panel.....	En-14
Connectors.....	En-16
Button.....	En-21
Switch.....	En-23
Slots	En-25
LED Status Indicators (optional)	En-32
BIOS Setup	En-36
Software Information	En-48
한국어.....	Kr-1
메인보드 사양.....	Kr-2
빠른 부품 설명서.....	Kr-4
CPU (중앙 처리 장치).....	Kr-5
메모리	Kr-9
전원 공급 장치.....	Kr-12
후면 패널.....	Kr-14
커넥터	Kr-16
버튼	Kr-21
스위치	Kr-23
슬롯	Kr-25
LED 상태 표시기 (옵션).....	Kr-32
BIOS 설정	Kr-36
소프트웨어 정보.....	Kr-48
日本語.....	Jp-1
マザーボードの仕様.....	Jp-2

クイックコンポーネントガイド.....	Jp-4
CPUに関する注意事項.....	Jp-5
メモリ.....	Jp-9
電源.....	Jp-12
I/Oパネル.....	Jp-14
コネクタ.....	Jp-16
ボタン.....	Jp-21
スイッチ.....	Jp-23
スロット.....	Jp-25
状態表示LED (オプション).....	Jp-32
BIOSの設定.....	Jp-36
ソフトウェアの情報.....	Jp-48
繁體中文.....	Tc-1
主機板規格.....	Tc-2
快速零組件指南.....	Tc-4
CPU (中央處理器).....	Tc-5
記憶體.....	Tc-9
電源供應器.....	Tc-12
背板.....	Tc-14
接頭.....	Tc-16
按鈕.....	Tc-21
開關.....	Tc-23
插槽.....	Tc-25
LED 燈號說明 (選配).....	Tc-32
BIOS 設定.....	Tc-36
軟體訊息.....	Tc-48
簡体中文.....	Sc-1
主板规格.....	Sc-2
组件快速指南.....	Sc-4
CPU (中央处理器).....	Sc-5
内存.....	Sc-9
电源适配器.....	Sc-12
后置面板.....	Sc-14
接口.....	Sc-16
按钮.....	Sc-21
开关.....	Sc-23
插槽.....	Sc-25
LED 状态说明 (选配).....	Sc-32
BIOS 设置.....	Sc-36
软件信息.....	Sc-48



English

XPower Series

Asia version

Mainboard Specifications

Processor Support

- Intel® Bloomfield™ processor in the LGA1366 package
(For the latest information about CPU, please visit <http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2>)

QPI

- Up to 6.4 GT/s

Chipset

- North Bridge : Intel® X58 chipset
- South Bridge : Intel® ICH10R chipset

Memory Support

- 6 DDR3 DIMMs support DDR3 2133*(OC)/ 1800*(OC) /1600*(OC)/ 1333/ 1066 / 800 DRAM (24GB Max)
- Supports Dual-Channel/ Triple-Channel mode
*(For more information on compatible components, please visit <http://www.msi.com/index.php?func=testreport>)

LAN

- Supports Dual LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111DL

IEEE 1394

- 1 IEEE 1394 port by VIA® VT6315N

QuantumWave Audio Card

- Realtek® ALC889
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
- 7.1 Channel High Definition Audio Codec with jack sensing
- Supports 1x S/PDIF out header
- Supports Coaxial/Optical S/PDIF out ports on rear

SATA

- 6 SATA 3Gb/s (SATA1~6) ports by Intel® ICH10R
- 2 SATA 6Gb/s (SATA7~8) ports by Marvell® 88SE9128
- 1 ESATA port & 1 ESATA/ USB 2.0 combo port (back panel) by JMicron® JMB362
- Supports hot plug & asynchronous notification

USB 3.0

- 2 USB 3.0 ports by NEC® uPD720200F1

RAID

- SATA1~6 support Intel® Matrix Storage Technology (AHCI/ RAID 0/1/5/10) by Intel® ICH10R
- SATA7~8 ports support RAID 0/ 1 mode by Marvell® 88SE9128

Connectors

- Back panel
 - 1 PS/2 keyboard port
 - 1 PS/2 mouse port
 - 1 Clear CMOS button
 - 1 D-LED2 panel connector
 - 1 IEEE1394 port
 - 5 USB 2.0 ports
 - 1 ESATA port
 - 1 ESATA/ USB 2.0 Combo port
 - 2 LAN ports
 - 2 USB 3.0 ports
- On-Board
 - 2 USB 2.0 connectors
 - 1 IEEE1394 connector
 - 1 Chassis Intrusion connector
 - 1 TPM Module connector
 - 1 Reset button
 - 1 Power button
 - 1 GreenPower Genie connector (optional)
 - 1 Over-Voltage switch
 - 1 set voltage check point
 - 1 OC Genie button
 - 2 Base clock control buttons
 - 1 set Debug LED panel

Slots

- 6 PCI Express 2.0 x16 slots (PCI_E2 & PCI_E5 support up to PCIe x16 speed, PCI_E4 & PCI_E6 support up to PCIe x8 speed, PCI_E3 & PCI_E7 support up to PCIe x4 speed)
- 1 PCI Express 1.1 x1 slot

Form Factor

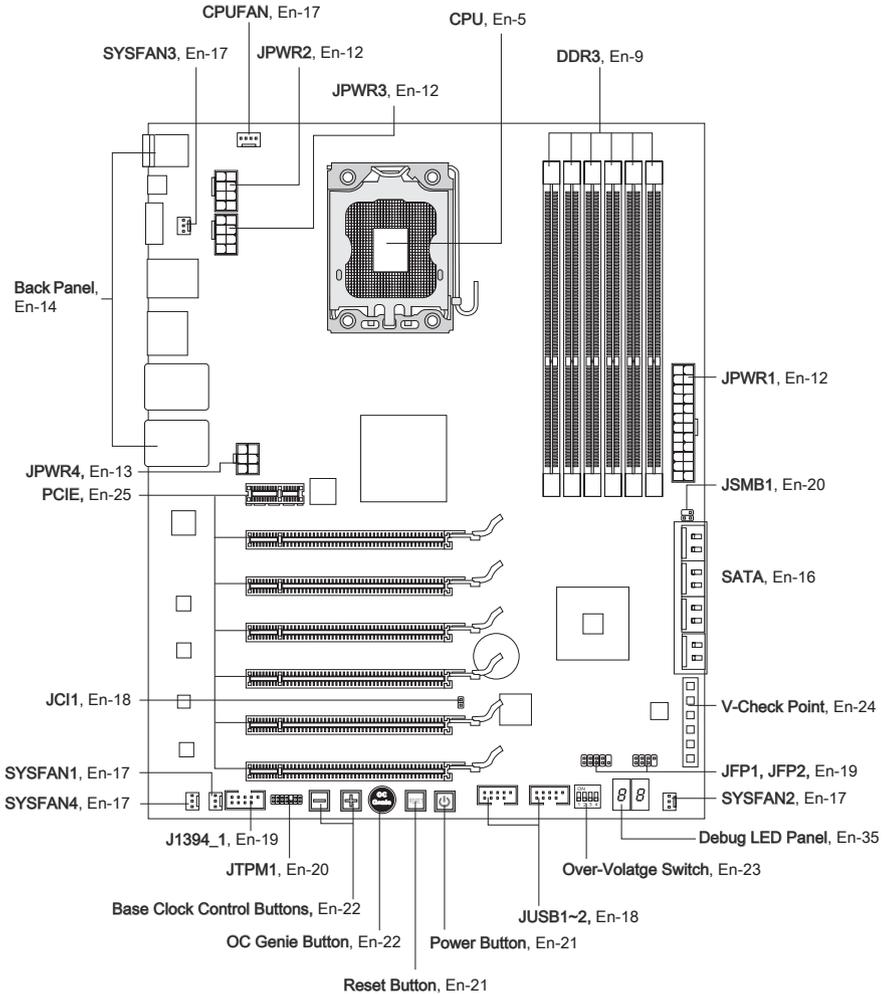
- ATX (24.4cm X 30.5 cm)

Mounting

- 9 mounting holes

* If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address <http://www.msi.com/index.php>

Quick Components Guide



CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer. For the latest information about CPU, please visit <http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2>

Important

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

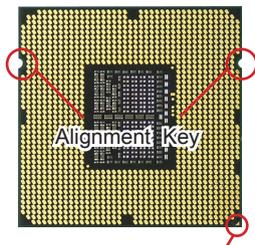
While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power supply's power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product specifications.

Introduction to LGA 1366 CPU

The pin-pad side of LGA 1366 CPU.



Yellow triangle is the Pin 1 indicator

The surface of LGA 1366 CPU. Remember to apply some thermal paste on it for better heat dispersion.



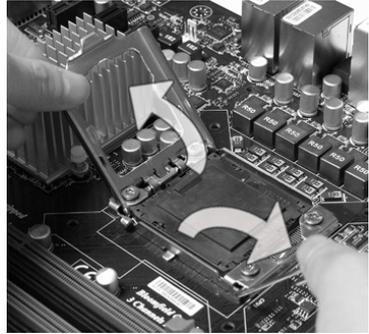
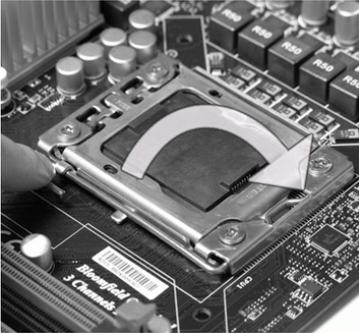
Yellow triangle is the Pin 1 indicator

CPU & Cooler Installation

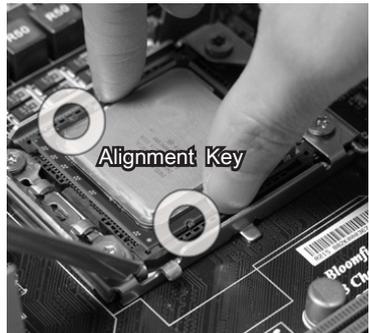
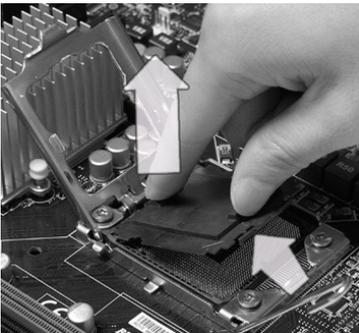
When you are installing the CPU, make sure the CPU has a cooler attached on the top to prevent overheating. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will cause the damage of your CPU & mainboard.

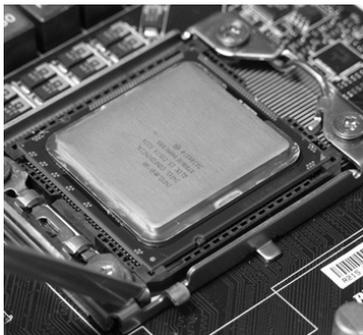
1. Open the load level.
2. Lift the load lever up and open the load plate.



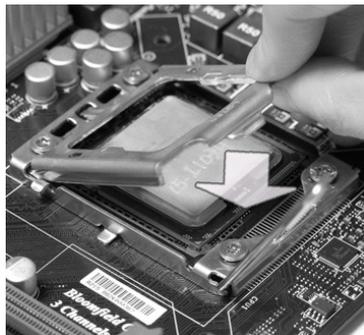
3. The CPU socket has a plastic cap on it to protect the contact from damage. Before you install CPU, always cover it to protect the socket pin. Remove the cap (as the arrow shows).
4. After confirming the CPU direction for correct mating, put down the CPU in the socket housing frame. Be sure to grasp on the edge of the CPU base. Note that the alignment keys are matched.



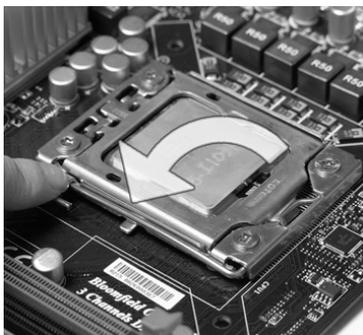
5. Visually inspect if the CPU is seated well into the socket. If not, take out the CPU with pure vertical motion and reinstall.



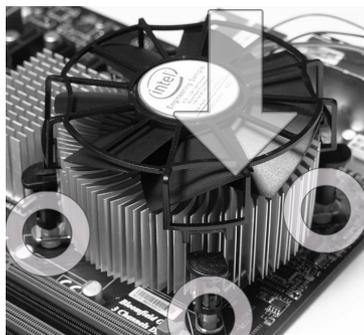
6. Cover the load plate onto the package.



7. Press down the load lever lightly onto the load plate, and then secure the lever with the hook under retention tab.



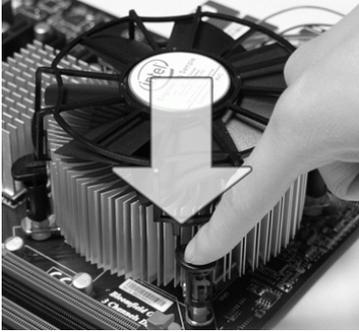
8. Align the holes on the mainboard with the heatsink. Push down the cooler until its four clips get wedged into the holes of the mainboard.



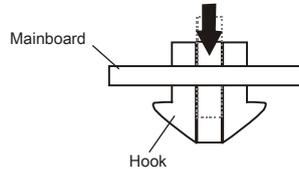
Important

- Confirm if your CPU cooler is firmly installed before turning on your system.
- Do not touch the CPU socket pins to avoid damaging.

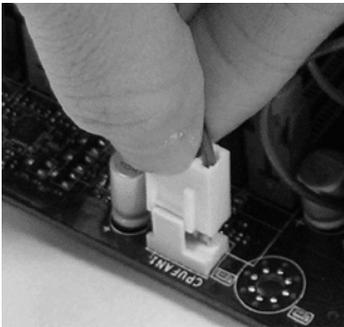
9. Press the four hooks down to fasten the cooler.



10. Turn over the mainboard to confirm that the clip-ends are correctly inserted.



11. Finally, attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

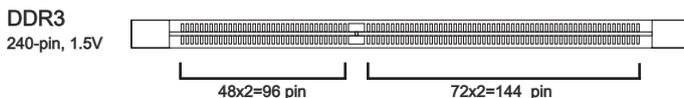


Important

- Read the CPU status in BIOS.
- Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the plastic cap covered (shown in Figure 1) to avoid damaging.
- Mainboard photos shown in this section are for demonstration of the CPU/ cooler installation only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model you purchase.
- Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details about the CPU fan installation.

Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit <http://www.msi.com/index.php?func=testreport>



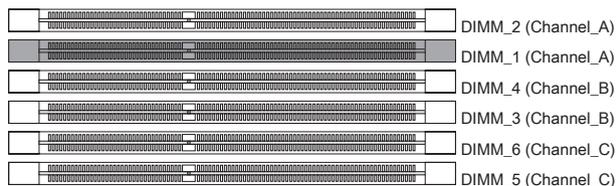
Memory Population Rule

Please refer to the following illustrations for memory population rules.

Single-Channel mode Population Rule

When you have only **one** memory module, please always insert it into the DIMM_1 (DIMM_A0 in v1.0 PCB) first.

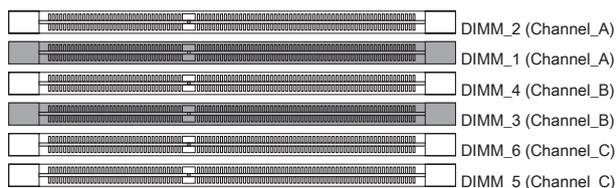
①



Dual-Channel mode Population Rule

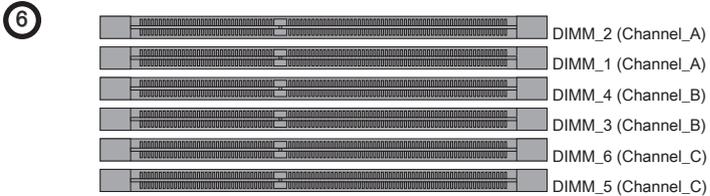
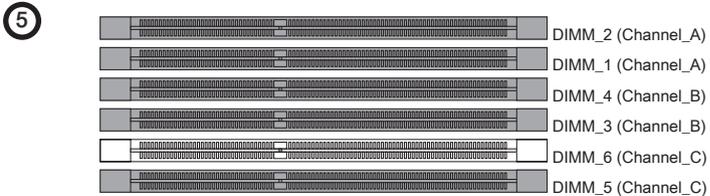
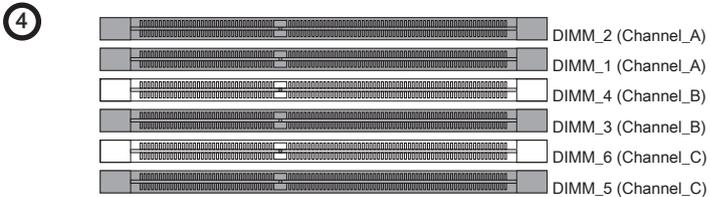
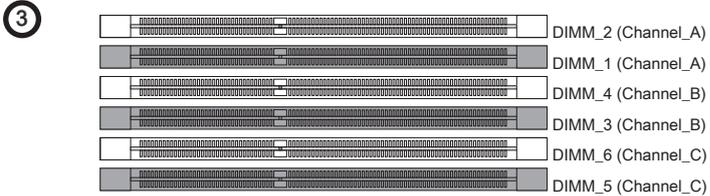
In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system performance. When you have **two** memory modules, please always insert them as the figures shown in below.

②



Triple-Channel mode Population Rule

In Triple-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with three data bus lines simultaneously. Enabling Triple-Channel mode can enhance the best system performance. When you have three or more memory modules, please always insert them as the figures shown in below.



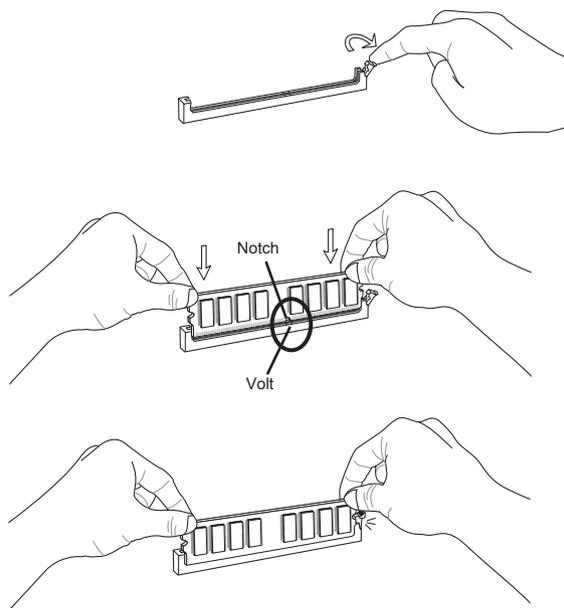
Important

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 standard is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in the DDR3 DIMM slots.*
- *In Triple-Channel/ Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same type and density in different channel DIMM slots.*

- To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the DIMM_1 (DIMM_A0 in v1.0 PCB) first.
- Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up to 23+GB (not full 24GB) when each DIMM is installed with a 4GB memory module.

Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right orientation.
2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot clips at the sides.



Important

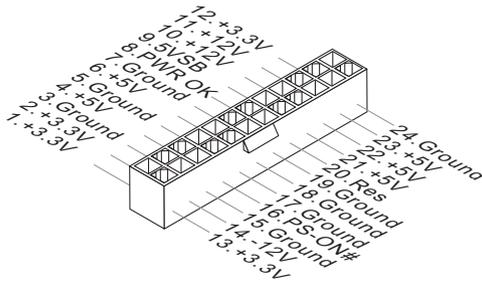
You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the DIMM slot.

Power Supply

ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

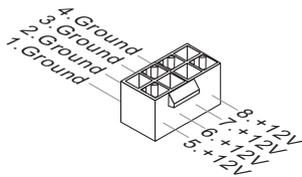
This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.



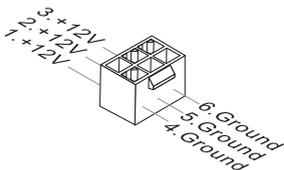
ATX 8-pin Power Connector: JPWR2/ JPWR3

These connectors provide 12V power output to the CPUs.



ATX 6-pin Power Connector: JPWR4

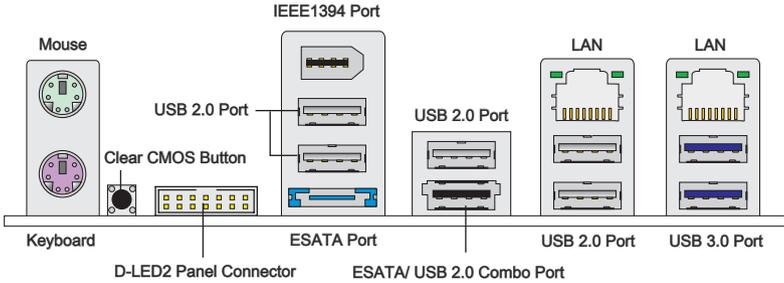
This connector is used to provide power to the graphics card.



Important

- *Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to ensure stable operation of the mainboard.*
- *Power supply of 450 watts (and above) is highly recommended for system stability.*

Back Panel



► Mouse/Keyboard

The standard PS/2[®] mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2[®] mouse/keyboard.

► Clear CMOS Button

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external battery to keep the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, use the button to clear data. Press the button to clear the data.

Important

Make sure that you power off the system before clearing CMOS data.

After pressing this button to clear CMOS data in power off (G3) state, the system will boot automatically.

► D-LED2 Panel Connector

This connector connects to a D-LED2 (Debug-LED2) panel (optional), which shows information on the panel for you and identify the current status or mode of the connected system. Please refer to the D-LED2 quick guide (optional) for more details and usages.

► IEEE 1394 Port

The IEEE 1394 port on the back panel provides connection to IEEE 1394 devices.

► USB 2.0 Port

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard, mouse, or other USB-compatible devices. Supports data transfer rate up to 480Mbit/s (Hi-Speed).

► ESATA Port

The ESATA (External SATA) port is for attaching the ESATA hard drive.

► ESATA/ USB 2.0 Combo Port

The ESATA/USB 2.0 combo port is for attaching the ESATA external hard drive or USB device.

► USB 3.0 Port

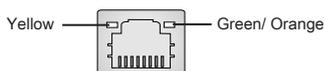
USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. Supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Important

If you want to use a USB 3.0 device, you must use the USB 3.0 cable to connect to the USB 3.0 port.

► LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to the Local Area Network (LAN). You can connect a network cable to it.

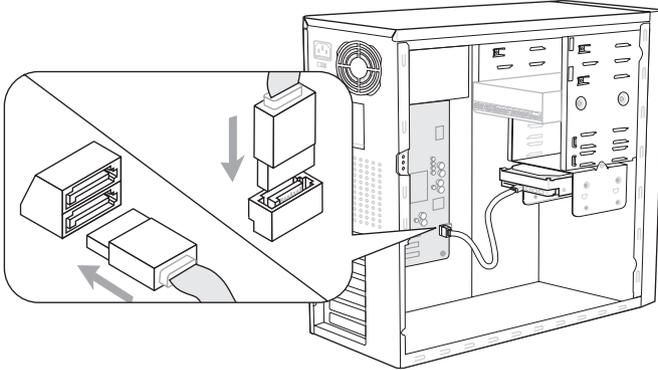


LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is not established.
		On(Steady state)	LAN link is established.
		On(brighter & pulsing)	The computer is communicating with another computer on the LAN.
Right	Green	Off	10 Mbit/sec data rate is selected.
		On	100 Mbit/sec data rate is selected.
	Orange	On	1000 Mbit/sec data rate is selected.

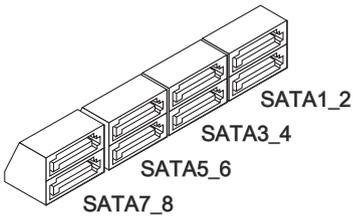
Connectors

Serial ATA Connector: SATA1~8

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect to one Serial ATA device.



* The MB layout in this figure is for reference only.



SATA1~6 (3Gb/s)
supported by Intel® ICH10R

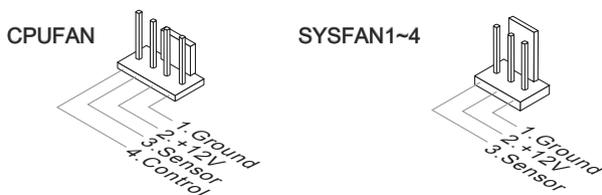
SATA7/ SATA8 (6Gb/s)
supported by Marvell® 88SE9128

Important

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may occur during transmission.

Fan Power Connectors: CPUFAN, SYSFAN1~4

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

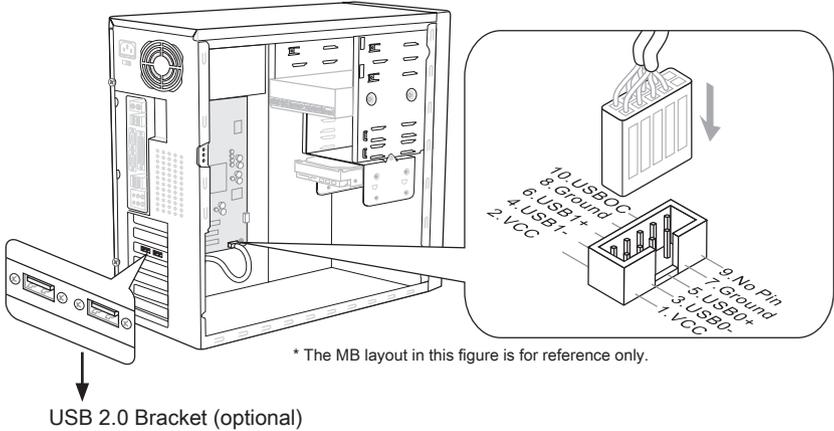


Important

- Please refer to the recommended CPU fans at processor's official website or consult the vendors for proper CPU cooling fan.
- CPUFAN support Smart fan control. You can install **Control Center** utility that will automatically control the CPUFAN speeds according to the actual CPUFAN temperatures.

Front USB Connector: JUSB1 / JUSB2

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3 players, printers, modems and the like.

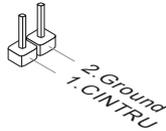


Important

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible damage.

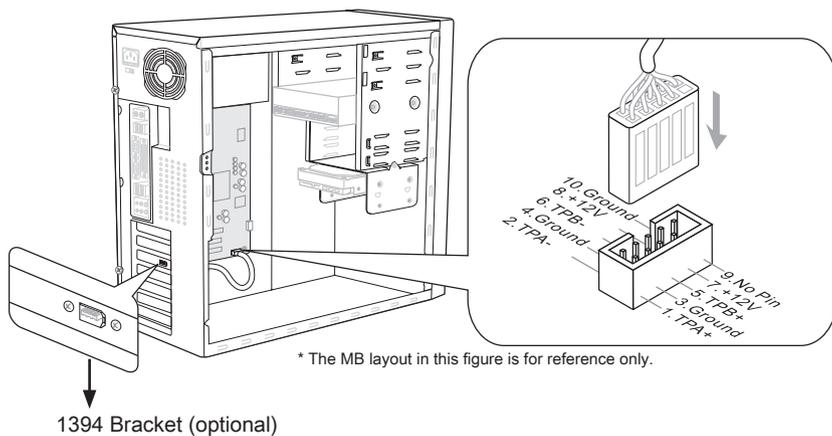
Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.



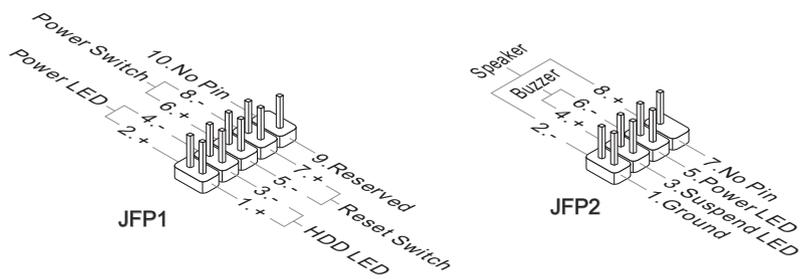
IEEE1394 Connector: J1394_1

This connector allows you to connect the IEEE1394 device via an optional IEEE1394 bracket.



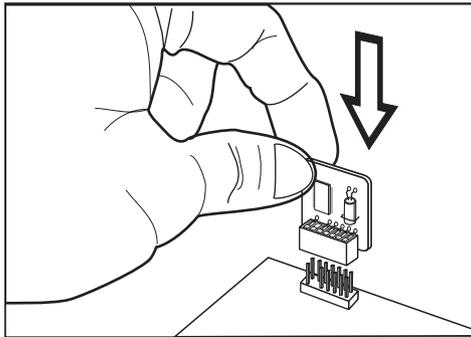
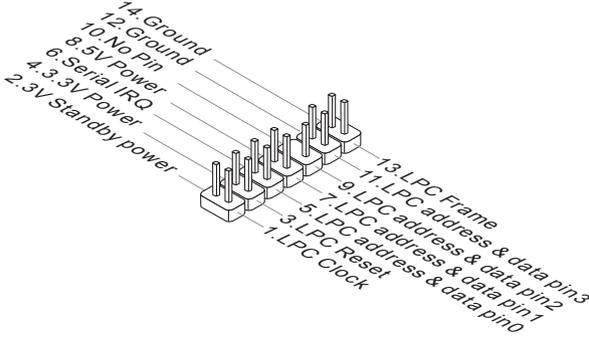
Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



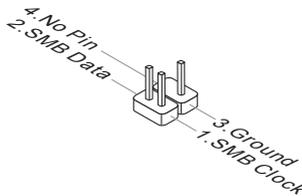
TPM Module connector: JTPM1

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.



GreenPower Genie Connector: JSMB1 (optional)

This connector connects to GreenPower Genie (optional).



Button

The mainboard provides the following buttons for you to set the computer's function. This section will explain how to change your mainboard's function through the use of button.

Power Button

This button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-on or turn-off the system.



Reset Button

This button is used to reset the system. Press the button to reset the system.



OC Genie Button

This button is used to auto-overclock for the system. Press this button to enable the OC Genie function when the system is in power off state, meanwhile, the button will light and lock. And then the system will automatically detect the optimum values to overclock after booting the system. To disable the OC Genie function, please press the button again after power off the system, meanwhile, the button light will off and unlock, and the system will restore the default for next boot.



Important

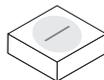
- Please install the DDR3 1333 and up memory and equip better heat sink/ cooler with OC Genie function.
- We do not guarantee the OC Genie overclocking range and the damages or risks caused by the OC Genie overclocking behavior.
- You can disable the OC Genie function in BIOS setup. And we suggest you to save the OC Genie configuration to overclocking profile in BIOS for future using.
- The usage of OC Genie is at your own risk. Overclocking is never guaranteed by MSI.

Base Clock Control Buttons

These buttons are used to increase or decrease the Base clock frequency. Pressing the Plus/ Minus button once will increase/ decrease the Base clock frequency 0.5 MHz when the system is in regular operation state.



Plus button



Minus button

Switch

This mainboard provides the following switch for you to set the computer's function. This section will explain how to change your mainboard's function through the use of switch.

Over-Voltage Switch

The switch is used to upgrade the maximum adjustment value of CPU/ QPI/ DDR/ IOH voltage in BIOS setup. And then you can over-voltage the CPU/ QPI/ DDR/ IOH voltage in BIOS setup.



Follow the instructions below to upgrade the maximum adjustment value of CPU/ QPI/ DDR/ IOH voltage.



Switch 1 : is used to upgrade the CPU voltage adjustment range, switching it to "ON" will upgrade the CPU voltage adjustment range in BIOS.



Switch 2 : is used to upgrade the QPI voltage adjustment range, switching it to "ON" will upgrade the QPI voltage adjustment range in BIOS.



Switch 3 : is used to upgrade the DDR voltage adjustment range, switching it to "ON" will upgrade the DDR voltage adjustment range in BIOS.



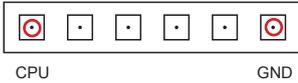
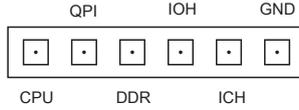
Switch 4 : is used to upgrade the IOH voltage adjustment range, switching it to "ON" will upgrade the IOH voltage adjustment range in BIOS.

Important

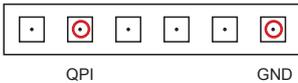
- While you enable OC Genie to detect your system configuration, please don't turn on any parts of V-switch simultaneously. That behavior would offer too much voltage for device and would be possible to cause some damage of device.
- After you set the CPU/ QPI/ DDR/ IOH voltage in BIOS, you can check the CPU/ QPI/ DDR/ IOH voltage by measuring the Voltage Check Point with multimeter. Please refer the following instructions to measure these voltages.

Voltage Check Point: V-Check Point

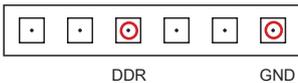
This voltage check point set is used to measure the current CPU/ QPI/ DDR/ IOH/ ICH voltage.



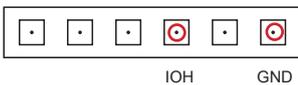
CPU voltage: measure the current CPU voltage with CPU point and GND point by using a multimeter.



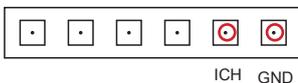
QPI voltage: measure the current QPI voltage with QPI point and GND point by using a multimeter.



DDR voltage: measure the current DDR voltage with DDR point and GND point by using a multimeter.



IOH voltage: measure the current IOH voltage with IOH point and GND point by using a multimeter.

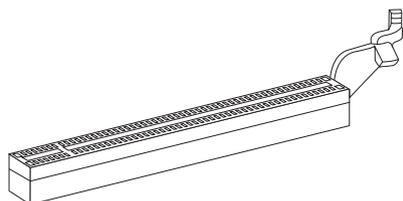


ICH voltage: measure the current ICH voltage with ICH point and GND point by using a multimeter.

Slots

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.



PCI Express x16 Slot



PCI Express x1 Slot

Important

When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.

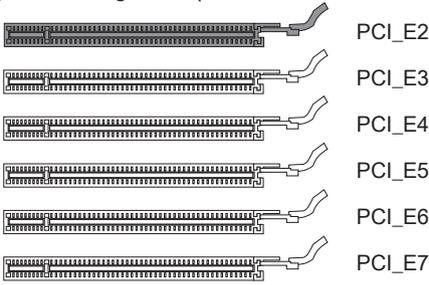
PCIe x16 slots Population Rule

Please refer to the following illustrations for PCIe x16 population rules. And the following table details the PCIe x16 lanes configuration with/ without installed expansions card(s).

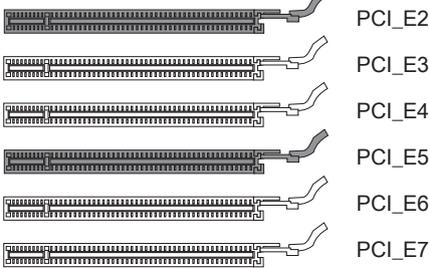
	1 expansion card	2 expansion cards	3 expansion cards		4 expansion cards	5 expansion cards	6 expansion cards
PCI_E2 Lane	x16 @	x16 @	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E3 Lane	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @	x4 @
PCI_E4 Lane	x0	x0	x0	x8 @	x8 @	x4 @	x4 @
PCI_E5 Lane	x16	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E6 Lane	x0	x0	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x4 @
PCI_E7 Lane	x0	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @

@ : expansion card installed slot

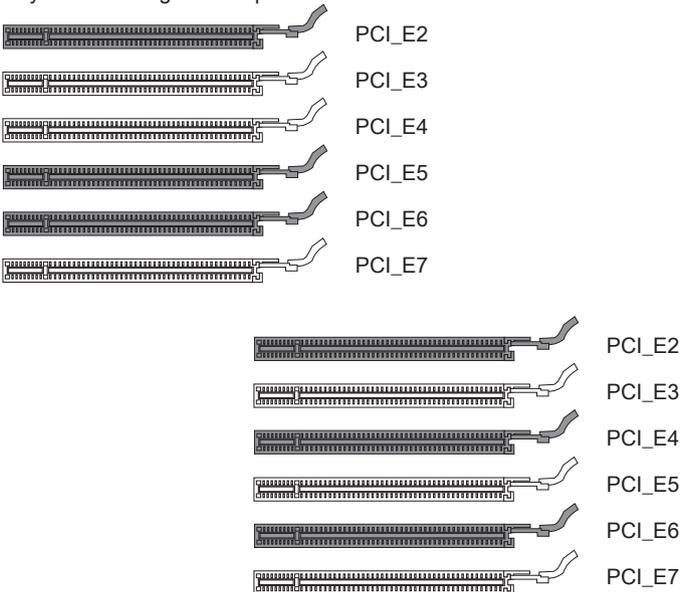
■ The way for installing one expansion card:



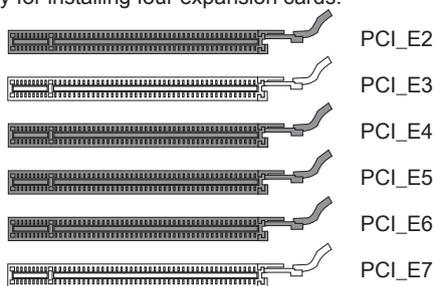
■ The way for installing two expansion cards:



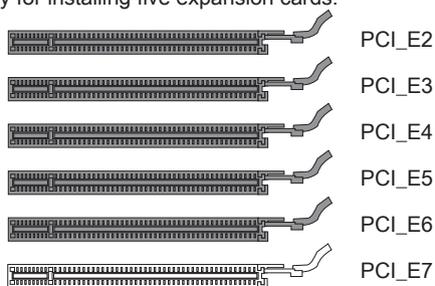
■ Two ways for installing three expansion cards:



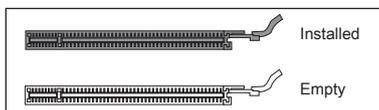
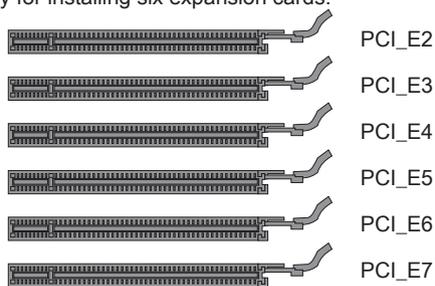
■ The way for installing four expansion cards:



■ The way for installing five expansion cards:



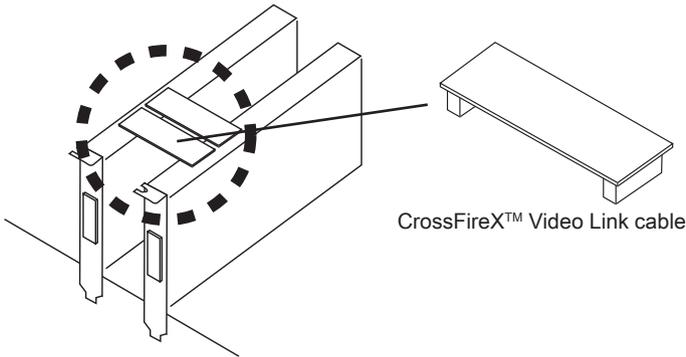
■ The way for installing six expansion cards:



ATI CrossFireX™ (Multi-GPU) Technology

ATI CrossFireX™ is the ultimate multi-GPU performance gaming platform. Enabling game-dominating power, ATI CrossFireX™ technology enables two or more discrete graphics processors to work together to improve system performance. ATI CrossFireX™ technology allows you to expand your system's graphics capabilities. It allows you the ability to scale your system's graphics horsepower as you need it, supporting two or more ATI Radeon™ HD graphics cards, making this the most scalable gaming platform ever. The motherboard can auto detect the CrossFireX™ mode by software, therefore you don't have to enable the CrossFireX™ in BIOS by yourself. The following details the 2-way CrossFireX™ installation.

1. Install two ATI Radeon™ HD graphics cards into the PCI_E2 & PCI_E5 slots.
2. With two cards installed, an CrossFireX™ Video Link cable is required to connect the golden fingers on the top of these two graphics cards (refer to the picture below). Please note that although you have installed two or more graphics cards, only the video outputs on the graphics card installed in first PCIE x16 slot will work. Hence, you only need to connect a monitor to this graphics card.



Important

- If you intend to install TWO graphics cards for CrossFireX™ mode, make sure that:
 - a. these two graphics cards are of the same brand and specifications;
 - b. these two cards are installed on both PCIE x16 slots (PCI_E2 & PCI_E5) that support up to PCIE x16 speed.
- Make sure that you connect an adequate power supply to the JPWR4 connector (or to the power connector on the graphics card) to ensure stable operation of the graphics card.
- Only Windows® XP with Service Pack 2 (SP2) & Windows® XP Professional x64 Edition, Windows® Vista & Windows® 7 support the CrossFireX™ function.

3. When all of the hardware and software has been properly set up and installed, reboot the system. After entering the O.S., click the “Catalyst™ Control Center” icon on the desktop. There is a setting in the Catalyst™ Control Center that needs to be enabled for CrossFireX™ to operate. The following aspect appears in Catalyst™ Control Center:

Select the Advanced View from the view drop menu.



Important

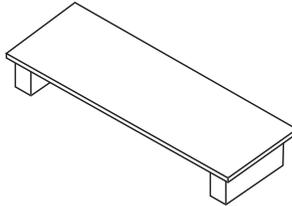
A CrossFireX™ system has four possible display modes:

- SuperTiling
- Scissor Mode
- Alternate Frame Rendering
- Super Anti-aliasing.

for more details, please consult the graphics card manual from the manufacturer.

NVIDIA® SLI Technology

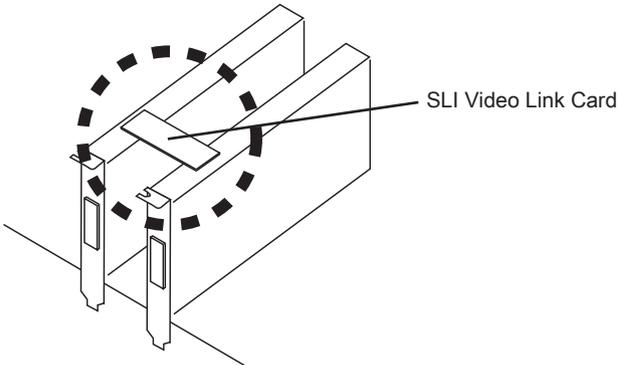
NVIDIA® SLI (Scalable Link Interface) technology allows two GPUs to run in tandem within a system to achieve up to twice the performance of a single graphics card. To utilize this technology, the two GPU cards must be connected by an SLI Video Link card.



SLI Video Link Card

If you intend to use the SLI mode for better graphics performance, please refer to the following instructions.

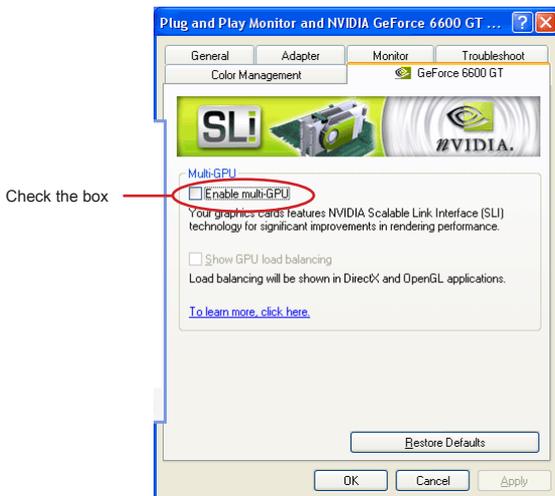
1. Install two graphics cards into the PCI_E2 & PCI_E5 slots. With two cards installed, an SLI Video Link Card is required to connect the golden fingers on the top of these two graphics cards (refer to the picture below). Please note that although you have installed two graphics cards, only the video outputs on the first card will work. Hence, you only need to connect a monitor to the first PCI Express card.



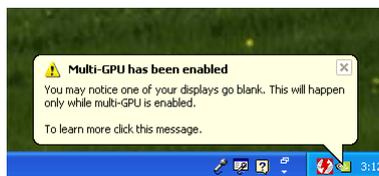
Important

- *The photos shown in this section are for demonstration only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model you purchase.*
- *If you intend to install TWO x16 graphics cards, make sure that these two graphics cards are of the same brand and specifications.*
- *Make sure that you connect an adequate power supply to the JPWR4 connector (or to the power connector on the graphics card) to ensure stable operation of the graphics card.*

- After the hardware installation is completed, restart the system and install the NV SLI driver/utility. A configuration panel will be provided for Multi-GPU control. Check the Enable multi-GPU box to enable the SLI function for the onboard graphics cards (concerning the details of multi-GPU settings, please refer to your graphics card manual).



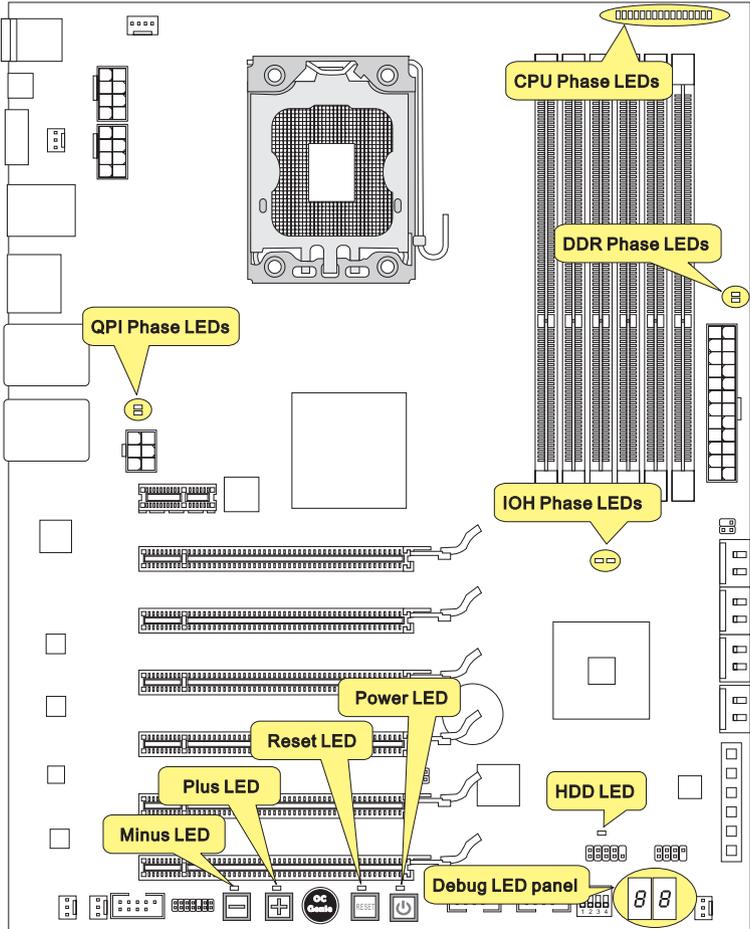
- Restart your system and a pop-up message will show in the system tray confirming the Multi-GPU has been enabled.



Important

If you want to remove one graphics card and quit the SLI function, make sure the “MultiGPU” function is disabled.

LED Status Indicators (optional)



IOH Phase LEDs

These LEDs indicate the current IOH power phase mode. Follow the instructions below to read.

Lights Off

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IOH is in 1 phase power mode.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	IOH is in 2 phase power mode.
---	-------------------------------	---	-------------------------------

DDR Phase LEDs

These LEDs indicate the current DDR power phase mode. Follow the instructions below to read.

Lights Off

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	DDR is in 1 phase power mode.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	DDR is in 2 phase power mode.
--	-------------------------------	---	-------------------------------

HDD LED

Lights when the hard drive is operating.

Power LED

Every time you press the power button and it is functional, the power LED will blink once.

Reset LED

Every time you press the reset button and it is functional, the reset LED will blink once.

Minus LED

Every time you press the minus button and it is functional, the minus LED will blink once.

Plus LED

Every time you press the plus button and it is functional, the plus LED will blink once.

Debug LED Panel

Please refer to the table below to get more information about the Debug LED message.

Post	Status
FF	Power on and first initialize CPU.
C0, C1, C2	Early CPU Initialize.
C4, C6	Initialize chipset.
D4, D5	Initialize memory.
08	Initialize keyboard.
2A, 31	Initialize onboard devices. Load Option ROM (VGA and RAID option ROM) from BIOS to memory.
37	Displaying sign-on message, CPU information, setup key message and any OEM specific information.
38	Initialize USB device and different devices.
3C	Mid POST initialization of chipset registers. Detect different devices (parallel ports, serial ports and coprocessor in CPU...etc.)
75, 78	Initialize INT 13 devices and IPL devices. (include SATA/ PATA HDD and CD/DVD ROM).
87	Enter setup screen. BIOS setup if needed/ requested.
A4	Wait for user input at configuration display if needed.
A7	Display the system configuration screen if enabled.
B1	Save system context for ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).Prepare give control to OS loader (INT 19H).
00	Pass control to OS Loader (typically INT 19H).
AA	Enter OS.

BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:

- An error message appears on the screen during the system booting up, and requests you to run BIOS SETUP.
- You want to change the default settings for customized features.

Important

- *The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*
- *Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is usually in the format:*

A7666IMS V1.0 042210 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.

2nd - 5th digit refers to the model number.

6th digit refers to the chipset as I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD and V = VIA.

7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

042210 refers to the date this BIOS was released.

Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the arrow keys (↑ ↓) to select the item. The on-line description of the highlighted setup function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol appears to the left of certain fields that means a sub-menu can be launched from this field. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys (↑ ↓) to highlight the field and press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the main menu, just press the <Esc >.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help screen.

The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen. The Main Menu allows you to select from the setup functions and two exit choices. Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the sub-menu.



▶ Standard CMOS Features

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

▶ Advanced BIOS Features

Use this menu to setup the items of special enhanced features.

▶ Integrated Peripherals

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

▶ Power Management Setup

Use this menu to specify your settings for power management.

▶ H/W Monitor

This entry shows your PC health status.

▶ Green Power

Use this menu to specify the power phase.

▶ BIOS Setting Password

Use this menu to set the password for BIOS.

▶ Cell Menu

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.

► M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).

► Overclocking Profile

Use this menu to save/ load your settings to/ from CMOS for BIOS.

► Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system performance.

► Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically for optimal performance of the mainboard.

► Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

► Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

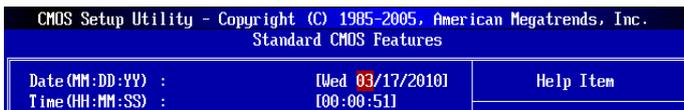
When entering the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. Load Optimized Defaults : Use control keys (↑↓) to highlight the Load Optimized Defaults field and press <Enter> , a message as below appears:



Select [Ok] and press Enter to load the default settings for optimal system performance.

2. Setup Date/ Time : Select the Standard CMOS Features and press <Enter> to enter the Standard CMOS Features menu. Adjust the Date, Time fields.



3. Save & Exit Setup : Use control keys (↑↓) to highlight the Save & Exit Setup field and press <Enter> , a message as below appears:

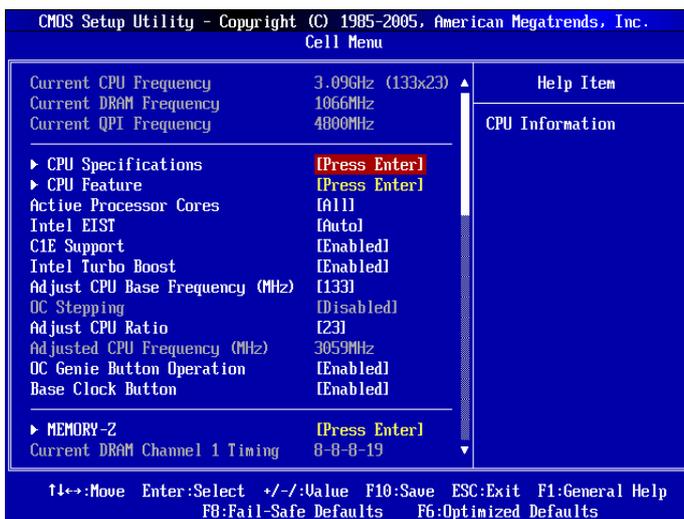


Select [OK] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.

Important

The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of BIOS, please see the complete version of English manual on MSI website.

4. Cell Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock the mainboard.



Important

Change these settings only if you are familiar with the chipset.

▶ Current CPU / DRAM / QPI Frequency

These items show the current frequencies of CPU, Memory and QPI. Read-only.

▶ CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This submenu shows the information of installed CPU.

▶ CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu, it shows the installed CPU technologies. Read only.

▶ CPU Feature

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep technology.

▶ Intel C-State

C-state is a power management state that significantly reduces the power of the processor during idle. This field will appear after you installed the CPU which supports c-state technology.

▶ **C State Package Limit Setting**

This feild allows you to select a C-state level. We recommend that you leave this setting to Auto.

▶ **C1E Support**

To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▶ **OverSpeed Protection**

Overspeed Protection function can monitor the current CPU draws as well as its power consumption. If it exceeds a certain level, the processor automatically reduces its clock speed. If you want to overclock your CPU, set it to [Disabled].

▶ **Hyper-Threading Function**

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item if your operating system doesn't support HT Function, or unreliability and instability may occur.

Important

Enabling the functionality of Hyper-Threading Technology for your computer system requires ALL of the following platform Components:

- CPU: An Intel® Processor with HT Technology;
- Chipset: An Intel® Chipset that supports HT Technology;
- BIOS: A BIOS that supports HT Technology and has it enabled;
- OS: An operating system that supports HT Technology.

For more information on Hyper-threading Technology, go to:

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm

▶ **Execute Bit Support**

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious "buffer overflow" attacks when combined with a supporting operating system. This functionality allows the processor to classify areas in memory by where application code can execute and where it cannot. When a malicious worm attempts to insert code in the buffer, the processor disables code execution, preventing damage or worm propagation.

▶ **Set Limit CPUID MaxVal to 3**

The Max CPUID Value Limit is designed limit the listed speed of the processor to older operating systems.

▶ **Intel Virtualization Tech**

This item is used to enable/disable the Intel Virtualization technology. For further information please refer to Intel's official website.

▶ Intel VT-d

This item is used to enable/disable the Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d). For further information please refer to Intel's official website.

▶ Active Processor Cores

This item allows you to select the number of active processor cores.

▶ Intel EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep technology.

▶ C1E Support

To enable this item to read the CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▶ Intel Turbo Boost

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology. This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale processor frequency higher dynamically when applications demand more performance and TDP headroom exists. It also can deliver seamless power scalability (Dynamically scale up, Speed-Step Down). It is the Intel newly technology within i7 CPU.

▶ Adjust CPU Base Frequency (MHz)

This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz). You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▶ OC Stepping

This item will be enabled after you set the overclocking frequency in the "Adjust CPU Base Frequency (MHz)". And the following items will appear. This items will help the system to overclock step by step after system booting up.

▶ Start OC Stepping From (MHz)

This item is used to set the initial base clock. The system will boot with the initial base clock, and start to overclock from initial base clock to set base clock that you set in "Adjust CPU Base Frequency (MHz)" step by step.

▶ OC Step

This item is used to set how many steps for base colck overclocking.

▶ OC Step Count Timer

This item is used to set the buffer time for every step.

▶ Adjust CPU Ratio

This item allows you to adjust the CPU ratio.

▶ Adjusted CPU Frequency (MHz)

It shows the adjusted CPU frequency (Base clock x Ratio). Read-only.

▶ OC Genie Button Operation

This item is used to enable/ disable the OC Genie button function.

▶ **Base Clock Button**

This item is used to enable/ disable the base clock button function.

▶ **MEMORY-Z**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ **DIMM1~6 Memory SPD Information**

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▶ **Current DRAM Channel1/2/3 Timing**

It shows the installed DRAM Timing. Read-only.

▶ **DRAM Timing Mode**

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following "Advance DRAM Configuration" sub-menu to be determined by BIOS based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to configure the DRAM timings and the following related "Advance DRAM Configuration" sub-menu manually.

▶ **Advance DRAM Configuration**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 1T/2T Memory Timing**

This item controls the SDRAM command rate. Selecting [1] makes SDRAM signal controller to run at 1N (N=clock cycles) rate. Selecting [2] makes SDRAM signal controller run at 2N rate.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 CAS Latency (CL)**

This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRCD**

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the faster the DRAM performance.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRP**

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its charge before DRAM refresh, refresh may be incomplete and DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRAS**

This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory cell.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRFC**

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tWR**

Minimum time interval between end of write data burst and the start of a precharge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tWTR**

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before read command starts.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRRD**

Specifies the active-to-active delay of different banks.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRTP**

Time interval between a read and a precharge command.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tFAW**

This item is used to set the tFAW timing.

▶ **Current CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRdTWr/ tdrRdTWr/ tddRdTWr/ tsrWrTRd/ tdrWrTRd/ tddWrTRd/ tdrWrTWr/ tddWrTWr/ tsrRdTRd/ tsrWrTWr**

These items show the advanced DRAM timings.

▶ **Channel 1/ Channel 2/ Channel 3 or Channel 1-3 Advance Timing**

Setting to [Auto] enables the advance memory timing automatically to be determined by BIOS. Setting to [Manual] allows you to set the following advanced memory timings.

▶ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)**

This item is used to enable/ disable the Intel Extreme Memory Profile (X.M.P.). For further information please refer to Intel's official website.

▶ **Memory Ratio**

This item allows you to set the memory multiplier.

▶ **Adjusted DRAM Frequency (MHz)**

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▶ **Uncore Ratio**

This item allows you to set the uncore multiplier.

▶ **Adjusted Uncore Frequency (MHz)**

It shows the adjusted uncore frequency. Read-only.

▶ **QPI Links Speed**

This item is used to select the QPI link speed mode.

▶ **QPI Frequency**

This item allows you to set the QPI frequency.

▶ **Adjusted QPI Frequency (MHz)**

It shows the adjusted QPI frequency. Read-only.

▶ **ClockGen Tuner**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▶ **CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control**

These items are used to select the CPU/ PCI Express clock amplitude.

▶ **CPU CLK Skew/ MCH CLK Skew**

These items are used to select the CPU/ MCH chipset clock skew. They can help CPU to reach the higher overclocking performance.

▶ **Adjust PCI-E Frequency (MHz)**

This field allows you to select the PCIE frequency (in MHz).

▶ **VDrop Control**

This item is used to select the VDrop control mode.

▶ **CPU Voltage (V)/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ IOH Voltage (V)/ IOH PCIE Voltage (V)/ ICH Voltage (V)**

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

▶ **Spread Spectrum**

When the mainboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overlocked processor to lock up.*

Important

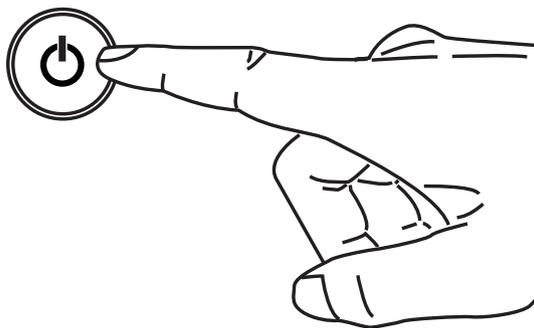
Failed Overclocking Resolution

This mainboard supports overclocking greatly. However, please make sure your peripherals and components are bearable for some special settings. Any operation that exceeds product specification is not recommended. Any risk or damage resulting from improper operation will not be under our product warranty.

Two ways to save your system from failed overclocking...

- **Reboot**

Press the Power button to reboot the system three times. Please note that, to avoid electric current to affect other devices or components, we suggest an interval of more than 10 seconds among the reboot actions.



At the fourth reboot, BIOS will determine that the previous overclocking is failed and restore the default settings automatically. Please press any key to boot the system normally when the following message appears on screen.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....

- **Clear CMOS**

Please refer to "how to clear CMOS data" section for more information about how to clear CMOS data.

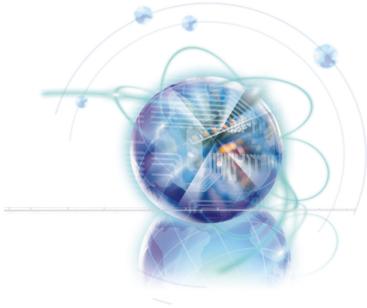
Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD contains the:

- Driver menu : The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : The Utility menu shows the software applications that the mainboard supports.

Important

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.



한국어

XPower 시리즈

Asia version

메인보드 사양

지원되는 프로세서

- LGA1366 패키지의 Intel® Bloomfield™ 프로세서
(CPU에 대한 최신 정보는 <http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2> 참조)

QPI

- 최대 6.4 GT/s 지원

칩셋

- 노스 브릿지: Intel® X58 칩셋
- 사우스 브릿지: Intel® ICH10R 칩셋

지원되는 메모리

- DDR3 2133*(OC)/ 1800*(OC) /1600*(OC)/ 1333/ 1066 / 800 DRAM 지원되는 DDR3 DIMM 6개 (최대 24GB)
- 듀얼 채널 모드/ 트리플 채널 모드 지원
*(호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 <http://www.msi.com/index.php?func=testreport>를 참조하십시오)

LAN

- Realtek® RTL8111DL에 의해 Dual LAN 10/100/1000 Fast Ethernet 지원

IEEE 1394

- VIA® VT6315N에 의해 IEEE 1394 포트 1개

QuantumWave 오디오 카드

- Realtek® ALC889
- Azalia 1.0 Spec 규격 준수
- 잭 감지 있는 7.1 채널 고음질 오디오 코덱
- 1x S/PDIF 출력 헤더 지원
- 후면 동축/광학 S/PDIF 출력 포트 지원

SATA

- Intel® ICH10R에 의한 SATA 3Gb/s (SATA1~6) 포트 6개
- Marvell® 88SE9128에 의한 SATA 6Gb/s (SATA7~8) 포트 2개
- JMicron® JMB362에 의한 ESATA 포트1개 & ESATA/ USB 2.0 콤보 포트1개 (후면 패널)
- 핫 플러그 및 비동기 통지 지원

USB 3.0

- NEC® uPD720200F1에 의한 USB 3.0 포트 2개

RAID

- Intel® ICH10R에 의한 Intel® Matrix Storage Technology (AHCI/ RAID 0/1/5/10) 지원하는 SATA1~6
- Marvell® 88SE9128에 의한 RAID 0/ 1 모드 지원하는 SATA7~8 포트

커넥터

- 후면 패널
 - PS/2 키보드 포트 1개
 - PS/2 마우스 포트 1개
 - CMOS 클리어 버튼 1개
 - D-LED2 패널 커넥터 1개
 - IEEE1394 포트 1개
 - USB 2.0 포트 5개
 - ESATA 포트 1개
 - ESATA/ USB 2.0 콤보 포트 1개
 - LAN 포트 2개
 - USB 3.0 포트 2개
- 온보드
 - USB 2.0 커넥터 2개
 - IEEE1394 커넥터 1개
 - 새시 침입 커넥터 1개
 - TPM 모듈 커넥터 1개
 - 리셋 버튼 1개
 - 전원 버튼 1개
 - GreenPower Genie 커넥터 1개 (옵션)
 - 오버-전압 스위치 1개
 - 설정 전압 체크 포인트 1개
 - OC Genie 버튼 1개
 - 베이스 클럭 제어 버튼 2개
 - 설정 디버그 LED 패널 1개

슬롯

- PCI Express 2.0 x16 슬롯 6개 (PCI_E2 & PCI_E5는 최대 PCIe x16 속도 지원, PCI_E4 & PCI_E6는 최대 PCIe x8 속도 지원, PCI_E3 & PCI_E7 최대 PCIe x4 속도)
- PCI Express 1.1 x1 슬롯 1개

폼 팩터

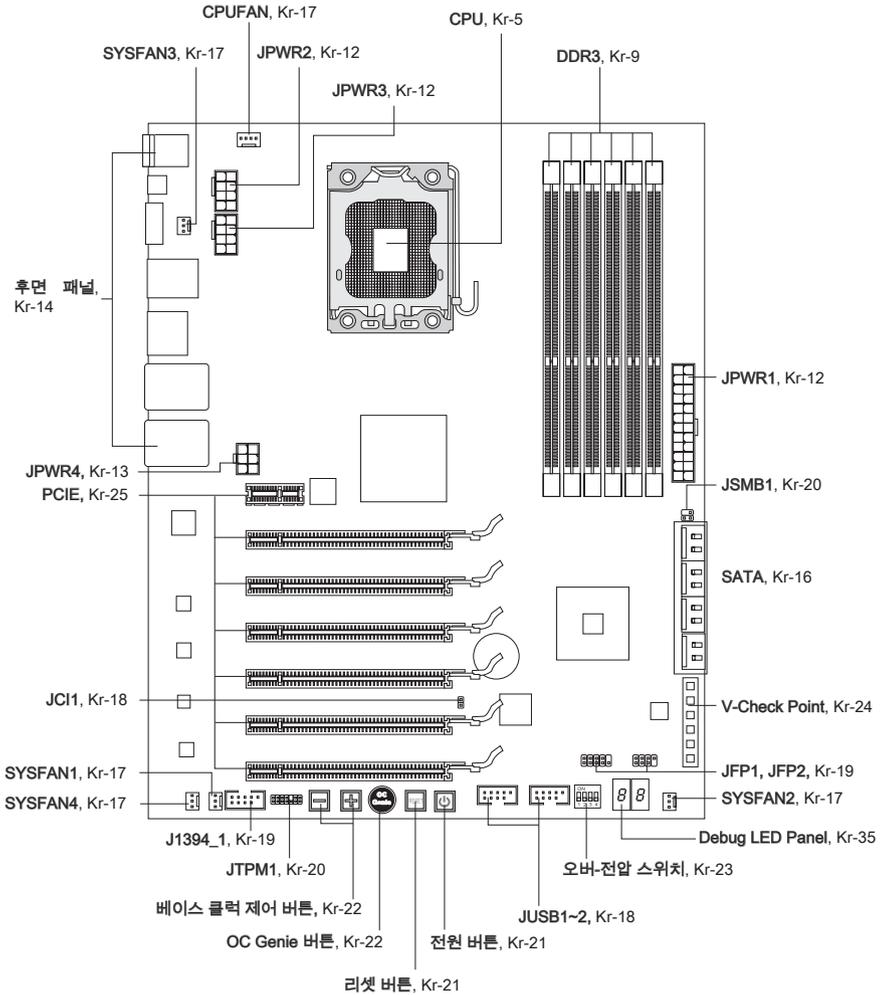
- ATX (24.4cm X 30.5 cm)

장착

- 장착 구멍 9개

* 액세서리 구매나 제품 번호 등의 다양한 정보는, 웹페이지 <http://www.msi.com/index.php>에서 확인할 수 있습니다.

빠른 부품 설명서



CPU (중앙 처리 장치)

CPU 설치 시 과열을 방지하는 쿨러를 반드시 설치하십시오. CPU 쿨러가 없는 경우, 컴퓨터를 켜기 전에 판매점에 문의하십시오.

CPU에 대한 최신 정보는 <http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2> 참조

중요 사항

과열

과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있습니다. CPU가 과열되지 않도록 냉각 팬이 제대로 작동하는지 항상 확인하십시오. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 바르십시오.

CPU 교체

CPU 교체 시, 항상 전원을 끄거나 먼저 ATX 전원 공급장치의 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑아 CPU의 안전을 확보하십시오.

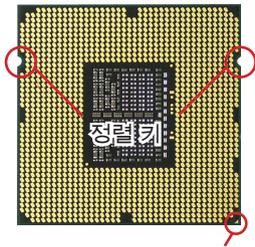
오버클로킹

이 메인보드는 오버클로킹 기능을 지원하도록 디자인되었습니다. 그러나 오버클로킹이 진행되는 동안 부품이 이러한 비정상적인 설정을 견뎌낼 수 있는지 확인하십시오. 제품 사양을 초과하는 범위에서 작동시키지 마십시오. 당사는 올바르게 않은 작동이나 제품 사양을 초과한 범위에서 사용하여 발생한 손상 또는 위험은 보증하지 않습니다.

LGA 1366 CPU 소개

LGA 1366 CPU의 핀 패드 면.

LGA 1366 CPU의 표면. 열이 잘 발산되도록 서멀 페이스트를 표면에 약간 바르십시오.



노란색 삼각형은 핀 1의 표시기입니다.



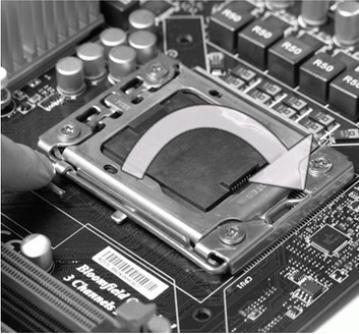
노란색 삼각형은 핀 1의 표시기입니다.

CPU 및 쿨러 설치

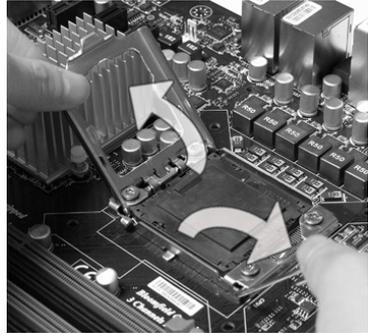
CPU 설치 시 과열을 방지하는 쿨러를 상단에 연결하십시오. 한편, 열이 잘 발산되도록 방열판/쿨러 팬을 설치하기 전에 CPU에 서멀 페이스트를 약간 바르십시오.

아래의 단계에 따라 CPU 및 쿨러를 올바르게 설치하십시오. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상됩니다.

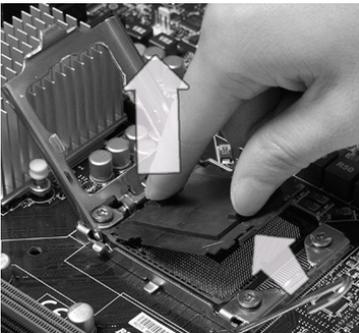
1. 로드 레버를 엽니다.



2. 로드 레버를 위로 올리고 로드 플레이트를 엽니다.



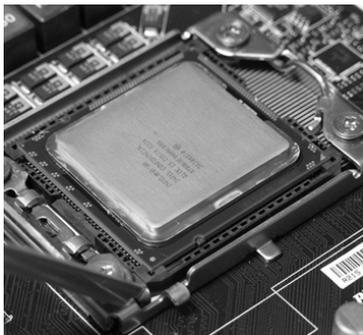
3. CPU 소켓에는 접촉에 의한 손상을 방지하는 플라스틱 캡이 있습니다. CPU를 설치하기 전에, 항상 캡으로 소켓을 덮어 소켓 핀을 보호하십시오. 화살표와 같이 캡을 제거하십시오.



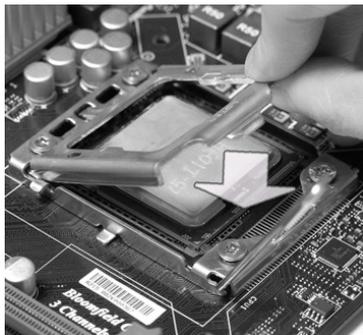
4. CPU 방향이 올바르게 맞춰졌는지 확인한 다음, CPU를 소켓 하우징 프레임에 내려 놓습니다. CPU 베이스의 가장자리를 잡으십시오. 정렬 키가 맞춰졌는지 유의하십시오.



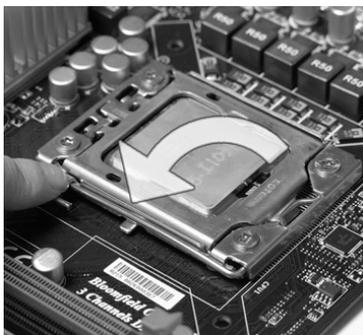
5. CPU가 소켓에 제대로 앉혀졌는지 육안으로 검사합니다. 그렇지 않은 경우, CPU를 수직 방향으로 들어 올린 다음 다시 설치합니다.



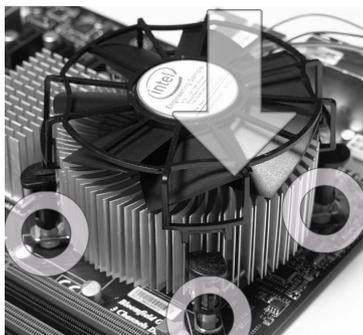
6. 로드 플레이트로 패키지를 덮습니다.



7. 로드 레버를 로드 플레이트 위로 살짝 누른 다음, 리텐션 탭 아래의 홈을 사용하여 레버를 고정합니다.



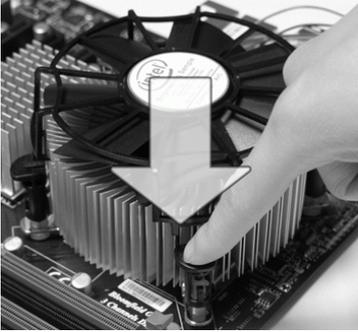
8. 메인보드의 구멍을 방열판과 맞춥니다. 4개의 클립이 메인보드의 구멍에 완전히 박힐 때까지 쿨러를 누릅니다.



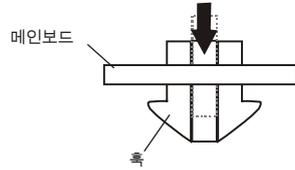
중요 사항

- 시스템을 켜기 전에 CPU 쿨러가 단단히 설치되었는지 확인합니다.
- 손상을 방지하려면 CPU 소켓을 만지지 마십시오.

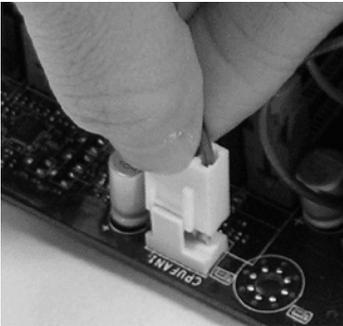
9. 4개의 훅을 눌러 쿨러를 고정합니다.



10. 메인보드를 뒤집어 클립 엔드가 올바르게 끼워졌는지 확인합니다.



11. 마지막으로 CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.

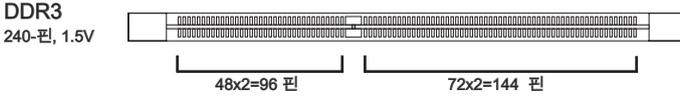


중요 사항

- BIOS에서 CPU 상태를 읽습니다.
- CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 (그림 1과 같이) 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하십시오.
- 이 절에 표시된 메인보드 사진은 CPU/쿨러 설치를 보여줄 목적으로만 사용된 사진입니다. 메인보드의 외양은 구입한 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- CPU 팬 설치에 대한 자세한 내용은 CPU 팬 패키지에 있는 설명서를 참조하십시오.

메모리

DIMM 슬롯은 메모리 모듈을 설치하는 데 사용됩니다. 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 <http://www.msi.com/index.php?func=testreport>를 참조하십시오.



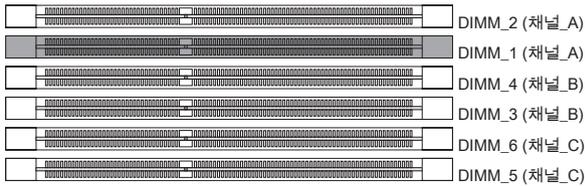
메모리 패포 규칙

다음 그림에서 메모리 패포 규칙을 참조하십시오.

싱글 채널 모드 패포 규칙

메모리 모듈이 하나인 경우, 반드시 DIMM_1 (PCB v1.0에 있는 DIMM_A0)에 먼저 끼우십시오.

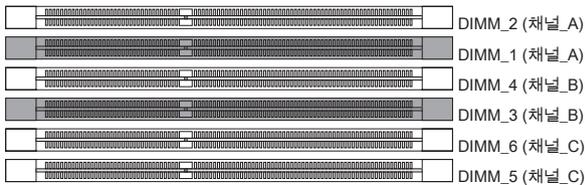
①



듀얼 채널 모드 패포 규칙

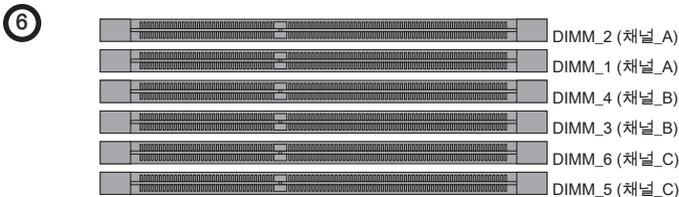
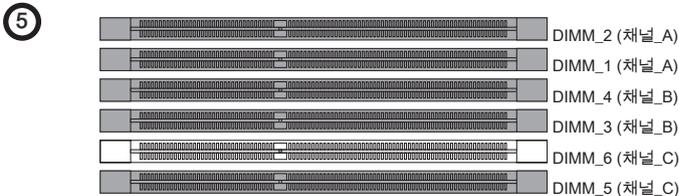
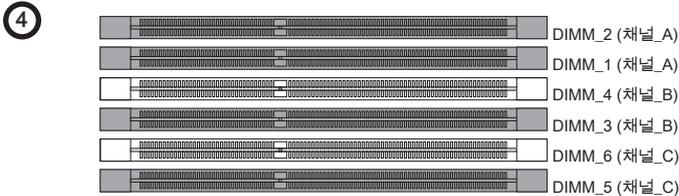
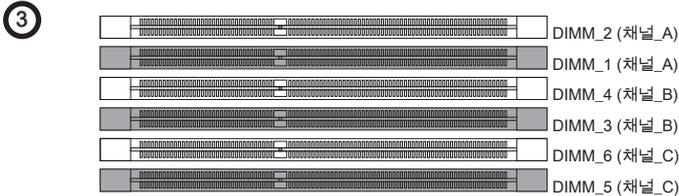
듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2개의 데이터 버스 회선을 동시에 사용하여 데이터를 전송 및 수신할 수 있습니다. 듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다. 다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하십시오.

②



트리플 채널 모드 배포 규칙

트리플 채널 모드에서는 메모리 모듈이 3개의 데이터 버스 회선을 동시에 사용하여 데이터를 전송 및 수신할 수 있습니다. 트리플 채널 모드를 활성화하면 최고의 시스템 성능이 향상됩니다. 메모리 모듈이 3개 이상인 경우, 아래 그림을 참조하여 설치하십시오.



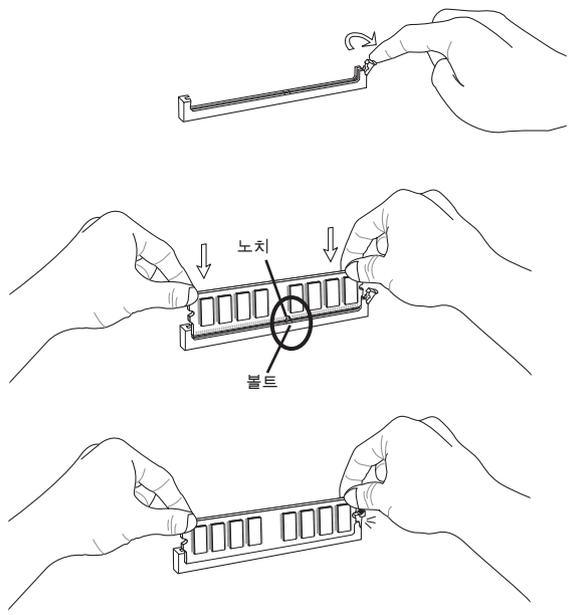
중요 사항

- DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 교환되지 않으며, DDR3 표준은 역호환이 되지 않습니다. 항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.
- 트립플/듀얼 채널 모드에서, 다른 채널 DIMM 슬롯에 유형과 밀도가 동일한 메모리 모듈을 설치했는지 확인하십시오.

- 성공적인 시스템 부팅을 하려면, 메모리 모듈을 먼저 DIMM_1 (PCB v1.0에 있는 DIMM_A0)에 끼우십시오.
- 칩셋 리소스 배치 때문에, 각 DIMM이 4GB 모듈로 설치된 경우 시스템 밀도가 (전체 24GB가 아닌) 최대 23+GB까지만 인식됩니다.

메모리 모듈 설치

1. 메모리 모듈은 중앙에 노치가 하나만 있으며, 오른쪽 방향으로만 맞습니다.
2. 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 수직으로 끼웁니다. 그리고 나서 메모리 모듈 위의 골든 핑거가 DIMM 슬롯에 깊이 삽입될 때까지 밀어 넣습니다. 메모리 모듈이 제자리를 잡으면, DIMM 슬롯의 양쪽에 있는 플라스틱 클립이 자동으로 닫힙니다.
3. 메모리 모듈이 양쪽에 있는 DIMM 슬롯 클립에 의해 제자리에 잠가졌는지 수동으로 확인하십시오.



중요 사항

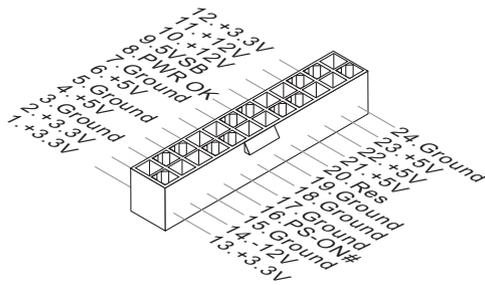
메모리 모듈이 DIMM 슬롯에 제대로 삽입되면 골든 핑거가 거의 보이지 않습니다.

전원 공급 장치

ATX 24 핀 전원 커넥터: JPWR1

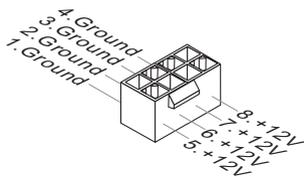
이 커넥터를 사용하여 ATX 24 핀 전원 공급장치를 연결할 수 있습니다. ATX 24 핀 전원 공급장치를 연결하려면, 전원 공급장치의 플러그가 올바른 방향으로 삽입되었는지, 이 정렬되었는지 확인하십시오. 그리고 나서 전원 공급장치를 커넥터 안쪽으로 짝 맞게 누릅니다.

원하는 경우 20 핀 ATX 전원 공급장치를 사용할 수 있습니다. 20 핀 ATX전원 공급장치를 사용하려면, 전원 공급장치의 플러그를 핀 1 및 핀13과 함께 연결하십시오.

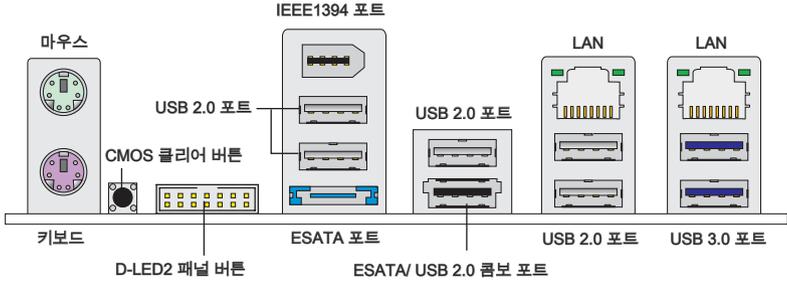


ATX 8 핀 전원 커넥터: JPWR2/ JPWR3

이 커넥터는 CPU에 12V 전원 출력을 공급하는 데 사용됩니다.



후면 패널



▶ 마우스/키보드

표준 PS/2® 마우스/키보드 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▶ CMOS 클리어 버튼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받은 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면, 버튼을 사용하여 데이터를 지우십시오. 버튼을 눌러 데이터를 지우십시오.

중요 사항

CMOS 데이터를 지우기 전에 시스템의 전원을 껐는지 확인하십시오.

전원을 끄기 (G3) 상태에서 이 버튼을 눌러 CMOS 데이터를 지우 다음에 시스템이 자동으로 부팅합니다.

▶ D-LED2 패널 커넥터

이 커넥터는 D-LED2 (Debug-LED2) 패널 (옵션)에 연결되며, 여기에 패널에 대한 정보가 표시되기 때문에 연결된 시스템의 현재 상태 또는 모드를 알 수 있습니다. 자세한 내용과 사용법은 D-LED2 빠른 설명서 (옵션)를 참조하십시오.

▶ IEEE 1394 포트

후면 패널의 IEEE1394 포트는 IEEE1394 장치에 대한 연결을 제공합니다.

▶ USB 2.0 포트

USB (Universal Serial Bus) 포트는 키보드, 마우스 또는 기타 USB 호환 가능 장치와 같은 USB 장치를 연결하는 데 사용됩니다. 최대 데이터 전송 480Mbit/s (고속) 지원합니다.

▶ESATA 포트

ESATA (외부 SATA) 포트는 하드 드라이브를 연결하는 데 사용됩니다.

▶ESATA/ USB 2.0 콤보 포트

ESATA/USB 2.0 콤보 포트는 ESATA 외장 하드 드라이브나 USB 장치를 연결하는 데 사용됩니다.

▶USB 3.0 포트

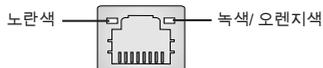
USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(초속).

중요 사항

USB 3.0 장치를 사용하려면 USB 3.0 케이블으로 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.

▶LAN

표준 RJ-45 LAN 잭은 Local Area Network (LAN) 연결용입니다. 네트워크 케이블을 이 잭에 연결할 수 있습니다.

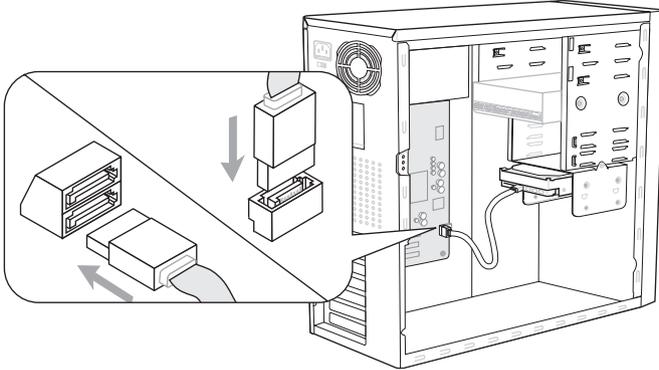


LED	칼라	LED 상태	조건
왼쪽	노란색	꺼짐	LAN 링크가 구축되지 않았습니다.
		켜기(지속 상태)	LAN 링크가 구축되었습니다.
		켜기(밝게 및 펄싱)	컴퓨터가 LAN 상의 다른 컴퓨터와 통신 중입니다.
오른쪽	녹색	꺼짐	10 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다.
		켜기	100 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다.
	오렌지색	켜기	1000 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다.

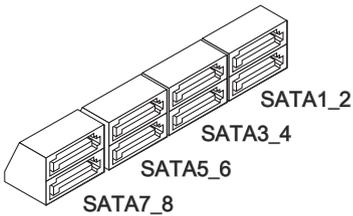
커넥터

시리얼 ATA 커넥터: SATA1~8

이 커넥터는 고속의 시리얼 ATA 인터페이스 포트에 사용됩니다. 각 커넥터는 하나의 시리얼 ATA 장치에 연결할 수 있습니다.



* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.



Intel® ICH10R에 의한
SATA1~6 (3Gb/s) 지원

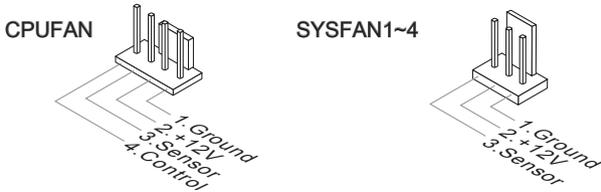
Marvell® 88SE9128에 의한
SATA7/ SATA8 (6Gb/s) 지원

중요 사항

시리얼 ATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손실될 수 있습니다.

팬 전원 커넥터: CPUFAN, SYSFAN1~4

팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 냉각 팬을 지원합니다. 전선을 커넥터에 연결할 때, 항상 빨간색 전선이 양극으로서 +12V에 연결되어야 하고, 검은색 전선은 접지선으로서 GND에 연결되어야 합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋 온보드가 있는 경우, CPU 팬 제어를 활용하기 위해 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다.

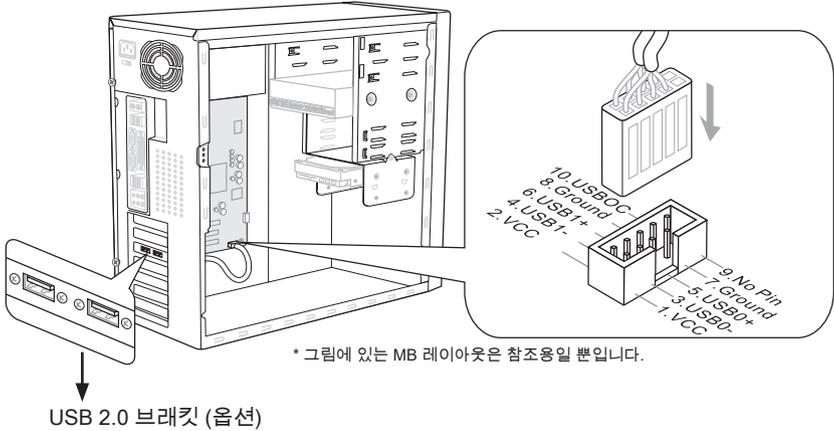


중요 사항

- 프로세서의 공식 웹 사이트에서 권장 CPU 팬을 참조하거나 판매점에 올바른 CPU 냉각 팬을 문의하십시오.
- CPUFAN은 팬 제어를 지원합니다. 실제 CPUFAN 시스템 온도에 따라 이 CPUFAN 속도를 자동으로 제어하는 **Control Center** 유틸리티를 설치할 수 있습니다.

전면 USB 커넥터: JUSB1 / JUSB2

Intel® I/O Connectivity Design Guide를 준수한 이 커넥터는 USB HDD, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 프린터, 모뎀 등과 같은 고속의 USB 인터페이스 주변 장치를 연결하는데 적합합니다.



중요 사항

VCC 및 GND의 핀은 손상을 방지하기 위해 올바르게 연결되어야 합니다.

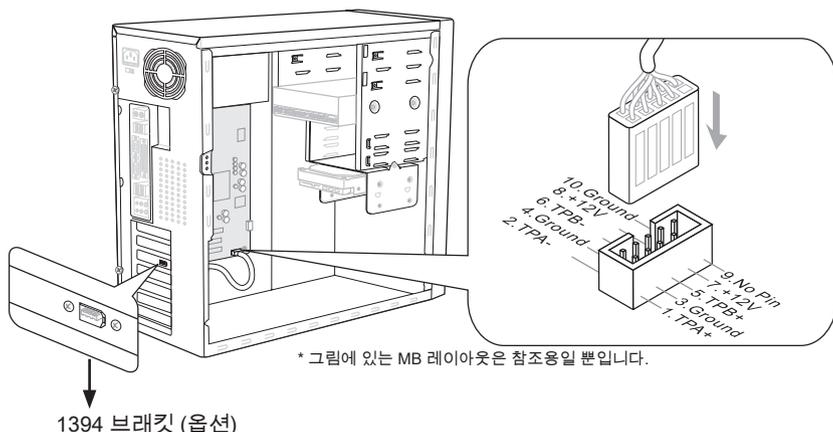
새시 침입 커넥터: JCI1

이 커넥터는 새시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 새시가 열리는 경우, 새시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지를 표시합니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.



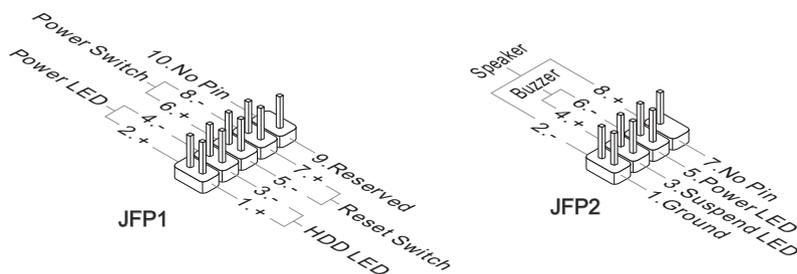
IEEE1394 커넥터: J1394_1

이 커넥터를 사용하여 옵션인 IEEE1394 브래킷을 통해 IEEE1394 장치를 연결할 수 있습니다.



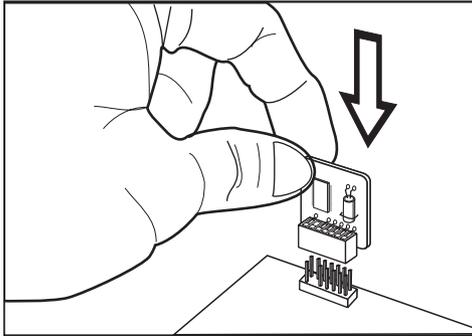
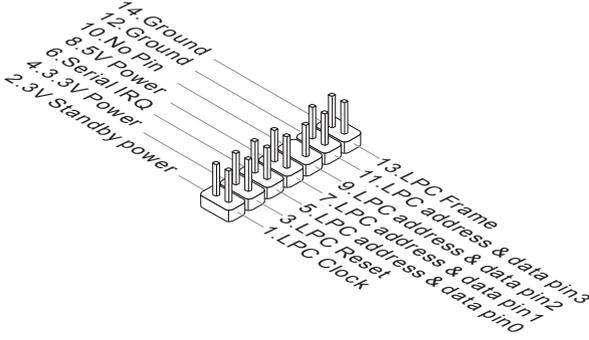
전면 패널 커넥터: JFP1, JFP2

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 대한 전기 연결에 사용됩니다. JFP1은 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.



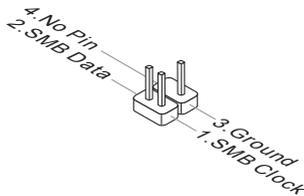
TPM 모듈 커넥터: JTPM1

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈(옵션)에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하십시오.



GreenPower Genie 커넥터: JSMB1 (옵션)

이 커넥터는 GreenPower Genie (옵션)에 연결됩니다.



버튼

메인보드는 컴퓨터의 기능을 설정할 수 있도록 다음 버튼을 제공합니다. 이 절에서는 버튼의 사용으로 메인보드의 기능을 변경하는 방법을 설명합니다.

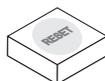
전원 버튼

이 전원 버튼은 시스템을 켜거나 끄는 데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 켜거나 끄십시오.



리셋 버튼

이 리셋 버튼은 시스템을 리셋하는 데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 리셋하십시오.



OC Genie 버튼

이 버튼은 시스템이 자동-오버클럭에 사용됩니다. 시스템이 끄기 상태에서 이 버튼을 눌러 OC Genie 기능을 활성화합니다. 한편, 버튼 불이 켜지고 잠급니다. 그리고 나서 시스템을 시작한 후에 오버클럭에 대한 최적의 값을 자동으로 감지합니다. 이 OC Genie 기능을 종료하려면 시스템을 끄기 후에 이 버튼을 다시 눌러 버튼의 불을 끄지고 잠금 해제됩니다. 시스템은 다음에 부트를 위해 이 값을 복원할 것입니다.

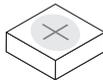


중요 사항

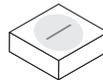
- OC Genie 기능을 사용하려면 DDR3 1333이상의 메모리를 설치해주시고 낮은 방열판/쿨러를 장비하십시오.
- OC Genie 오버클럭 범위 및 손상 또는 OC Genie 오버클럭 행동으로 인해 위험은 보증하지 않습니다.
- BIOS 설정에서 OC Genie 기능을 종료할 수 있습니다. 미래의 사용을 위해 BIOS에 있는 오버클럭 프로파일에 OC Genie 구성을 저장하십시오.
- OC Genie를 사용하여 일으키는 위험은 사용자의 책임입니다. MSI 회사는 오버클로킹을 보증하지 않습니다.

베이스 클럭 제어 버튼

이 버튼은 사용하여 베이스 클럭 주파수를 높이거나 줄일 수 있습니다. 시스템이 보통 운영 상태에서 이 플러스/마이너스 버튼을 한번 누르면 베이스 클럭 주파수가 0.5 MHz를 높이/줄일 수 있습니다.



플러스 버튼



마이너스 버튼

스위치

이 메인보드는 컴퓨터의 기능을 설정할 수 있도록 다음 스위치를 제공합니다. 이 절에서는 스위치의 사용으로 메인보드의 기능을 변경하는 방법을 설명합니다.

오버-전압 스위치

스위치를 변경하여 BIOS 설정에서 조절을 위해 CPU/ QPI/ DDR/ IOH의 전압 범위를 늘릴 수 있습니다.



아래의 소개에 따라 CPU/ QPI/ DDR/ IOH의 전압 범위를 늘리십시오.



스위치 1 : CPU 전압을 늘림에 사용되고, "ON"로 전환하여 BIOS에서 CPU 전압 조정 범위를 늘릴 수 있습니다.



스위치 2 : QPI 전압을 늘림에 사용되고, "ON"로 전환하여 BIOS에서 QPI 전압 조정 범위를 늘릴 수 있습니다.



스위치 3 : DDR 전압을 늘림에 사용되고, "ON"로 전환하여 BIOS에서 DDR 전압 조정 범위를 늘릴 수 있습니다.



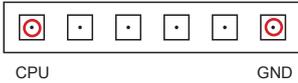
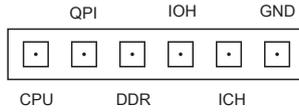
스위치 4 : IOH 전압을 늘림에 사용되고, "ON"로 전환하여 BIOS에서 IOH 전압 조정 범위를 늘릴 수 있습니다.

중요 사항

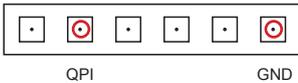
- OC Genie를 활성화하여 시스템 구성을 감지하려는 동시에 V-스위치의 아무 부분도 켜지 마십시오. 그렇다면 장치에 너무 많은 전압을 제공해야 하기 때문에 손상을 일으킬 수 있습니다.
- BIOS에서 CPU/ QPI/ DDR/ IOH 전압을 설치한 후에 멀티미터로 Voltage Check Point(전압 체크 포인트)를 조정하여 CPU/ QPI/ DDR/ IOH 전압을 체크할 수 있습니다. 아래의 소개를 참조하여 전압을 조정하십시오.

전압 체크 포인트: V-Check Point

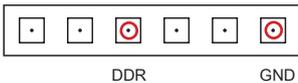
이 전압 체크 포인트 세트는 현재 CPU/ QPI/ DDR/ IOH/ ICH 전압을 조정에 사용됩니다.



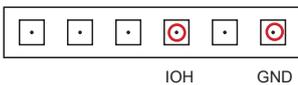
CPU 전압: 멀티미터를 사용하여 CPU 포인트 및 GND 포인트로 현재 CPU 전압을 조정합니다.



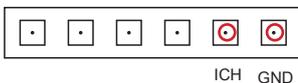
QPI 전압: 멀티미터를 사용하여 QPI 포인트 및 GND 포인트로 현재 QPI 전압을 조정합니다.



DDR 전압: 멀티미터를 사용하여 DDR 포인트 및 GND 포인트로 현재 DDR 전압을 조정합니다.



IOH 전압: 멀티미터를 사용하여 IOH 포인트 및 GND 포인트로 현재 IOH 전압을 조정합니다.

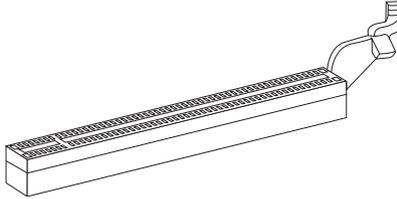


ICH 전압: 멀티미터를 사용하여 ICH 포인트 및 GND 포인트로 현재 ICH 전압을 조정합니다.

슬롯

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 슬롯

PCI Express 슬롯은 PCI Express 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.



PCI Express x16 슬롯



PCI Express x1 슬롯

중요 사항

확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원 공급장치의 플러그를 뽑으십시오. 점퍼, 스위치 또는 BIOS 구성과 같은 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 설정을 구성하려면 확장 카드의 설명서를 읽으십시오.

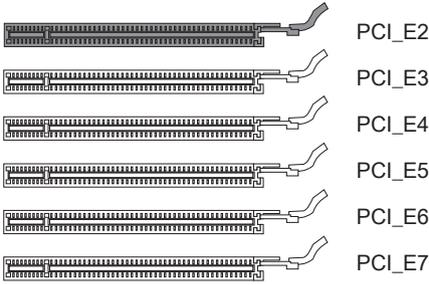
PCIe x16 슬롯 패포 규칙

PCIe x16 패포 규칙에 대한 정보는 아래의 소개를 참조하십시오. 설치된 확장 카드가 있는/없는 PCIe x16 레인 구성에 대한 자세한 정보는 아래의 테이블을 참조하십시오.

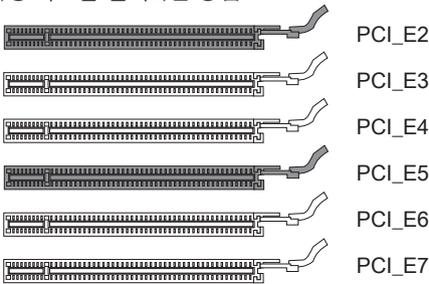
	확장 카드 1개	확장 카드 2개	확장 카드 3개		확장 카드 4개	확장 카드 5개	확장 카드 6개
PCI_E2 레인	x16 @	x16 @	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E3 레인	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @	x4 @
PCI_E4 레인	x0	x0	x0	x8 @	x8 @	x4 @	x4 @
PCI_E5 레인	x16	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E6 레인	x0	x0	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x4 @
PCI_E7 레인	x0	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @

@ : 확장 카드 설치된 슬롯

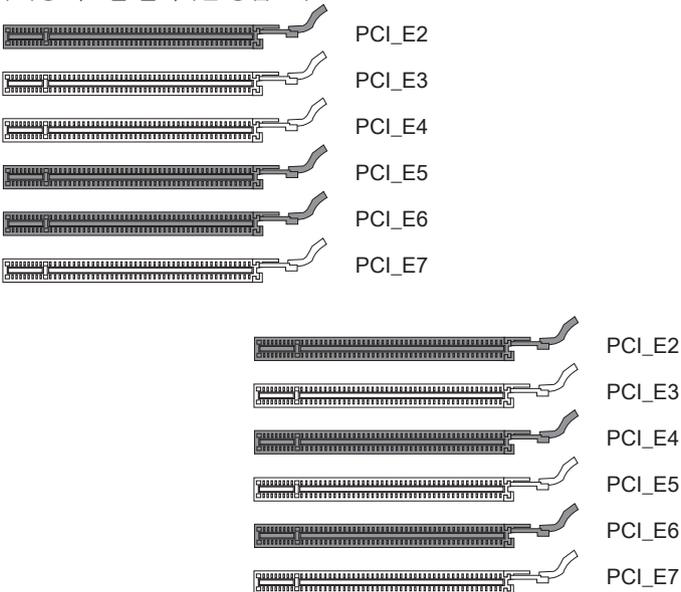
■ 1개의 확장 카드를 설치하는 방법:



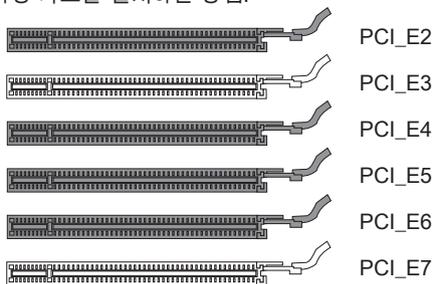
■ 2개의 확장 카드를 설치하는 방법:



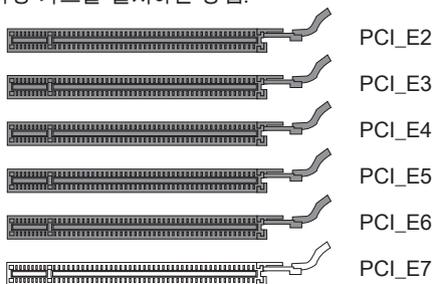
■ 3개의 확장 카드를 설치하는 방법 2개:



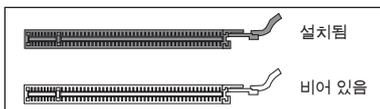
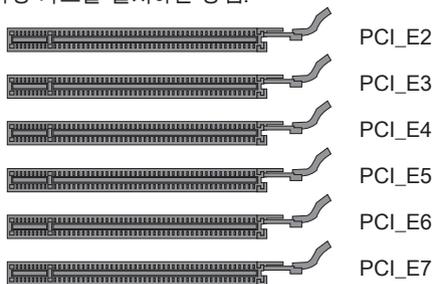
■ 4개의 확장 카드를 설치하는 방법:



■ 5개의 확장 카드를 설치하는 방법:



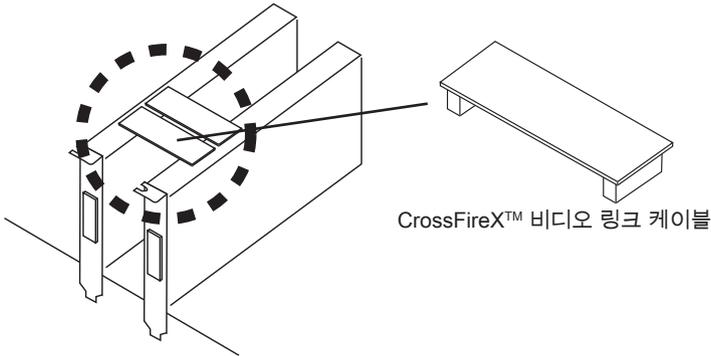
■ 6개의 확장 카드를 설치하는 방법:



ATI CrossFire™ (Multi-GPU) 기술

ATI CrossFire™는 우수한 멀티 GPU 성능의 게임용 플랫폼입니다. 게임 위주의 파워를 활성화하기 위해, ATI CrossFire™ 기술에서는 2개 이상의 개별 그래픽 프로세서가 함께 작동하도록 함으로써 시스템 성능을 높입니다. ATI CrossFire™ 기술에서는 시스템의 그래픽 성능을 확장할 수 있습니다. 이 기술에서는 시스템의 그래픽 파워를 필요에 따라 크기를 조절할 수 있기 때문에 2개 이상의 ATI Radeon™ HD 그래픽 카드를 지원함으로써 확장성이 가장 좋은 게임용 플랫폼이라고 할 수 있습니다. 메인보드는 소프트웨어에 의해 CrossFire™ 모드를 자동 인식할 수 있으며, 따라서 BIOS에서 CrossFire™를 직접 활성화할 필요가 없습니다. 다음은 2-웨이 CrossFire™ 설치에 대한 자세한 설명입니다.

1. 2개의 ATI Radeon™ HD 그래픽 카드를 PCI_E2 & PCI_E5 슬롯에 설치합니다.
2. 2개의 카드가 설치된 상태에서, CrossFire™ Video Link 케이블은 이러한 2개의 그래픽 카드의 상단에 있는 골든 핑거를 연결해야 합니다(아래의 그림 참조). 2개의 그래픽 카드를 설치했다라도 첫 번째 PCI_E x16 슬롯에 설치된 그래픽 카드의 비디오만 출력됩니다. 따라서 모니터를 이 그래픽 카드에 연결하기만 하면 됩니다.

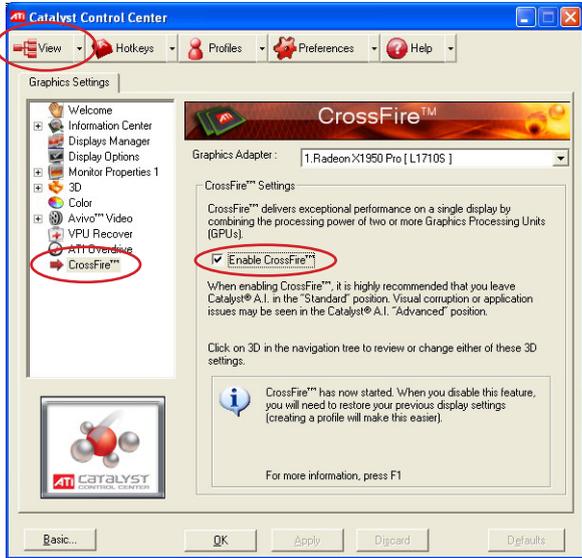


중요 사항

- CrossFire™ 모드용으로 그래픽 카드를 두개 설치하려면 다음을 유의하십시오. a. 이 그래픽 카드의 브랜드 및 사양이 동일해야 합니다. b. 이 그래픽 카드가 PCI_E2 & PCI_E5 슬롯에 설치됩니다.
- 그래픽 카드의 전원 커넥터가 올바른 전원 공급장치를 JPWR4 커넥터(또는 그래픽 카드의 전원 커넥터)에 연결되어 그래픽 카드의 작동이 안정적인지 확인하십시오.
- Service Pack 2 (SP2)를 갖춘 Windows® XP 및 Windows® XP Professional x64 Edition 및 Windows® Vista & Windows® 7만 CrossFire™ 기능을 지원합니다.

3. 하드웨어와 소프트웨어가 모두 적절하게 설정 및 설치되었다면 시스템을 재부팅하십시오. O.S.로 들어간 다음 바탕화면에서 "Catalyst™ Control Center" 아이콘을 클릭하십시오. CrossFireX™ 작동을 위해 필요한 Catalyst™ Control Center에 설정이 들어 있습니다. 다음 내용이 Catalyst™ Control Center에 표시됩니다:

보기 드롭다운 메뉴에서 고급 보기를 선택합니다.



중요 사항

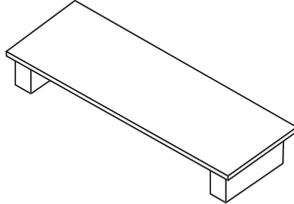
CrossFireX™ 시스템에 다음 네가지 화면 모드가 있습니다.

- SuperTiling
- Scissor Mode (드래곤 전투 모드)
- Alternate Frame Rendering (프레임 무작위 선택)
- Super Anti-aliasing (수퍼 앤티 앨리어싱).

자세한 내용은 제조업체의 그래픽 카드 설명서를 참조하십시오.

NVIDIA® SLI 기술

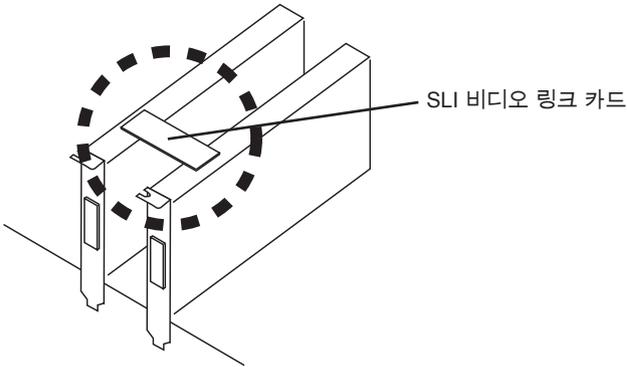
NVIDIA® SLI (Scalable Link Interface) 기술을 통해 두 개의 GPU가 한 시스템 내에서 협력하여 작동되도록 함으로써 싱글 그래픽 카드보다 두 배의 성능을 얻을 수 있습니다. 이 기술을 활용하려면 두 개의 그래픽 카드가 SLI 비디오 링크 카드에 의해 연결되어야 합니다.



SLI 비디오 링크 카드

그래픽 성능 향상을 위해 SLI 모드를 사용하려고 할 경우 다음 지침을 참조하십시오.

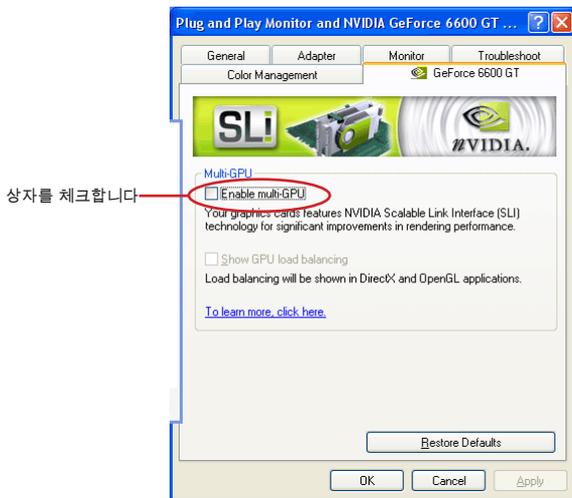
1. PCI_E2 & PCI_E5 슬롯에 그래픽 카드 2개를 설치합니다. 2개의 카드가 설치된 상태에서, SLI 비디오 링크 카드에 이 2개의 그래픽 카드의 상단에 있는 골든 핑거를 연결해야 합니다(아래의 그림 참조). 2개의 그래픽 카드를 설치했다라도 첫 번째 카드에서 비디오만 출력됩니다. 따라서 모니터를 첫 번째 PCI Express 카드에 연결하기만 하면 됩니다.



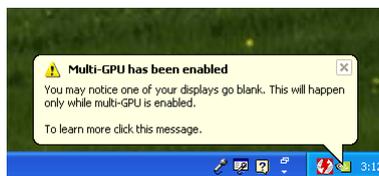
중요 사항

- 이 절에 표시된 사진은 참조 목적으로만 사용된 사진입니다. 메인보드의 외양은 구입한 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 2개의 x16 그래픽 카드를 설치할 경우 해당 그래픽 카드는 동일 상표와 동일 규격이어야 합니다.
- 그래픽 카드의 전원 커넥터가 올바른 전원 공급장치를 JPWR4 커넥터(또는 그래픽 카드의 전원 커넥터)에 연결되어 그래픽 카드의 작동이 안정적인지 확인하십시오.

2. 하드웨어 설치가 완료되면 시스템을 다시 시작하여 NV SLI 드라이버/유틸리티를 설치합니다. 구성 패널은 멀티 CPU 제어용으로 제공됩니다. Enable multi-GPU 상자를 선택하면 온보드 그래픽 카드에 SLI 기능을 사용할 수 있습니다(멀티 GPU 설정에 관한 자세한 내용은 그래픽 카드 설명서를 참조하십시오).



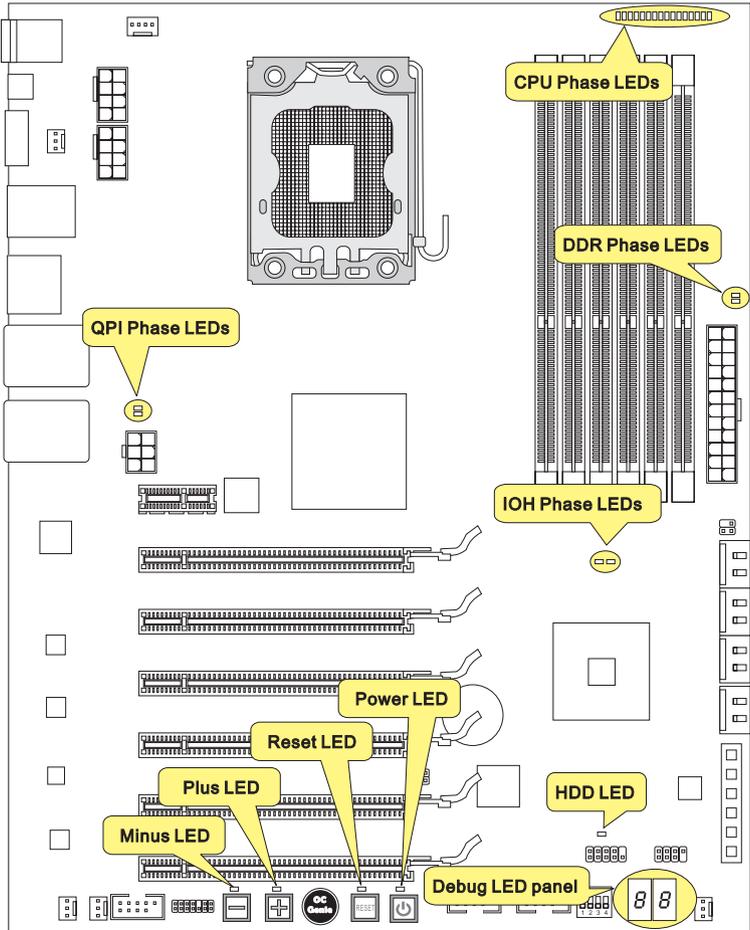
3. 시스템을 다시 시작하면 멀티 GPU가 활성화되었다는 팝업 메시지가 시스템 트레이에 표시됩니다.



중요 사항

그래픽 카드 한 개를 제거하고 SLI 기능을 정지시키려고 할 경우 "MultiGPU" 기능을 비활성화해야 합니다.

LED 상태 표시기 (옵션)



CPU Phase LEDs (CPU 위상 LEDs)

이 LED는 현재의 CPU 전원 위상 모드를 표시합니다. 아래의 지시 사항을 읽고 따르십시오.

■ 불 □ 꺼짐

■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 1위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 2위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 3위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 4위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 5위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 6위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 7위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 8위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 9위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 10위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 11위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 12위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 13위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 14위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 15위상 전원 모드에 있습니다.
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU는 16위상 전원 모드에 있습니다.

QPI Phase LEDs (QPI 위상 LED)

이 LED는 현재의 QPI 전원 위상 모드를 표시합니다. 아래의 지시 사항을 읽고 따르십시오.

■ 불 □ 꺼짐

□	QPI는 1위상 전원 모드에 있습니다.	■	QPI는 2위상 전원 모드에 있습니다.
■		■	

IOH Phase LEDs (IOH 위상 LEDs)

이 LED는 현재의 IOH 전원 위상 모드를 표시합니다. 아래의 지시 사항을 읽고 따르십시오.

■ 불 □ 꺼짐

■ □	IOH는 1위상 전원 모드에 있습니다.	■ ■	IOH는 2위상 전원 모드에 있습니다.
-----	-----------------------	-----	-----------------------

DDR Phase LEDs (DDR 위상 LEDs)

이 LED는 현재의 DDR 전원 위상 모드를 표시합니다. 아래의 지시 사항을 읽고 따르십시오.

■ 불 □ 꺼짐

□ ■	DDR는 1위상 전원 모드에 있습니다.	■ ■	DDR는 2위상 전원 모드에 있습니다.
-----	-----------------------	-----	-----------------------

HDD LED

하드 드라이브가 운영하는 경우 불을 켜집니다.

Power LED (전원 LED)

매 번에 전원 버튼을 눌러 이 기능이 사용되며 전원 LED가 깜빡입니다.

Reset LED (리셋 LED)

매 번에 전원 버튼을 눌러 이 기능이 사용되며 리셋 LED가 깜빡입니다.

Minus LED (마이너스 LED)

매 번에 마이너스 버튼을 눌러 이 기능이 사용되며 리셋 LED가 깜빡입니다.

Plus LED (플러스 LED)

매 번에 플러스 버튼을 눌러 이 기능이 사용되며 리셋 LED가 깜빡입니다.

Debug LED Panel (디버그 LED 패널)

디버그 LED 메시지에 대한 자세한 내용은 아래의 표를 참조하십시오.

위치	상태
FF	전원 켜기 및 최초 CPU 초기화.
C0, C1, C2	초기 CPU 초기화.
C4, C6	칩셋 초기화.
D4, D5	메모리 초기화.
08	키보드 초기화.
2A, 31	온보드 장치 초기화. 옵션 ROM(VGA 및 RAID 옵션 ROM)을 BIOS에서 메모리로 로드.
37	사인은 메시지, CPU 정보, 설정 키 메시지 및 OEM 특정 정보 표시.
38	USB 장치 및 기타 장치 초기화.
3C	칩셋 레지스터의 중간 POST 초기화. 기타 장치 인식(병렬 포트, 시리얼 포트 및 CPU의 코프로세서 등)
75, 78	INT 13 장치 및 IPL 장치 초기화. (SATA/ PATA HDD 및 CD/DVD ROM 포함).
87	설정 화면 시작. 필요한 경우/요청된 경우 BIOS 설정.
A4	필요한 경우 구성 디스플레이에서 사용자 입력 대기.
A7	활성화된 경우 시스템 구성 표시.
B1	ACPI(고급 구성 및 전원 인터페이스)용 시스템 콘텍스트 저장. OS 로더(INT 19H)에 제어 제공 준비.
00	OS 로더(일반적으로 INT 19H)로 제어 전달.
AA	OS 시작.

BIOS 설정

이 장에서는 BIOS 설정 프로그램에 대한 기본 정보를 제공하여 사용자가 최적의 사용을 위해 시스템을 구성할 수 있도록 도와줍니다. 다음의 경우 설정 프로그램을 실행해야 합니다.

- 시스템을 부팅하는 동안 화면에 오류 메시지가 나타나고 BIOS 설정을 실행하도록 요청하는 경우.
- 사용자 정의된 기능을 사용하기 위해 기본 설정을 변경하려는 경우.

중요 사항

- 이 장에서 설명되는 각 BIOS 범주 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 계속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으며 참조용으로만 사용해야 합니다.
- 부팅 시 메모리 카운트 다음에 나타나는 첫 번째 행의 정보가 BIOS 버전입니다. 이는 대개의 경우 다음과 같은 형식으로 표시됩니다:

A7666IMS V1.0 042210 여기에서:

1번째 문자는 BIOS 마커로서, A = AMI, W = AWARD, P = PHOENIX입니다.

2~5번째 자리수는 모델 번호입니다.

6번째 문자는 칩셋 공급업체로서, I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD, V = VIA입니다.

7~8번째 문자는 고객으로서, MS = 모든 표준 고객입니다.

V1.0은 BIOS 버전입니다.

042210은 이 BIOS가 발표된 날짜입니다.

설정 시작

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, 키를 눌러 설정을 시작합니다.

Press DEL to enter SETUP

(DEL을 눌러 설정을 시작합니다.)

사용자가 응답하거나 설정을 입력하기 전에 메시지가 표시되면, 시스템을 껐다가 다시 켜거나 리셋 (RESET) 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

도움말 불러오기

설정 메뉴를 시작한 다음, 처음으로 표시되는 메뉴가 주 메뉴입니다.

주 메뉴

주 메뉴는 변경할 수 있는 설정 기능을 나열합니다. 화살표 키(↑↓)를 사용하여 항목을 선택할 수 있습니다. 강조 표시된 설정 기능의 온라인 설명이 화면의 하단에 표시됩니다.

하위 메뉴

오른쪽 그림과 같이 올바른 포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에 표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 하위 메뉴를 시작할 수 있다는 것을 의미합니다. 컨트롤 키(↑↓)를 사용하여 필드를 강조 표시하고 <Enter>를 눌러 하위 메뉴를 불러냅니다. 그리고 나서 컨트롤 키를 사용하여 값을 입력하고 하위 메뉴내에서 필드 간을 이동합니다. 주 메뉴로 돌아가려면, <Esc>를 누르기만 하면 됩니다.

일반 도움말 <F1>

BIOS 설정 프로그램은 일반 도움말 화면을 제공합니다. 간단히 <F1>을 누르기만 하면 어느 메뉴에서든지 이 화면을 불러낼 수 있습니다. 도움말 화면은 사용할 수 있는 적절한 키와 강조 표시된 항목에 대해 선택할 수 있는 항목을 나열합니다. <Esc>를 누르면 도움말 화면이 종료됩니다.

주 메뉴

BIOS CMOS 설정 유틸리티에 들어가면 주 메뉴가 화면에 표시됩니다. 주 메뉴의 설정 기능 및 두개 종료 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 화살표 키를 사용하여 항목 중 하나를 선택한 다음 <Enter>를 눌러 하위 메뉴를 수락하거나 또는 시작합니다.



▶ **Standard CMOS Features (표준 CMOS 기능)**

이 메뉴를 사용하여 시간, 날짜 등과 같은 기본 시스템 구성을 처리합니다.

▶ **Advanced BIOS Features (고급 BIOS 기능)**

이 메뉴를 사용하여 BIOS 특별 고급 기능의 항목을 설정합니다.

▶ **Integrated Peripherals (통합된 주변 장치)**

이 메뉴를 사용하여 통합된 주변 장치의 설정을 지정합니다.

▶ **Power Management Setup (전원 관리 설정)**

이 메뉴를 사용하여 전원 관리의 설정을 지정합니다.

▶ **H/W Monitor (H/W 모니터)**

이 항목은 PC의 건간 상태를 표시합니다.

▶ **Green Power**

이 메뉴를 사용하여 전원 위상을 지정합니다.

▶ **BIOS Setting Password (BIOS 설정 암호)**

이 메뉴를 사용하여 BIOS의 암호를 설정합니다.

▶ **Cell Menu (셀 메뉴)**

이 메뉴를 사용하여 주파수/전압 제어 및 오버클로킹의 설정을 지정합니다.

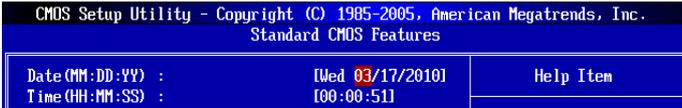
BIOS 설정 유틸리티를 시작할 때, 일반적 사용의 경우 다음 절차를 따르십시오.

1. Load Optimized Defaults(최적 기본값 로드): 컨트롤 키(↑↓)를 사용하여 Load Optimized Defaults 필드를 강조 표시한 다음 <Enter>를 누르면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

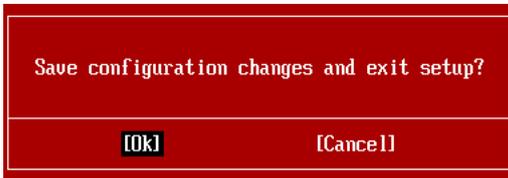


[OK(확인)]을 선택하고 Enter 키를 누르면 최적의 시스템 성능을 위한 기본 설정이 로드됩니다.

2. Setup Date/ Time(날짜/시간 설정): 표준 CMOS 기능 Standard CMOS Features을 선택한 다음 <Enter>를 눌러서 표준 CMOS 기능 메뉴로 들어갑니다. 날짜, 시간 필드를 조정합니다.



3. Save & Exit Setup(저장 및 설정 종료): 컨트롤 키(↑↓)를 사용하여 Save & Exit Setup 필드를 강조 표시한 다음 <Enter>를 누르면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

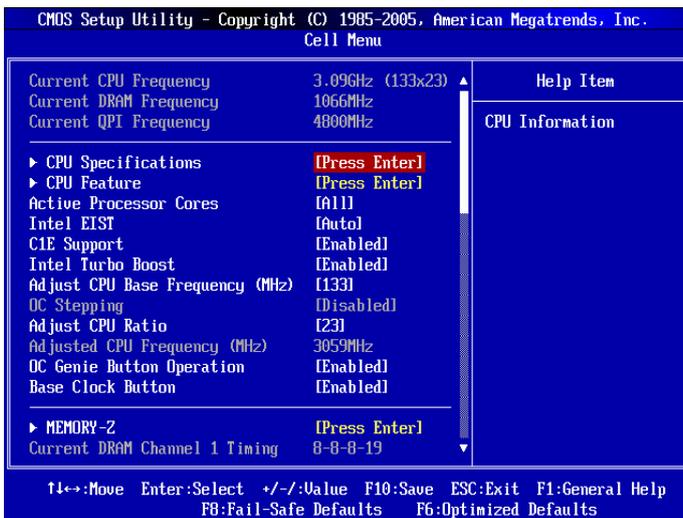


[OK(확인)] 키와 Enter 키를 눌러 구성을 저장한 다음 BIOS 설정 유틸리티를 종료합니다.

중요 사항

위의 구성은 일반적 사용의 경우에만 해당됩니다. BIOS 설정에 대한 세부사항은 MSI 웹사이트의 영어 설명서의 완전한 버전을 참조하십시오.

4. Cell Menu Introduction(셀 메뉴 소개): 메인보드를 오버클로킹하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.



중요 사항

사용자가 칩셋에 익숙할 경우에만 이 설정을 변경하십시오.

▶ Current CPU / DRAM / QPI Frequency (현재 CPU / DRAM / QPI 주파수)

이 항목은 CPU, 메모리 및 QPI 속도의 현재 주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▶ CPU Specifications (CPU 사양)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 CPU에 대한 정보를 표시합니다.

▶ CPU Technology Support (CPU 기술 지원)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 기술을 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▶ CPU Feature (CPU 기능)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▶ Intel EIST

향상된 Intel SpeedStep 기술로 인해 배터리 또는 AC 전원 중 어떤 방식으로 컴퓨터를 실행되는냐에 따라 마이크로프로세서의 성능 레벨을 설정할 수 있습니다. 기술을 지원하는 CPU를 설치하면 이 필드가 표시됩니다.

▶ Intel C-State

C-state는 시스템이 유휴 상태에 있는 동안 프로세서의 전원 소비량을 크게 줄여 주는 전원 관리 상태입니다. C-state 기술을 지원하는 CPU를 설치하면 이 필드가 표시됩니다.

▶ **C State Package Limit Setting (C-State 패키지 제한 설정)**

이 필드에서 C-state 레벨을 선택할 수 있습니다. Auto(자동)으로 설정하는 것을 권장합니다.

▶ **C1E Support (C1E 지원)**

이 항목은 아이들(PC가 아무 동작도 하지 않을 경우)일 경우 CPU의 전력을 설정하는 항목입니다. 모든 프로세서가 지원하지 않지만, 지원할 경우 향상된 전력관리를 사용할 수 있습니다(C1E).

▶ **OverSpeed Protection (과속 방지)**

과속 방지 기능은 전력 소비와 마찬가지로 현재 CPU 드로를 감시할 수 있습니다. 일정한 속도를 넘으면 이 프로세서는 자동으로 클럭 속도를 줄입니다. CPU를 오버클럭하려면 [Disabled(사용 안함)]으로 설정하십시오.

▶ **Hyper-Threading Function (하이퍼-스레딩 기능)**

프로세서가 하이퍼-스레딩 기술(Hyper-Threading technology)을 지원하면, 사용자의 응답시간을 최소화 할 수 있도록 연산기능을 분배할 수 있습니다. 이 기술은 프로세서 안의 물리적인 두 개의 코어(Core)에 각각 두 개의 논리적인 프로세서를 두어 실시간으로 가상적인 연산을 분배할 수 있습니다. 이 방법을 활용하면, 시스템의 연산능력을 극대화 할 수 있습니다. 만약 이 기능을 사용하지 않을 경우 프로세서(CPU)는 하나의 코어에서 하나의 작업만 수행하게 됩니다. HT 기술을 지원하지 않는 프로세서를 사용할 경우 'disable(사용안함)'으로 설정하는 것을 권장하며, 무리하게 활용할 경우 시스템에 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다.

중요 사항

하이퍼-스레딩 기술을 활성화하기 위해서는 아래에서 제시되는 모든 구성물이 갖추어져야 합니다:

- CPU: HT 기술을 지원하는 Intel® 프로세서;
- 칩셋: HT 기술을 지원하는 Intel® 칩셋;
- BIOS: HT 기술을 활용할 수 있는 BIOS;
- OS: HT 기술을 지원하는 운영체제.

하이퍼-스레딩 기술에 대해 보다 많은 정보를 원하면, 다음 사이트를 방문하세요:

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm

▶ **Execute Bit Support (XD Bit 지원)**

Intel의 XD Bit(Execute Disable Bit) 보안 기능을 지원해 운영체제에 대한 '버퍼 오버플로우' 공격 등 바이러스와 악성 코드에 대해 시스템을 보안하고, 실행 및 네트워크의 다른 시스템에 전염되는 것을 차단합니다. 이 기능은 프로세서(CPU)가 메모리 영역에 존재하는 어플리케이션의 실행여부를 결정하는 것으로, 악의적인 웜(혹은 바이러스)가 버퍼영역에 코드화되어 침입할 경우, 프로세서는 연산을 차단해, 시스템이 손상이나 웜의 확산을 방지합니다.

▶ **Set Limit CPUID MaxVal to 3 ('CPUID MaxVal'을 최대 3으로 제한)**

XP/VISTA 이전의 운영체제를 지원하기 위한 항목으로 최대 CPUID 값을 0에서 3사이로 제한할 수 있는 항목입니다. XP나 VISTA 운영체제 사용시에는 사용하지 마십시오.

▶ **Intel Virtualization Tech (Intel 가상화 기술)**

이 항목은 Intel 가상화 기술을 활성화/비활성화 할 수 있는 항목입니다. 보다 자세한 정보는 Intel의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

▶ **Base Clock Button (베이스 클럭 버튼)**

이 항목을 사용하여 베이스 클럭 버튼 기능을 활성화/비활성화할 수 있습니다.

▶ **MEMORY-Z (메모리-Z)**

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▶ **DIMM1~6 Memory SPD Information (DIMM1~6 메모리 SPD 정보)**

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.

▶ **Current DRAM Channel1/2/3 Timing (현재 DRAM 채널 1/2/3 타이밍)**

이 항목은 설치된 DRAM 타이밍을 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▶ **DRAM Timing Mode (DRAM 타이밍 모드)**

DRAM 모듈의 SPD (시리얼 존재 감지) EEPROM에 의해 DRAM 타이밍을 제어하는 지어던지 선택합니다. [Auto (자동)]으로 설정하면 SPD 구성을 기준으로 하는 BIOS에 의해 DRAM 타이밍 및 다음 “고급 DRAM 구성” 하위 메뉴를 판별할 수 있습니다. [Manual(수동)]으로 설정하면 사용자가 DRAM 타이밍 및 다음 “고급 DRAM 구성” 하위 메뉴를 수동으로 설정할 수 있습니다.

▶ **Advance DRAM Configuration (고급 DRAM 구성)**

<Enter>키를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 1T/2T Memory Timing (CH1/ CH2/ CH3 또는 CH1-3 1T/2T 메모리 타이밍)**

이 항목은 SDRAM 명령 대기 시간을 제어합니다. [1]를 선택하면 SDRAM 신호 컨트롤러가 1N (N=클럭 사이클) 속도로 실행됩니다. [2]를 선택하면 SDRAM 신호 컨트롤러가 2N 속도로 실행됩니다.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 CAS Latency (CH1/ CH2/ CH3 또는 CH1-3 CAS 대기 시간) (CL)**

SDRAM이 읽기 명령을 받아서 이 명령을 시작하기 전에 (클럭 사이클의) 타이밍 지연을 결정하는 CAS 대기 시간을 제어합니다.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 또는 CH1-3 tRCD**

DRAM이 재충전되면 행과 열이 따로 분리됩니다. 이 설정 항목을 사용하면 RAS(열 주소)에서 CAS(행 주소)로의 변환 타이밍을 결정할 수 있습니다. 클럭 사이클이 짧을수록 DRAM 성능이 빨라집니다.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 또는 CH1-3 tRP**

이 설정은 사전에 충전할 수 있는 RAS 사이클 수를 제어합니다. DRAM 재충전 이전에 RAS가 충전 시간을 충분히 갖지 못할 경우, 충전이 불충분해서 DRAM이 데이터를 보존하지 못할 수 있습니다. 이 항목은 시스템에 동기화 DRAM이 설치된 경우에만 적용됩니다.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 또는 CH1-3 tRAS**

이 설정은 RAS가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▶ **CH1/ CH2/ CH3 또는 CH1-3 tRFC**

이 설정은 RFC가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▶ ClockGen Tuner (ClockGen 튜너)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▶ CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control (CPU 진폭 제어/ PCI Express 진폭 제어)

이 항목을 사용하여 CPU/ PCI Express 클럭 진폭을 선택할 수 있습니다.

▶ CPU CLK Skew/ MCH CLK Skew (CPU CLK 스큐/ MCH CLK 스큐)

이 항목은 CPU/ MCH 노스 브릿지 칩셋 클럭 스큐를 선택하는 데 사용됩니다. 이 항목은 CPU가 높은 오버클로킹 성능에 도달하는 데 도움이 될 수 있습니다.

▶ Adjust PCI-E Frequency (PCI-E 주파수 조정) (MHz)

이 필드에서 PCIE 주파수(MHz)를 선택할 수 있습니다.

▶ VDroop Control (VDroop 제어)

이 항목을 사용하여 VDroop 제어 모드를 선택할 수 있습니다.

▶ CPU Voltage (V)/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ IOH Voltage (V)/ IOH PCIE Voltage (V)/ ICH Voltage (V)

이 항목은 CPU, 메모리 및 칩셋의 전압 조정에 사용됩니다.

▶ Spread Spectrum (대역 확산)

메인보드의 클럭 생성기가 펄스화되면 펄스의 극치값(스파이크)이 전자파 장애를 일으킵니다. 대역 확산 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI를 줄여줌으로써 그 결과 펄스의 스파이크가 평탄한 곡선으로 줄어듭니다.

중요 사항

- EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 [Disabled(사용 안함)]로 설정합니다. 그러나 EMI로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 위해 대역 확산 값을 선택하십시오.
- 대역 확산 값이 클수록 EMI는 감소되지만 시스템의 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 대역 확산 값은 해당 지역의 EMI 규정을 참조하십시오.
- 사소한 지터조차도 클럭 속도를 일시적으로 상승시키면 오버클로킹한 프로세스를 고정시키는 원인이 될 수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역확산을 반드시 사용 안함으로 설정해야 합니다.

중요 사항

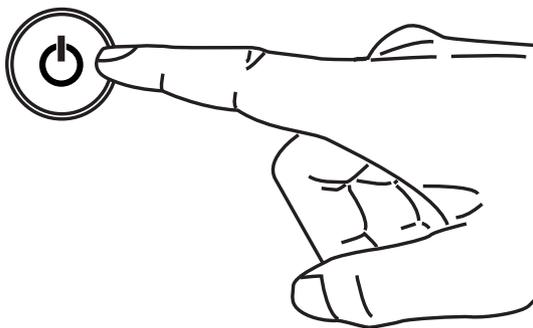
Failed Overclocking Resolution (오버클로킹 해상도 실패)

이 마더 보드는 오버클로킹을 전적으로 지원합니다. 그러나 사용자의 주변장치 및 구성 요소가 일부 특수 설정을 견딜 수 있는지 확인하십시오. 생산 사양을 초과하는 작업은 어떤 경우에도 바람직하지 않습니다. 적절하지 못한 작업으로 인한 위험이나 손상은 당사의 제품 보증을 받지 못합니다.

실패한 오버클로킹으로부터 시스템을 저장하는 두가지 방법...

- **Reboot (재부팅)**

전원 버튼을 눌러 시스템을 세 번 재부팅합니다. 전류가 다른 장치나 구성요소에 영향을 미치지 않도록 주의하십시오. 그러기 위해서 각각의 재부팅 사이에 10초 이상의 간격을 두는 것이 좋습니다.



네 번째 재부팅 시 BIOS가 이전 오버클로킹이 실패했음을 판별하고 자동으로 기본 설정으로 돌아갑니다. 화면에 다음 메시지가 나타나면 아무 키나 눌러 시스템을 평소대로 부팅하십시오.

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....

- **Clear CMOS (CMOS 초기화)**

자세한 내용은 "CMOS 데이터 초기화 방법" 부분을 참조하세요.

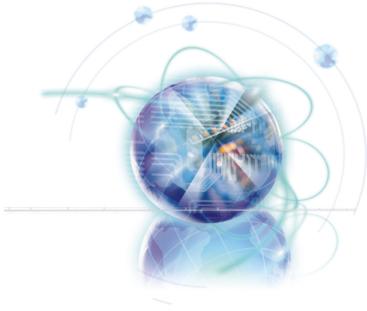
소프트웨어 정보

메인보드 패키지에 들어 있는 드라이버/유틸리티 DVD를 꺼내서 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 설치에 자동 실행되며, 드라이버나 유틸리티를 클릭하기만 하면 팝업 화면이 설치 완료를 표시합니다. 드라이버/유틸리티 DVD에는 다음이 포함됩니다:

- 드라이버 메뉴 : 사용 가능한 드라이버를 표시합니다. 원하는 대로 드라이버를 설치한 다음 장치를 활성화합니다.
- 유틸리티 메뉴 : 메인보드가 지원하는 소프트웨어 응용 프로그램을 표시합니다.

중요 사항

최신 드라이버 및 BIOS로 시스템 성능을 향상시키고 싶다면 MSI 웹사이트를 방문하십시오.



日本語

XPowerシリーズ

Asia version

マザーボードの仕様

対応プロセッサ

- LGA1366 インテル® Bloomfield™プロセッサ
(最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。 <http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2>)

QPI

- 最大6.4 GT/sまでをサポート

チップセット

- ノースブリッジ: インテル® X58チップセット
- サウスブリッジ: インテル® ICH10Rチップセット

対応メモリ

- DDR3-DIMMスロット6本搭載、DDR3 2133*(OC)/ 1800*(OC) /1600*(OC)/ 1333/ 1066 / 800 DRAMをサポート (最大24GB搭載可能)
- デュアルチャンネル/トリプルチャンネルメモリアクセス対応
*(最新のメモリモジュール対応状況については下記Webサイトをご参照ください。
<http://www.msi.com/index.php?func=testreport>)

LAN

- Realtek® RTL8111DLデュアルLAN 10/100/1000ファーストイーサネットをサポート

IEEE 1394

- VIA® VT6315NによるIEEE 1394ポート1基搭載

QuantumWaveオーディオカード

- Realtek® ALC889
- Azalia 1.0準拠
- 7.1チャンネルハイデフィニションオーディオコーデック (接続検知機能付き)
- 1x S/PDIF出力ヘッドをサポート
- リアパネルにはの同軸/光学S/PDIF出力ポートをサポート

SATA

- インテル® ICH10RによるSATA 3Gb/s (SATA1~6)ポート6基搭載
- Marvell® 88SE9128によるSATA 6Gb/s (SATA7~8)ポート2基搭載
- JMicron® JMB362によるESATAおよびESATA/USB 2.0コンボポート各1基搭載(I/Oパネル部)
- ホットプラグおよび非同期通知をサポート

USB 3.0

- NEC® uPD720200F1によるUSB 3.0ポート2基搭載

RAID

- SATA1~6はインテル® ICH10Rによるインテル® Matrix Storageテクノロジーをサポート (AHCI/ RAID 0/1/5/10)
- SATA7~8ポートはMarvell® 88SE9128によるRAID 0/ 1モードをサポート

コネクタ

■ I/Oパネル

- PS/2キーボードポート ×1
- PS/2マウスポート ×1
- クリアCMOSボタン ×1
- D-LED2パネルコネクタ ×1
- IEEE1394ポート ×1
- USB 2.0ポート ×5
- ESATAポート ×1
- ESATA/USB 2.0コンボポート ×1
- LANポート ×2
- USB 3.0ポート ×2

■ オンボード

- USB 2.0コネクタ ×2
- IEEE1394コネクタ ×1
- ケース開放センサーコネクタ ×1
- TPMモジュールコネクタ ×1
- リセットボタン ×1
- 電源ボタン ×1
- GreenPower Genieコネクタ ×1 (オプション)
- 過電圧スイッチ ×1
- セット電圧チェックポイント ×1
- OC Genieボタン ×1
- ベースクロックコントロールボタン ×2
- セットデバッグLEDパネル ×1

スロット

- PCI Express 2.0 x16スロット ×6 (PCI_E2とPCI_E5は最高PCIe x16の速度をサポート、PCI_E4とPCI_E6は最高PCIe x8の速度をサポート、PCI_E3とPCI_E7は最高PCIe x4の速度をサポートします。)
- PCI Express 1.1 x1スロット ×1

寸法

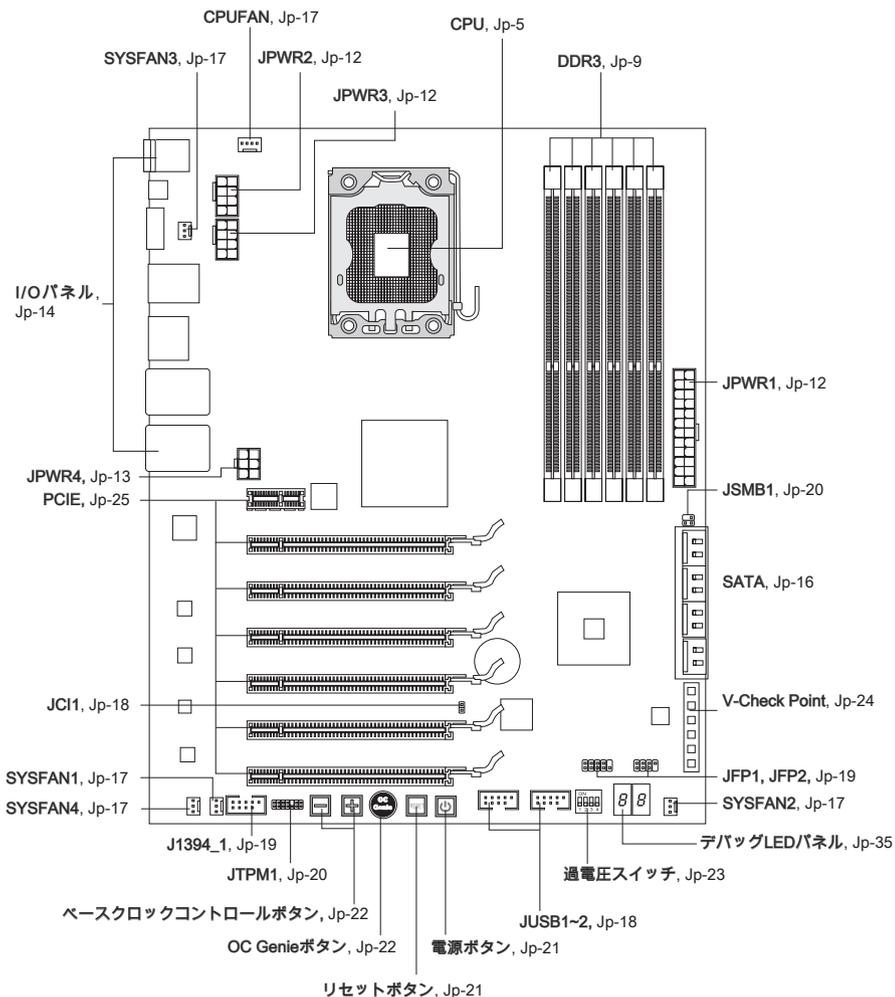
- ATX (24.4cm X 30.5 cm)

取付穴

- 9 穴

*製品について更に詳しい情報を求める場合は、弊社のWebサイトをご参照願います。<http://www.msi.com/index.php>

クイックコンポーネントガイド



CPUに関する注意事項

CPUを装着する際はCPUクーラーを必ず装着してください。CPUクーラーを装着しない、あるいは取り付けが不十分だと、システムを安定して動作させることができないばかりか、最悪の場合CPUに修復不可能なダメージを与える場合があります。CPUクーラーが装着されていない状態でシステムの電源をONにしないでください。最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。<http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2>

注意

過熱

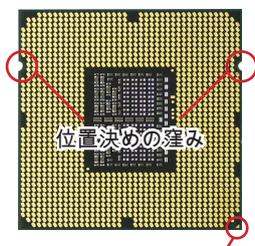
過熱が起るとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。

CPUの交換

CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。

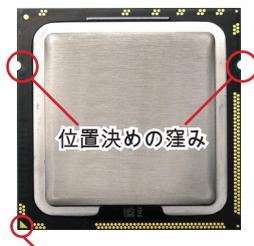
LGA 1366 CPUについて

LGA 1366 CPUの端子側



黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。

LGA 1366 CPUのヒートスプレッタ側。
効果的な放熱を行うために、シリコングリスを塗布してください。

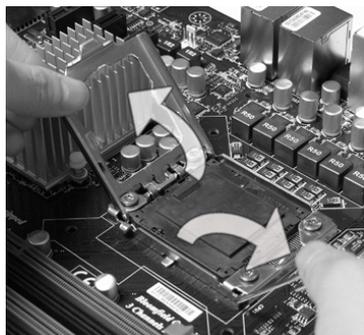
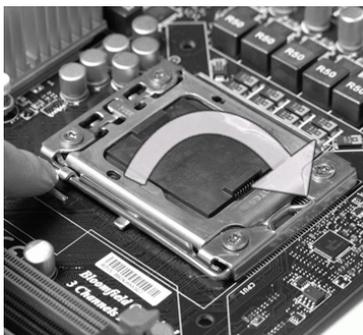


黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。

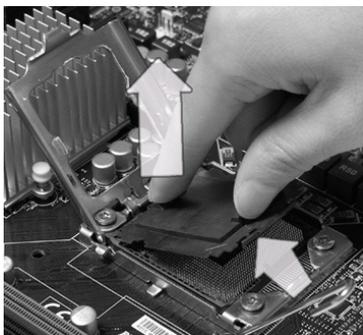
CPUおよびクーラーの装着

CPUを取り付ける際、過熱を防ぐためにCPUクーラーをCPUに密着するように確実に取り付けてください。また、CPUクーラーを装着する場合には必要に応じて適切な量のシリコングリスを塗布してください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUクーラーを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合はCPUやマザーボードなどの破損を招きます。

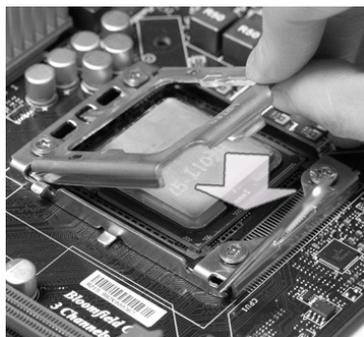
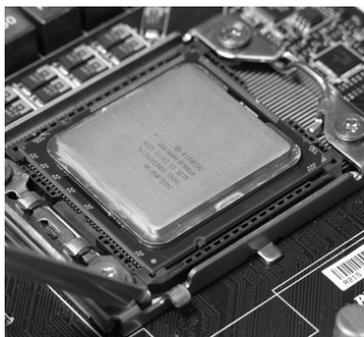
1. CPUのランドサイドカバー(端子保護カバー)を外します。
2. レバーと固定プレートを起こします。



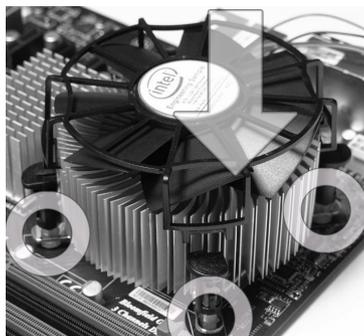
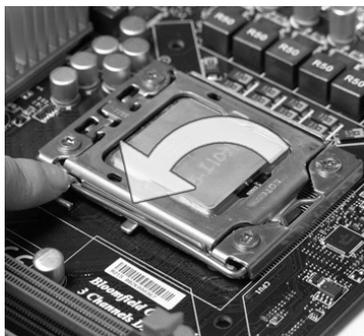
3. 下図のようにソケットのレバーはそのままにして保護するためのプラスチックカバーをゆっくり外します。
4. CPUのalignment key(位置決めの窪み)とCPUソケットの[出っ張り]を合わせて、装着する向きを決定します。



5. CPUが正しくソケットに収まっていることを確認してください。
6. ロードプレートをパッケージに掛けます。



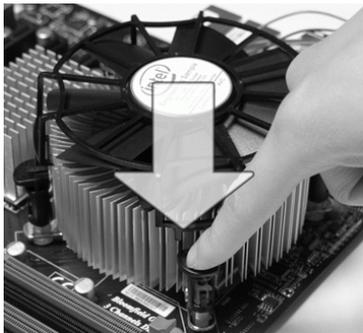
7. 固定プレートをゆっくり下ろした後、レバーを下ろしてフックに固定します。
8. CPUクーラーの四隅のピンをマザーボードの固定穴に合わせ、ゆっくりと押し込みます。



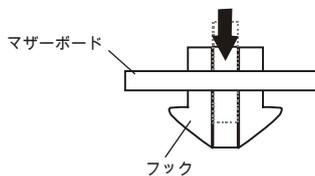
注意

- システムを起動する前に、CPUクーラーがしっかり装着されたことを確認してください。
- 損傷を防ぐために、CPUソケット内部のピンに触れないように注意してください。

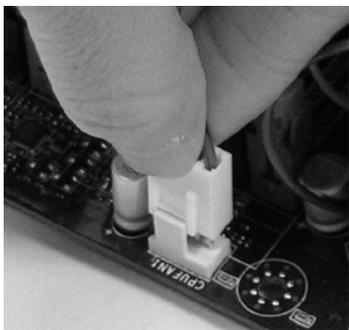
9. 位置が正しいことを確認したら、フックが固定されるまでプッシュピン押し込みます。



10. マザーボードを裏返して、裏面に出たプッシュピンの先が開き、正しくロックできたことを確認します。



11. 最後に、CPUファンケーブルをマザーボードのコネクタに接続します。

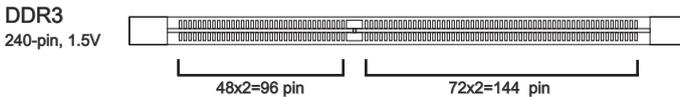


注意

- 使用するCPUにBIOSが対応していることを確認してください。
- ソケットに添付されるプラスチックカバーは捨てないでください。CPUを外して保管する場合は、このプラスチックカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。
- 本章の画像は参照用であり、お手元の製品と細部が異なる場合があります。
- CPUファンの装着についてはCPUファンの同梱の説明書をご参照ください。

メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。 <http://www.msi.com/index.php?func=testreport>



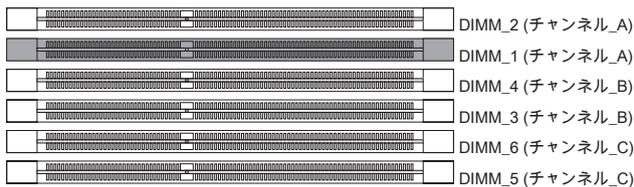
メモリソケットルール

以下のイラストを参照してください。

シングルチャンネルモードソケットルール

一つのメモリモジュールの場合には、メモリスロットはDIMM_1 (v1.0 PCBの場合はDIMM_A0)を優先的に使用してください。

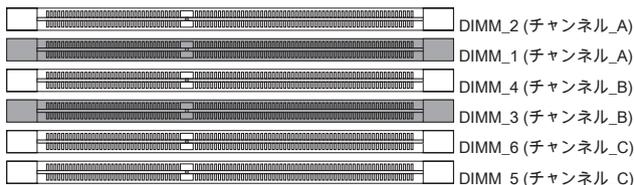
①



デュアルチャンネルモードソケットルール

デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセススピードを向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。

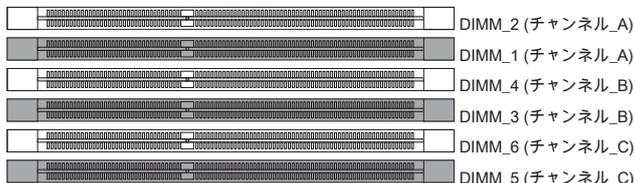
②



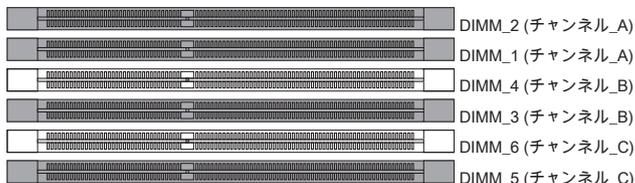
トリプルチャンネルモードソケットルール

トリプルチャンネルメモリアクセス方式は、三つのメモリデータバスを同時に使用してデータの読み書きを行うことになり、アクセススピードを向上させます。スリー以上のチャンネルを有効にするには、以下の方法3/ 4/ 5/ 6のような多くの組み合わせでメモリモジュールを装着でき、最高のシステム性能を実現します。

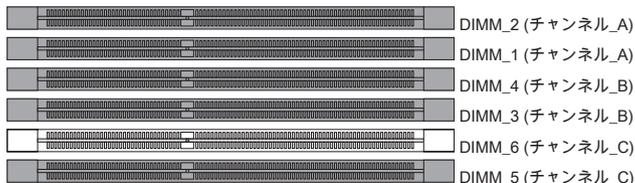
③



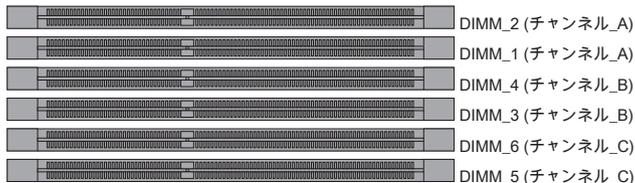
④



⑤



⑥



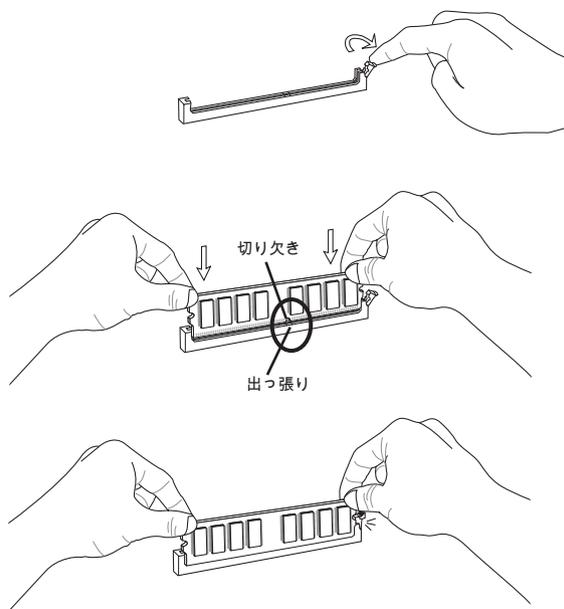
注意

- DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電氣的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。
- トリプルチャンネル/デュアルチャンネルアクセスを有効にするには同一メーカーの同一メモリモジュールを装着してください。

- メモリスロットはDIMM_1 (PCB v1.0バージョンにはDIMM_A0)を優先的に使用してください。
- チップセットの仕様により、各DIMMスロットに4GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(24GB未満での認識となります)

メモリモジュールの装着

1. メモリモジュール中央付近には左右非対称の場所に切り欠きが1ヶ所設けられており、このため間違った向きでは差し込めないように作られています。
2. DIMMメモリモジュールをDIMMスロットへ垂直に差し込むとDIMMスロットの両側にあるモジュール固定ラッチが自動的に閉じ、モジュールを固定します。
3. 電源投入前にモジュールが両側のモジュール固定ラッチによって正しく固定されているかどうかを必ず確認してください。



注意

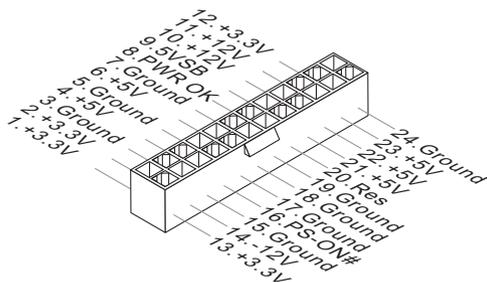
メモリモジュールがしっかりと装着されると、モジュールの端子部分が見えなくなります。

電源

ATX 24ピン電源コネクタ: JPWR1

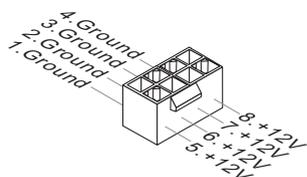
ATX電源24ピンコネクタを接続します。接続の際にはコネクタの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクタのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。

20ピンのATX電源も使用可能です。その場合には、11、12、23 & 24ピンは使用しません。



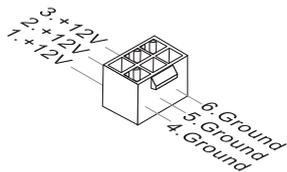
ATX 8ピン電源コネクタ: JPWR2/ JPWR3

この電源コネクタは、CPUに12Vの電源を供給します。



ATX 6ピン電源コネクタ: JPWR4

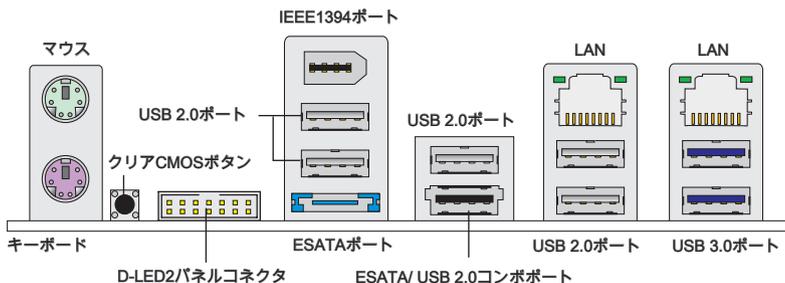
この電源コネクタは、グラフィックスカードに電源を供給します。



注意

- 本製品を動作させるには上記のコネクタを正しく接続する必要があります。
- 450W以上の良質な電源ユニットを使用してください。

I/Oパネル



▶ マウス/キーボード

マザーボードはPS/2[®]、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2[®]、マウス/キーボードミニDINコネクタが各一個ずつ設けられています。

▶ クリアCMOSボタン

製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

注意

CMOSクリアを行う際は、まずコンセントから電源コードを抜いてください。

このボタンを押して電源終了状態(G3)にCMOSデータをクリアすると、システムは自動的に起動します。

▶ D-LED2パネルコネクタ

このコネクタはD-LED2 (デバッグLED2)パネルを接続します (オプション)。パネルには情報を表示し、接続したシステムの状態あるいはモードを確認します。詳細についてはD-LED2クイックガイドを参照してください (オプション)。

▶ IEEE 1394ポート

バックパネルのIEEE1394ポートはIEEE1394デバイスを接続します。

▶ USB 2.0ポート

キーボードやマウスなどのUSB機器を本製品へ接続する場合に使用します。データ転送速度は最大480Mbit/sまでをサポートします (高速度)。

▶ESATAポート

ESATA (外付けSATA)ポートはESATAハードドライブを接続します。

▶ESATA/ USB 2.0コンボポート

ESATA/USB 2.0コンボポートはESATA接続の外付けドライブやUSBデバイスなどを接続する場合に使用します。

▶USB 3.0ポート

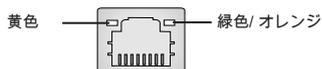
USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超速度)。

注意

USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。

▶LAN

コンピューターをネットワーク環境へ接続する際

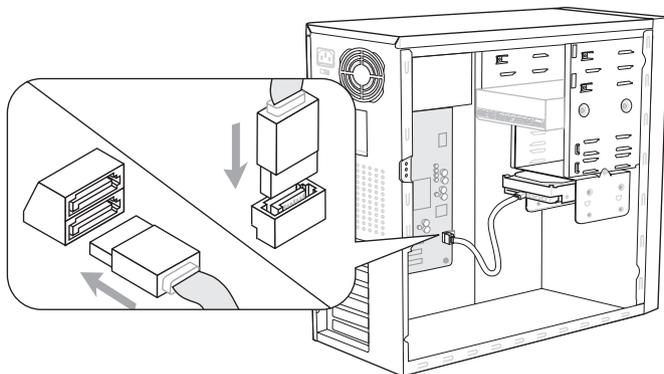


LED	色	LED状態	コンディション
左	黄色	Off	ネットワークに接続していません。
		On(点灯)	ネットワークに接続しています。
		On(点滅)	通信中です。
右	緑色	Off	10 Mbit/秒で通信しています。
		On	100 Mbit/秒で通信しています。
	オレンジ	On	1000 Mbit/秒で通信しています。

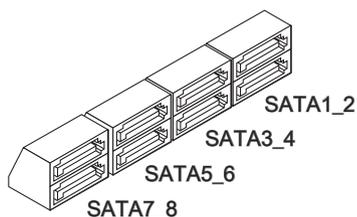
コネクタ

シリアルATAコネクタ: SATA1~8

このコネクタは高速シリアルATAインターフェイスポートです。一つのコネクタにつき、一つのハードディスクを接続することができます。



* 本図のMBレイアウトは参照用だけです。



SATA1~6 (3Gb/s)はインテル® ICH10Rへ接続しています。

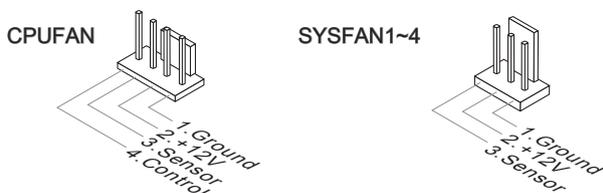
SATA7/ SATA8 (6Gb/s)はMarvell® 88SE9128へ接続しています。

注意

シリアルATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようにご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。

ファン電源コネクタ: CPUFAN, SYSFAN1~4

ファン電源コネクタは+12Vの冷却ファンをサポートします。接続する時に注意しなければならないのは、赤い線はプラスなので+12Vに、黒い線はアースなのでGNDに接続することです。また、本製品のシステムハードウェアモニタ機能を使用する場合はファンの回転数センサー機能がったファンを使用する必要があります。

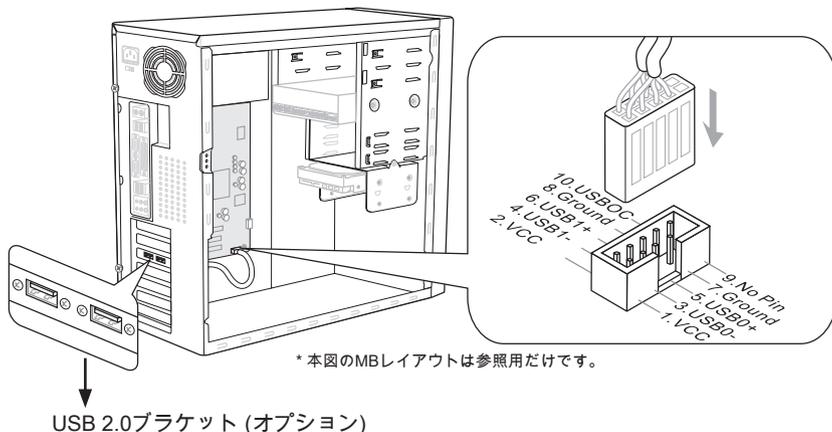


注意

- CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。
- CPUFANはファンコントローラーをサポートします。ユーザーはControl Centerユーティリティをインストールして、CPUFANの温度によって自動的にCPUFANの回転数をコントロールします。

フロントUSBコネクタ: JUSB1 / JUSB2

本製品にはインテル® I/O Connectivity Design Guideに準拠したUSB 2.0ピンヘッダーが搭載されています。USBは汎用性が非常に高く、外付けUSB HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタなど様々な機器の接続に対応しています。

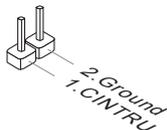


注意

VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。

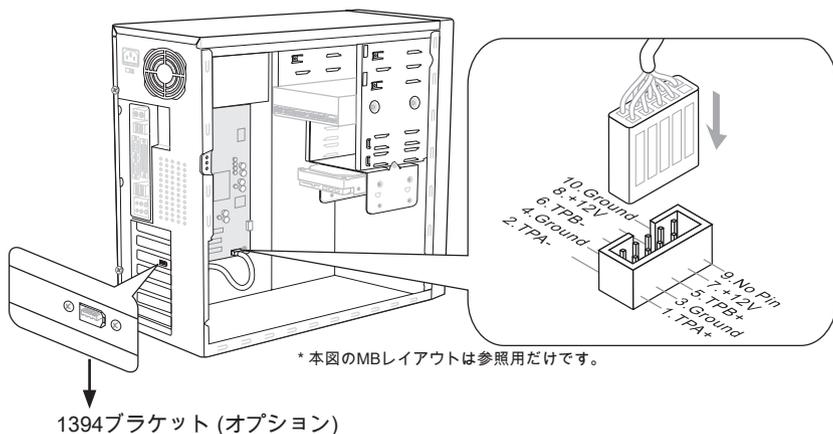
ケース開放センサーコネクタ: JCI1

このコネクタには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。



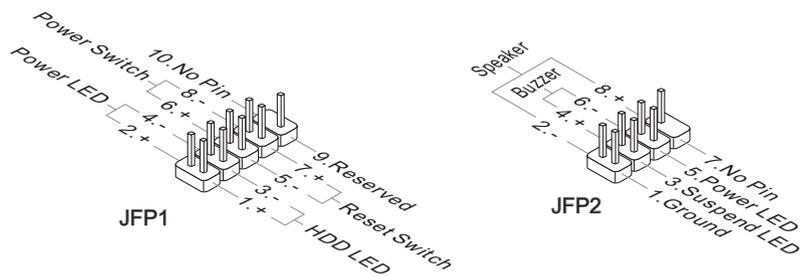
IEEE1394コネクタ: J1394_1

このコネクタはオプションのIEEE1394ブラケット経由でIEEE1394デバイスを接続します。



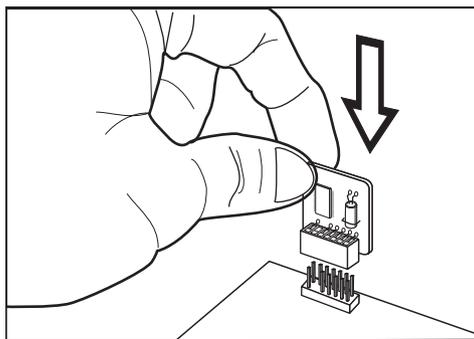
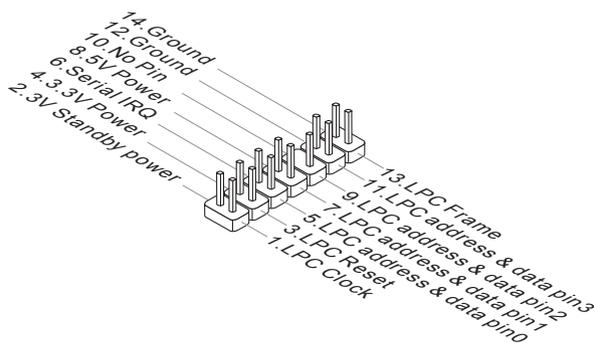
フロントパネルコネクタ: JFP1, JFP2

本製品にはケースのフロントパネルスイッチや電源 / HDDアクセスLED用にフロントパネルコネクタが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。



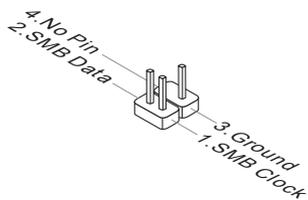
TPMモジュールコネクタ: JTPM1

このコネクタはTPM (Trusted Platform Module)モジュール(オプション)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットフォームホームマニュアルを参照してください。



GreenPower Genieコネクタ: JSMB1 (オプション)

GreenPower Genieを接続します (オプション)。



ボタン

本製品は以下のボタンを搭載しています。本章では各ボタンの機能を解説します。

電源ボタン

このボタンはシステムを起動/終了します。



リセットボタン

このボタンはシステムをリセットします。



OC Genieボタン

OC Genieは自動でシステムを最適なオーバークロック状態へ設定可能な技術です。システムの電源オフ状態の際にこのボタンを押してからシステムを起動させると、OC Genie機能が有効になるとともに、ボタンに明りが点きロックされます。起動後システムは自動的にオーバークロックの最適値を検知します。この機能を無効にした場合は、システムを終了した後再度ボタンを押してください。同時に、ボタンのライトが消え、ロックが解除され、システム設定がデフォルト値に戻ります。



注意

- OC Genie機能をご利用になる際には、DDR3-1333以上のメモリやオーバークロック動作に効果的の高い高性能ヒートシンク/クーラーを装着してください。
- OC Genie機能によるオーバークロックはハードウェアを破損する危険性があります。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。
- BIOS設定の際にはOC Genie機能を無効にて下さい。設定値の再利用をするために、OC Genieの各設定値をBIOSのオーバークロックプロファイルへ保存することをお勧めします。
- OC Genie機能でオーバークロックを行う際は、自己責任をご了解頂いた上でご使用ください。

ベースクロックコントロールボタン

これらのボタンでベースクロック周波数の上下が可能です。システムが通常の操作状態の際には、プラス/マイナスボタンを一回押すごとにベースクロック周波数が0.5MHzずつ上昇/下降します。



プラスボタン



マイナスボタン

スイッチ

本製品は以下のスイッチを搭載しています。本章はスイッチでマザーボードの機能を変更することを解説します。

過電圧スイッチ

このスイッチはBIOS設定メニューのCPU/ QPI/ DDR/ IOHの電圧レンジを上げて調整を行うことができます。



以下の解説に従ってCPU/ QPI/ DDR/ IOHの電圧レンジを上げてください。



スイッチ1：CPUの電圧調整範囲を変更します。“ON”に変えると、BIOSのCPU電圧調整範囲が上ヘシフトします。



スイッチ2：QPI電圧調整範囲を変更します。“ON”に変えると、BIOSのQPI電圧調整範囲が上ヘシフトします。



スイッチ3：DDR電圧調整範囲を変更します。“ON”に変えると、BIOSのDDR電圧調整範囲が上ヘシフトします。



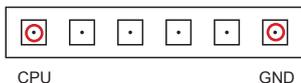
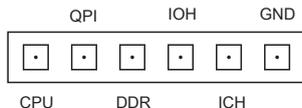
スイッチ4：IOH電圧調整範囲を変更します。“ON”に変えると、BIOSのIOH電圧調整範囲が上ヘシフトします。

注意

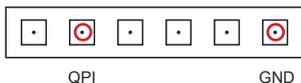
- OC Genieを有効にしてシステムの環境設定を検知している同時に、Vスイッチをつけません。過電圧行為が多過ぎた電圧を提供するために、デバイスに損害を与える恐れがあります。
- BIOSでCPU/ QPI/ DDR/ IOH電圧を設定した後はマルチメーターで電圧チェックポイントを測り、CPU/ QPI/ DDR/ IOH電圧をチェック願います。以下の解説に従って電圧を測ってください。

電圧チェックポイント: V-Check Point

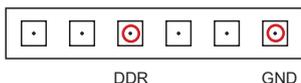
この電圧チェックポイントを使うことで現在のCPU/ QPI/ DDR/ IOH/ ICHの各電圧計測が可能です。



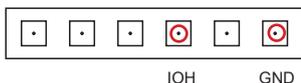
CPU電圧:マルチメーターのプローブをCPUとGNDへ接続することで現在のCPU電圧を測ります。



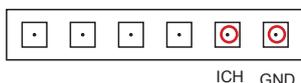
QPI電圧:マルチメーターのプローブをQPIとGNDへ接続することで現在のQPI電圧を測ります。



DDR電圧:マルチメーターのプローブをDDRとGNDへ接続することで現在のDDR電圧を測ります。



IOH電圧:マルチメーターのプローブをIOHとGNDへ接続することで現在のIOH電圧を測ります。

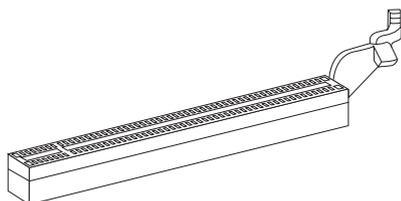


ICH電圧:マルチメーターのプローブをICHとGNDへ接続することで現在のICH電圧を測ります。

スロット

PCI Expressスロット

PCI ExpressスロットはPCI Expressインターフェース拡張カードをサポートします。



PCI Express x16スロット



PCI Express x1スロット

注意

拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。

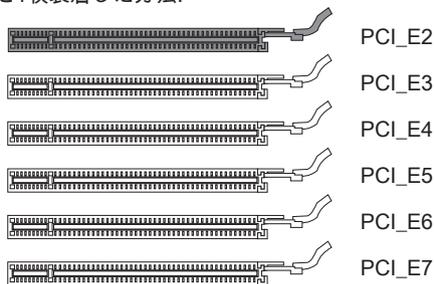
PCI Express x16スロットソケットルール

PCI Express x16ソケットルールについては下図を参照してください。それに、下表は装着された拡張カードを付け/付けないPCI Express x16レーンの構成を列挙します。

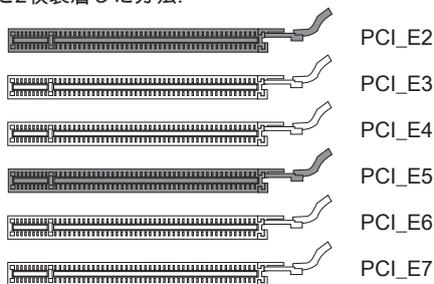
	1拡張カード	2拡張カード	3拡張カード		4拡張カード	5拡張カード	6拡張カード
PCI_E2レーン	x16 @	x16 @	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E3レーン	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @	x4 @
PCI_E4レーン	x0	x0	x0	x8 @	x8 @	x4 @	x4 @
PCI_E5レーン	x16	x16 @	x8 @	x8	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E6レーン	x0	x0	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x4 @
PCI_E7レーン	x0	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @

@: 拡張カードを装着したスロット

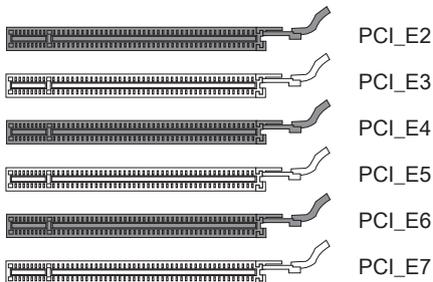
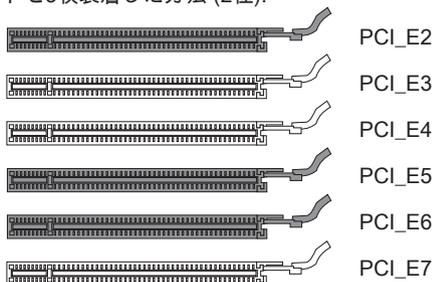
■ カードを1枚装着した方法:



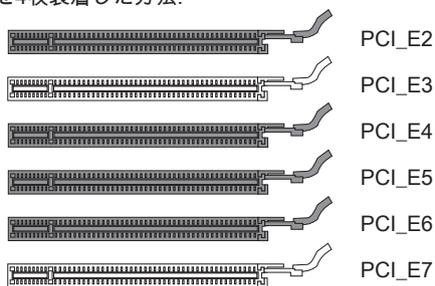
■ カードを2枚装着した方法:



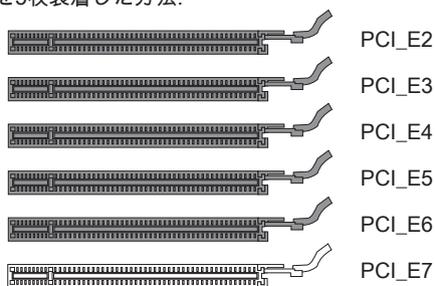
■ カードを3枚装着した方法 (2種):



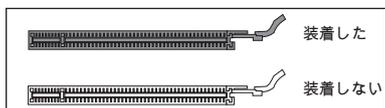
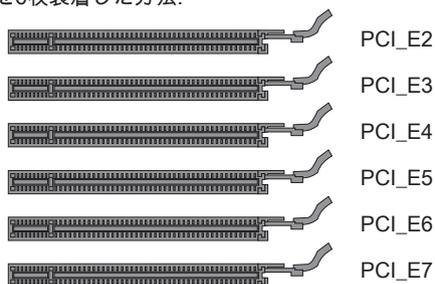
■ カードを4枚装着した方法:



■ カードを5枚装着した方法:



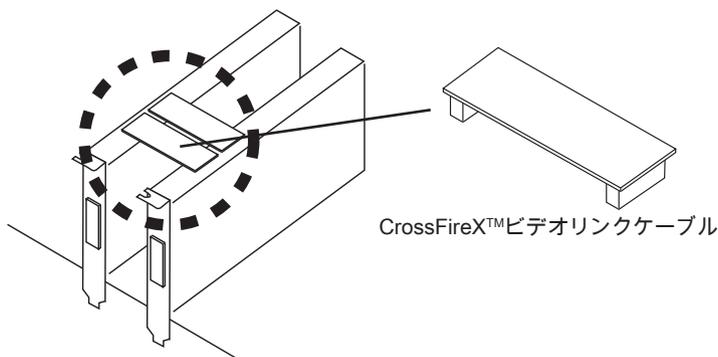
■ カードを6枚装着した方法:



ATI CrossFireX™ (Multi-GPU)テクノロジー

ATI CrossFireX™は、最高のゲームプラットフォームであり、2基および2基以上のATI Radeon™ HDグラフィックスカードの並行処理を可能にする技術です。複数のグラフィックスプロセッサを一体として動作させることにより、グラフィックス処理機能が大幅に向上します。マザーボードは自動的にCrossFireX™モードを検知します。手動設定によりCrossFireX™を有効にする必要はありません。CrossFireX™のセットアップは以下の要領で行ってください。

1. 2枚のATI Radeon™ HDグラフィックスカードをPCI_E2とPCI_E5スロットに装着してください。
2. グラフィックスカードをマザーボードに装着したら、CrossFireX™ビデオリンクケーブルでグラフィックスカード同士を連結させます。最後にモニターケーブルをプライマリ側(CrossFireX™エディション側)のグラフィックスカードに接続してください。システムを起動してドライバーをインストールします。



注意

- CrossFireX™モードご利用の際にはグラフィックスカードを2枚装着すると、必ず以下の条件を確認してください。
 - a. 同一メーカーの同一グラフィックスカードを装着します。
 - b. 2枚のカードをPCI_E x16速度をサポートしたPCI_E x16スロット (PCI_E2 & PCI_E5)に装着します。
- グラフィックスカードの安定性のために、グラフィックスカードのマニュアルで指定された適切な補助電源コネクタ-JPWR4 (あるいはグラフィックスカードにはの電源コネクタ)を接続してください。
- この機能をサポートするOSはWindows® XP (SP2以降)、Windows® XP Professional x64 Edition、Windows® Vista/ Windows® 7です。

3. ハードウェアの装着後、ドライバソフトウェアをインストールし、システムを再起動します。再起動後デスクトップの“Catalyst™ Control Center”アイコンをクリックして、中にあるCrossFireX™機能のために必要な設定を有効にしてください。Catalyst™ Control Centerには以下の形式が表示されます。

ドロップダウンメニューからViewを選択してください。



注意

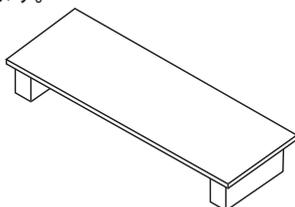
CrossFireX™テクノロジーは以下のモードをサポートします。

- SuperTiling (スーパーチリングモード)
- Scissor Mode (シザーモード)
- Alternate Frame Rendering (オルタネイトフレームレンダリング)
- Super Anti-aliasing (スーパーアンチエイリアス)

詳細についてはグラフィックスカードのマニュアルを参照してください。

NVIDIA® SLIテクノロジー

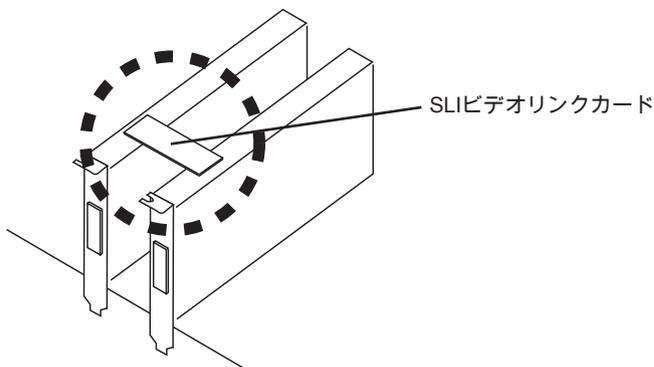
本製品はNVIDIA® SLI (Scalable Link Interface)テクノロジーをサポートしています。NVIDIA® SLIテクノロジーとは2枚のGPUを1台のPCで動作させ、負荷の大きな処理でも処理を分散することでパフォーマンスを向上させる技術です。2枚のGPUはSLIビデオリンクカードで接続されます。



SLIビデオリンクカード

SLIモードにより描画の質と速度が大幅に向上する場合には、以下の説明に従ってください。

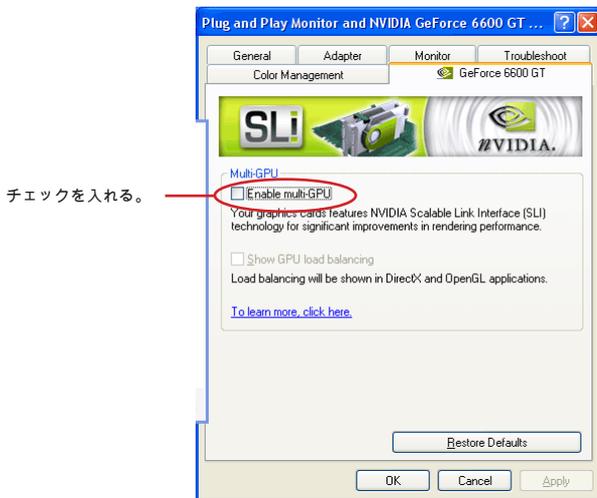
1. 2枚のグラフィックスカードをPCI_E2とPCI_E5スロットに装着してください。グラフィックスカードをマザーボードに装着したら、SLIビデオリンクカードでグラフィックスカード同士を連結させます(下図を参照してください)。最後にモニターケーブルをプライマリ側のグラフィックスカードに接続してください。



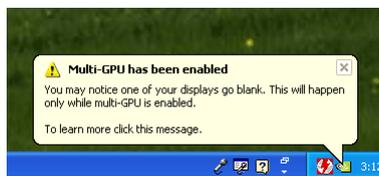
注意

- 本解説で使用した画像はお手元の製品と細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
- SLI環境を構築する場合は、全く同一の2枚の x16グラフィックスカードを使用してください。
- グラフィックスカードの安定性のために、指定された適切な補助電源コネクタ JPWR4(あるいはグラフィックスカードにはの電源コネクタ)を接続してください。

- ハードウェアのセットアップが完了したら、システムを起動してNV SLIドライバー/ユーティリティの設定を行います。ユーティリティ画面内の[Enable multi-GPU]のチェックボックスにチェックを入れてください(multi-GPU設定の詳細に関することはグラフィックスカードのマニュアルを参照してください)。



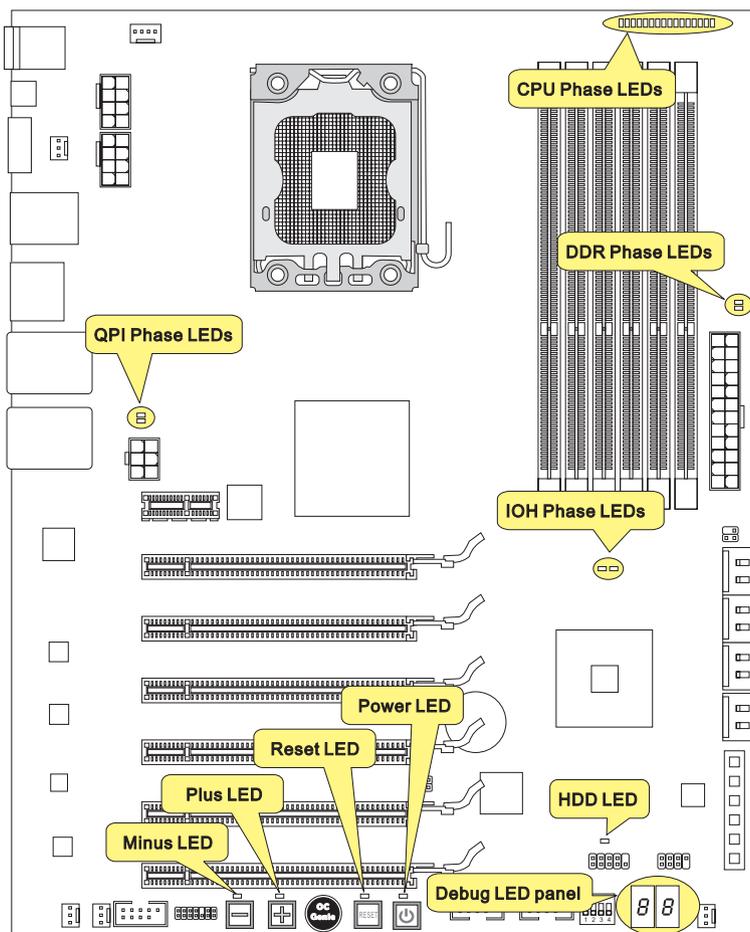
- システムを再起動すると、画面右下隅のタスクトレイに[Multi-GPU has been enabled]というバルーンメッセージが表示されます。



注意

SLIモードからシングルVGAカードの環境に戻す場合は、MultiGPUのチェックを外してください。

状態表示LED (オプション)



CPU電源回路フェーズLED

これらのLEDは現在のCPU電源回路の動作フェーズ数を表示します。

■ ライト □ オフ

■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は1フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は2フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は3フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は4フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は5フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は6フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は7フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は8フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は9フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は10フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は11フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は12フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は13フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は14フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は15フェーズで動作しています。
■□□□□□□□□□□□□□□	CPU電源回路は16フェーズで動作しています。

QPI電源回路フェーズLED

これらのLEDは現在のQPI電源回路の動作フェーズ数を表示します。

■ ライト □ オフ

□	QPI電源回路は1フェーズで動作しています。	■	QPI電源回路は2フェーズで動作しています。
■		■	

IOH電源回路フェーズLED

これらのLEDは現在のIOH電源回路の動作フェーズ数を表示します。

■ ライト □ オフ

■ □	IOH電源回路は1フェーズで動作しています。	■ ■	IOH電源回路は2フェーズで動作しています。
-----	------------------------	-----	------------------------

DDR電源回路フェーズLED

これらのLEDは現在のDDR電源回路の動作フェーズ数を表示します。

■ ライト □ オフ

□ ■	DDR電源回路は1フェーズで動作しています。	■ ■	DDR電源回路は2フェーズで動作しています。
-----	------------------------	-----	------------------------

HDD LED

LEDが点灯すると、ハードドライブが動作していることを表示します。

電源LED

電源ボタンを押すとLEDが点灯し、一度点滅します。

リセットLED

リセットボタンを押すとLEDが点灯し、一度点滅します。

マイナスLED

マイナスボタンを押すとLEDが点灯し、一度点滅します。

プラスLED

プラスボタンを押すとLEDが点灯し、一度点滅します。

デバッグLEDパネル

デバッグLEDメッセージの詳細については下表を参照してください。

位置	ステータス
FF	電源を投入してからCPUを初期化します。
C0, C1, C2	初期のCPU初期化
C4, C6	チップセットを初期化します。
D4, D5	メモリを初期化します。
08	キーボードを初期化します。
2A, 31	オンボードデバイスを初期化します。BIOSからメモリにオプションのROMをロードします(VGAとRAIDオプションROM)。
37	標識メッセージ、CPU情報、セットアップキーメッセージとOEM仕様品の情報を表示します。
38	USBデバイスやほかの デバイスを初期化します。
3C	チップセットレジスターの中期POST初期化。他のデバイスを検知します。(パラレルポート、シリアルポートやCPU内の双対プロセッサなど)
75, 78	INT 13とIPLデバイスを初期化します。(SATA/ PATA HDDとCD/DVD ROMを含む)
87	BIOSセットアップ画面を呼び出します。
A4	必要がある場合は、環境設定の画面にユーザーの入力を待ちます。
A7	有効にすると、システムの環境設定画面を表示します。
B1	ACPIのためにシステムコンテキストを保存します。OSローダーへのコントロールを準備します。(INT 19H)
00	OSローダーへのコントロールを通過します。(一般的にINT 19H)
AA	OS画面を呼び出します。

BIOSの設定

本章ではBIOS設定について説明します。ユーザーの用途に合ったシステム設定を行うことで、より快適にシステムを使用できるようになります。また、以下に該当する場合は、BIOSセットアッププログラムを起動して設定値を適切な値に変更してください。

- システムの起動中に画面にエラーメッセージが表示され、SETUPを実行するように指示された場合。
- 機能をカスタマイズするために、デフォルト設定を変更する場合。

注意

- BIOSはパフォーマンスの向上や問題回避のために、継続的に変更/修正が加えられています。そのため、お手元の製品と本書の内容に食い違いが生じてしまう場合があります。予めご了承ください。
- システムを起動すると、BIOSバージョンが画面の上側に表示されます。表示されるメッセージはA7666IMS V1.0 042210のような書式となります。それぞれの意味は：

1桁目：AならAMI BIOS、WならAWARD BIOS、PならPHOENIX BIOS

2 - 5桁目：製品のモデル番号

6桁目：IならIntelチップセット、NならNVIDIAチップセット、AならAMDチップセット、VならVIAチップセット

7 - 8桁目：MS =標準出荷バージョン

V1.0：BIOSバージョン

042210：2010年04月22日リリース

BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

Press DEL to enter SETUP

(キーを押してセットアップ画面を呼び出す)

を押す前にこのメッセージが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

ヘルプ

BIOS画面内を立ち上げると、最初にメインメニューが表示されます。

メインメニュー

メインメニューにはBIOSが提供する設定項目が各カテゴリ別に表示されます。矢印キー(↑↓)を使って項目を選択してください。カーソルが当たってハイライトされた設定項目の説明(英語)が画面の下部に表示されます。

サブメニュー

左手に三角が表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューに入るには項目をハイライトして<Enter>キーを押します。これでサブメニューが表示され、コントロールキーで項目の選択や変更を行います。上位のメニューに戻るには<Esc>キーを押します。

ヘルプキー <F1>

<F1>を押すと使用すべきキーやハイライトされた項目の選択肢の解説がポップアップウィンドウで表示されます。ヘルプウィンドウを閉じるには、<F1>か<Esc>キーを押してください。

メインメニュー

BIOS CMOSセットアップユーティリティを開きますと、メインメニューが表示されます。メインメニューのセットアップ機能や終了の設定項目に複数の選択肢があります。矢印で選択し、<Enter>キーを押してサブメニューを表示します。



▶ Standard CMOS Features (標準CMOS設定)

日付/時刻などのシステムの基本的な設定を行います。

▶ Advanced BIOS Features (拡張BIOS設定)

拡張BIOS機能の設定を行います。

▶ Integrated Peripherals (内蔵機能の設定)

IDE、サウンド機能、グラフィック機能などの各種オンボード機能の設定を行います。

▶ Power Management Setup (電源管理セットアップ)

電源管理に関する設定を行います。

▶ H/W Monitor (H/Wモニタ)

PCの状態を表示します。

▶ Green Power

動作フェーズ数の確認・設定を行います。

▶ BIOS Setting Password (BIOS設定パスワード)

設定変更を制限するためのパスワードを設定します。

▶ Cell Menu (セルメニュー)

周波数/電圧のコントロールやオーバークロックの各種設定を行います。

▶ M-Flash

USBメモリドライブを使ったBIOS更新を行う際に使用します。(FAT/FAT32フォーマットのみ)

▶ Overclocking Profile (オーバークロックのプロフィール)

CMOSへのプロファイル書き込み/ CMOSからのプロファイル読み込みを行います。

▶ Load Fail-Safe Defaults (BIOSの初期設定値をロードする)

安定動作を最優先した初期設定値をロードします。

▶ Load Optimized Defaults (最適のデフォルト値をロードする)

工場出荷時の設定をロードします。動作の安定性と性能の釣り合いが取れた設定値です。

▶ Save & Exit Setup (設定値を保存して終了する)

変更した設定値を保存して終了します。

▶ Exit Without Saving (設定値を保存せず終了する)

変更した設定値を保存せず終了します。

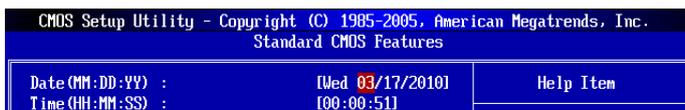
BIOSセットアップユーティリティについて、以下の手順で初期設定を行ってください。

1. Load Optimized Defaults (最適のデフォルト値をロードする) : コントロールキー(↑↓)で[Load Optimized Defaults]フィールドを強調表示します。<Enter>キーを押すと、以下のメッセージが表示されます。

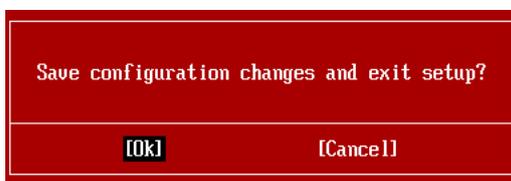


[OK]キー押すと、工場出荷設定のデフォルト値がロードされます。

2. Setup Date/ Time (日付/時間を設定する) : [Standard CMOS Features]を選択して<Enter>キーを押すと、Standard CMOS Featuresメニューが表示されます。日付/時間を調整します。



3. Save & Exit Setup (設定値を保存して終了する) : コントロールキー(↑↓)で[Save &Exit Setup]フィールドを強調表示します。<Enter>キーを押すと、以下のメッセージが表示されます。

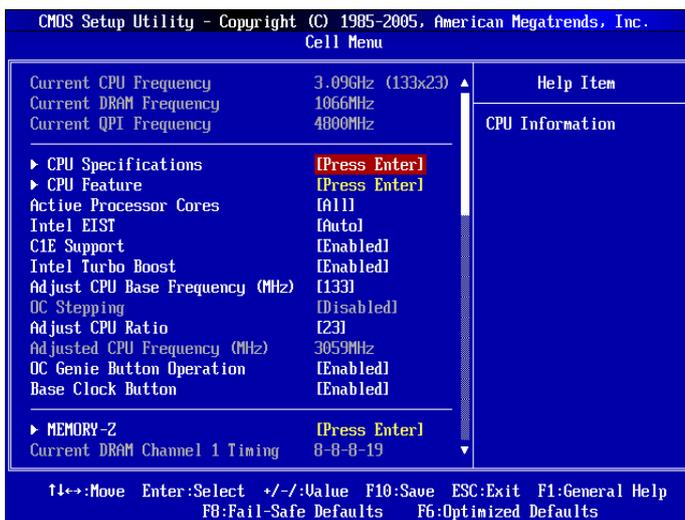


[OK]を選択して<Enter>キーを押すと、設定を保存してBIOSセットアップユーティリティを終了します。

注意

BIOS設定の詳細について知りたい場合には、英語マニュアルを参照して下さい。

4. Cell Menu Introduction (セルメニューの解説) : 動作周波数や電圧の設定変更を行います。



注意

動作周波数や電圧の設定を変更すると、コンポーネントの消費を早めたり、場合によっては破損を招くことがあります。本章の項目は変更しないで下さい。

▶ Current CPU / DRAM / QPI Frequency (現在のCPU / DRAM / QPI周波数)

CPU、メモリとQPIの周波数を表示します。読取専用です。

▶ CPU Specifications (CPUの仕様)

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUの情報を示します。

▶ CPU Technology Support (CPUのテクノロジーサポート)

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジーを示します。読取専用です。

▶ CPU Feature (CPUの機能)

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▶ Intel EIST

拡張版インテル® SpeedStepテクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。Speed StepテクノロジーはCPUの負荷に応じて電圧と周波数を変化させ、パフォーマンスと省電力を両立させCPUの発熱を抑える機能です。拡張版インテル® Speed Stepテクノロジー(EIST)をサポートするCPUを搭載した場合に設定が可能です。

▶ Intel C-State

C-stateはアイドル期間でプロセッサの電力を著しく減少する電源管理状態です。c-stateテクノロジーをサポートするCPUを搭載した後このフィールドが表示されます。

▶ **C State Package Limit Setting**

C-stateレベルを選択します。この項目を[Auto]に設定することをお勧めします。

▶ **C1E Support (C1Eサポート)**

CPUがアイドル状態の時に消費電力を低減できます。ただし、全てのCPUがこの拡張命令(C1E)をサポートしているわけではありません。

▶ **OverSpeed Protection (オーバースピード保護)**

本機能はCPUの消費電力だけではなく、現在のCPU動作も監視します。ある程度を超えると、プロセッサが自動的にクロック回転速度を落とします。CPUをオーバークロックしたい場合には、この項目を[Disabled]に設定してください。

▶ **Hyper-Threading Function (ハイパースレッティング機能)**

ハイパースレッティング機能に対応したCPUをお使いの場合、1つのCPUコアを2つの論理的なCPUコアとして認識させ、並列処理性能を高めることができます。ほとんどの場合、ハイパースレッティング機能を有効にすることでシステムの処理性能を向上できますが、マルチCPUに対応していないOSやアプリケーションソフトウェアを使う場合はDisable(使用しない)に設定して下さい。システムの動作が不安定になる場合があります。

注意

コンピューターシステムでハイパースレッティング機能を利用するためには、以下の全てのプラットフォームが必要です。

- CPU: インテル® HTテクノロジー対応プロセッサ
- チップセット: インテル® HTテクノロジー対応プロセッサチップセット
- BIOS: インテル® HTテクノロジー対応BIOS
- OS: インテル® HTテクノロジーをサポートするOS

インテル® HTテクノロジーの詳細については、以下のWebサイトご参照ください。

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm

▶ **Execute Bit Support (エグゼキュートビットサポート)**

本機能を有効にすることで、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる悪意を持った行為からシステムを保護することができます。本機能はCPUがアプリケーション毎のメモリエリアをコントロールすることで、ワームやウイルスなどが悪意の有るコードをバッファエリアなどに挿入しようとする行為を防止し、システムの損害や外部への伝播をおさえることができます。

▶ **Set Limit CPUID MaxVal to 3**

CPUID MaxVal項目は、古いオペレーティングシステムなどを利用する際にシステムのスピードを制限するために用います。

▶ **Intel Virtualization Tech (インテル仮想化テクノロジー)**

この項目ではインテル仮想化テクノロジーの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▶ **Intel VT-d (インテルVT-d)**

この項目ではDirected I/O (VT-d)のために、インテル仮想化テクノロジーの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▶ **Active Processor Cores (アクティブプロセッサコア)**

アクティブプロセッサコアの数を選択します。

▶ **Intel EIST**

拡張版インテル® SpeedStepテクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。Speed StepテクノロジーはCPUの負荷に応じて電圧と周波数を変化させ、パフォーマンスと省電力を両立させCPUの発熱を抑える機能です。拡張版インテル® SpeedStepテクノロジー(EIST)をサポートするCPUを搭載した場合に設定が可能です。

▶ **C1E Support (C1Eサポート)**

CPUがアイドル状態の時に消費電力を低減できます。ただし、全てのCPUがこの拡張命令(C1E)をサポートしているわけではありません。

▶ **Intel Turbo Boost**

インテル® Turbo BoostテクノロジーをサポートするCPUを装着するとこの項目が表示され、インテル® Turbo Boostテクノロジーの有効/無効を選択可能にします。アプリケーションソフトが性能の向上を要求した場合や熱的な余裕がある場合にプロセッサ周波数をCPU規定の動作クロックを超えて動的に変化させることが可能になります。

▶ **Adjust CPU Base Frequency (MHz) (CPUベース周波数を調整する)**

この項目はCPUベースクロックを設定します(MHz)。設定値を変更すると、CPUをオーバークロックすることができます。仕様書を超える設定を行った場合に関しましては、一切保証されません。

▶ **OC Stepping (オーバークロックステップの調整)**

[Adjust CPU Base Frequency (MHz) (CPUベースクロック周波数を調整する)]で周波数をオーバークロックするとこの項目が有効になり、以下のアイテムも表示されます。システムの起動後、設定されたステップでオーバークロックを行います。

▶ **Start OC Stepping From (MHz) (OC Stepping初期値の設定)**

初期のベースクロックを設定します。初期のベースクロック設定に伴ってシステムは起動されます。初期のベースクロックからオーバークロックを始めて、[Adjust CPU Base Frequency (MHz) (CPUベースクロック周波数を調整する)]では段階的にベースクロックを設定します。

▶ **OC Step (オーバークロックのステップ)**

ベースクロックのオーバークロックステップ幅を設定します。

▶ **OC Step Count Timer (オーバークロックステップ値の表示間隔)**

各段階の緩衝時間を設定します。

▶ **Adjust CPU Ratio (CPU倍率を調整する)**

CPU倍率を調整します。

▶ **Adjusted CPU Frequency (MHz) (調整したCPU周波数)**

調整したCPU周波数(ベースクロック × 倍率)を表示します。読取専用です。

▶ **OC Genie Button Operation (OC Genieボタンの操作)**

OC Genieボタンの機能を有効/無効にします。

▶ **Base Clock Button (ベースクロックボタン)**

ベースクロックボタンの機能を有効/無効にします。

▶ **MEMORY-Z**

<Enter>キーを押してサブメニューが表示されます。

▶ **DIMM1~6 Memory SPD Information (DIMM1~6メモリSPD情報)**

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。

▶ **Current DRAM Channel1/2/3 Timing (現在のDRAMチャンネル1/2/3タイミング)**

装着されたDRAMタイミングを表示します。読取専用です。

▶ **DRAM Timing Mode (DRAMタイミングモード)**

この項目でDRAMタイミングがDRAMモジュールのSPD (Serial Presence Detect) EEPROM情報によりコントロールするかどうかを決定します。[Auto]に設定すると、DRAMタイミングを有効にして、以下の[Advance DRAM Configuration]メニューがSPDの情報を基に、自動的に最適な設定を行います。[Manual]に設定すると、以下のメニューを手動で設定します。

▶ **Advance DRAM Configuration (高級なDRAM配置)**

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 1T/2T Memory Timing (CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 1T/2Tメモリタイミング)**

ここでSDRAMコマンド率をコントロールできます。[1]を選択すると、SDRAM信号コントローラーが1N(N=クロックサイクル)単位で制御され、[2]では2N単位で制御されます。

▶ **CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 CAS Latency (CL)**

SDRAMが読み込みコマンドを受信した後読み込みを開始するまでのタイミング遅延であるCASレイテンシーを設定します。

▶ **CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tRCD**

RAS(行アドレス信号)とCAS(列アドレス信号)の信号間隔を手動で設定します。一般的にクロックサイクル値が小さいほどDRAMの動作速度が上がります。

▶ **CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tRP**

DRAMがリフレッシュに必要とする電荷を蓄積する時間を手動で設定します。RAS信号のクロック数がこの時間を規定しますが、電荷を蓄積するための時間が足りない場合はDRAMのリフレッシュは不完全になり、DRAMがデータを保持できなくなることがあります。システムに同期DRAMをインストールした場合のみこの項目が利用できます。

▶ **CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tRAS**

RAS(行アドレス信号)が発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▶ **CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tRFC**

RFCが発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▶ CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tWR

プリチャージが掛かる前のデータの書込みに要する時間を手動で設定するのがtWRです。この設定ではプリチャージが掛かる前に、書込みバッファのデータがメモリセルに完全に書き込まれるように設定する必要があります。

▶ CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tWTR

同じメモリバンク内で処理される書き込み命令から読み取り命令までの間隔時間を手動で設定します。読み取り命令の始める前にI/O gatingがセンス増幅器を増速駆動できます。

▶ CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tRRD

異なるメモリバンク間でデータアクセスを行うための遅延時間を手動で設定します。

▶ CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tRTP

この設定はデータ読み込みとプリチャージ命令の時間間隔をコントロールします。

▶ CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tFAW

tFAWタイミングを設定します。

▶ Current CH1/ CH2/ CH3あるいはCH1-3 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRdTWrr/ tdrRdTWrr/ tddRdTWrr/ tsrWrTRd/ tdrWrTRd/ tddWrTRd/ tdrWrTWrr/ tddWrTWrr/ tsrRdTRd/ tsrWrTWrr

高級なDRAMタイミングを表示します。

▶ Channel 1/ Channel 2/ Channel 3 or Channel 1-3 Advance Timing (チャンネル1/チャンネル2/チャンネル3あるいはチャンネル1-3高級なタイミング)

[Auto]に設定すると、高級なメモリタイミングを有効にして、自動的にBIOSに決定されます。[Manual]に設定すると、以下のタイミングを手動で設定を行います。

▶ Extreme Memory Profile (X.M.P.)

インテルExtreme Memory Profile (X.M.P.)を有効/無効にします。詳細についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▶ Memory Ratio (メモリ倍率)

メモリ倍率を設定します。

▶ Adjusted DRAM Frequency (MHz) (調整したDRAM周波数)

調整したDRAM周波数を表示します。読取専用です。

▶ Uncore Ratio (倍率)

Uncore倍率を設定します。

▶ Adjusted Uncore Frequency (MHz) (調整したUncore周波数)

調整したuncore周波数を表示します。読取専用です。

▶ QPI Links Speed (QPIリンクスピード)

QPIリンクスピードのモードを選択します。

▶ QPI Frequency (QPI周波数)

QPI周波数を設定します。

▶ Adjusted QPI Frequency (MHz) (調整したQPI周波数)

調整したQPI周波数を表示します。読取専用です。

▶ ClockGen Tuner

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▶ CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control

CPU/ PCI Expressクロック振幅を選択します。

▶ CPU CLK Skew/ MCH CLK Skew

CPU/ MCHチップセットのクロックゆがみを選択します。CPUの性能を向上することができます。

▶ Adjust PCI-E Frequency (MHz) (PCI-E周波数を調整する)

PCIE周波数を選択します。(MHz)

▶ VDrop Control (VDropコントロール)

VDropコントロールモードを選択します。

▶ CPU Voltage (V)/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ IOH Voltage (V)/ IOH PCIE Voltage (V)/ ICH Voltage (V)

CPU、メモリやチップセットの電圧を調整します。

▶ Spread Spectrum

コンピュータはクロック信号と呼ばれるパルス信号を元に動作しています。クロックジェネレーターがパルス信号を発生する際に、構造上やむを得ずスパイクノイズと呼ばれる電磁妨害(EMI)が生じます。基本的にはボード上の配線の取り回しによってノイズを相殺するように工夫しています。しかし特定環境下において外部にノイズが漏れてしまう場合があります、そのようなケースではスペクトラム拡散方式で信号の波形を変更することで、ノイズの漏れを回避する場合があります。通常は[Disabled]に設定して使用します。また、オーバークロックをかけた状態で使用する場合も[Disabled]に設定してください。

注意

- 特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するために[Disabled]に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず[Enabled]に設定して障害の軽減に努めて下さい。
- Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。
- オーバークロック動作実験をする場合は、必ず[Disabled]に設定して下さい。

注意

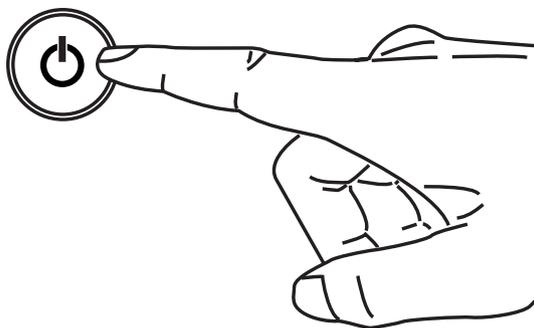
Failed Overclocking Resolution (オーバークロックがうまくいかない場合)

本製品は多彩なオーバークロック設定をサポートします。しかしながら、オーバークロック実験の成功にはCPUをはじめ温度や電圧など実に様々な要素が影響する上に定格以外の設定で動作させることはあらゆるコンポーネントにダメージを与える可能性があります。不適切な操作や設定原因でシステムを破損した場合は、製品保証の対象外です。

Two ways to save your system from failed overclocking... (オーバークロック失敗後にシステムを復旧する方法...)

• Reboot (再起動)

システムを再起動するために、電源ボタンを3回も押してください。連続した電源のON/OFFは機器に悪影響を与えます。再起動する場合は10秒以上の間隔を空けて下さい。



4回目の再起動でもシステムが正常動作できない場合、前回設定に問題があったとシステムが判断し、自動的にデフォルト設定値を復元します。以下のメッセージが画面に表示される場合は、何かキーを押して進めて下さい。

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....

• CMOSをクリア

CMOSデータ消去の詳細については[how to clear CMOS data (CMOSデータの消去方法)]を参照してください。

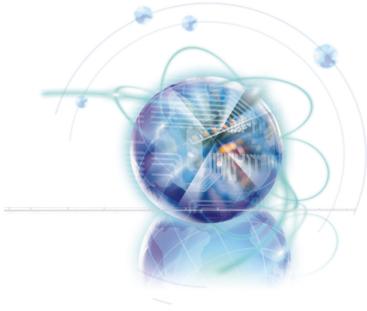
ソフトウェアの情報

本製品にはドライバー/ユーティリティDVDが同梱されています。OSのインストールが終了したら、全てのドライバーのインストールし、セットアップを完了させてください。ユーティリティソフトはユーザーのニーズに応じてインストールしてください。ドライバー/ユーティリティDVDには以下の内容が含まれています。

- Driver menu : 使用できるドライバーを表示します。要望によってドライバーをインストールし、デバイスを起動します。
- Utility menu : サポートのソフトウェアアプリケーションを表示します。

注意

MSIのホームページから最新のドライバーやBIOSを入手することができます。



繁體中文

XPower 系列

Asia version

主機板規格

處理器

- 支援 LGA1366 架構的 Intel® Bloomfield™ 處理器
(欲知更多 CPU 相關訊息，請至微星科技網站
<http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2>)

QPI

- 最高達每秒 6.4 GT

晶片組

- 北橋：Intel® X58 晶片組
- 南橋：Intel® ICH10R 晶片組

記憶體

- 6 條 DDR3 DIMM 支援 DDR3 2133*(超頻)/ 1800*(超頻)/1600*(超頻)/ 1333/ 1066 / 800 DRAM (支援總合最高 24GB)
- 支援雙通道模式或 3 通道模式
*(有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站
<http://www.msi.com/index.php?func=testreport>)

LAN

- 由 Realtek® RTL 8111DL 支援 2 組 10/100/1000 快速乙太網路

IEEE 1394

- 由 VIA® VT6315N 支援 1 個 IEEE 1394 連接埠

QuantumWave 獨立音效卡

- Realtek® ALC889
- 符合 Azalia 1.0 規格
- 7.1 聲道高音質音效
- 支援 1 個 S/PDIF 輸出接頭
- 支援同軸或光纖 S/PDIF 輸出連接埠 (位於背板)

SATA

- 由 Intel® ICH10R 支援 6 個 SATA 3Gb/s 連接埠 (SATA1~6)
- 由 Marvell® 88SE9128 支援 2 個 SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA7~8)
- 由 JMicron® JMB362 支援 ESATA 及 ESATA/ USB 2.0 combo 連接埠各一(二者均位於背板)
- 支援熱插拔及非同步告知功能

USB 3.0

- 由 NEC® uPD720200F1 支援 2 個 USB 3.0 連接埠

RAID

- 由 Intel® ICH10R 支援的 SATA1~6 連接埠支援 Intel® Matrix Storage 技術 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)
- 由 Marvell® 88SE9128 支援的 SATA7~8 連接埠支援 RAID 0/ 1 模式

接頭

- 背板
 - 1 個 PS/2 鍵盤連接埠
 - 1 個 PS/2 滑鼠連接埠
 - 1 個清除 CMOS 按鈕
 - 1 個 D-LED2 除錯面板接頭
 - 1 個 IEEE 1394 連接埠
 - 5 個 USB2.0 連接埠
 - 1 個 ESATA 連接埠
 - 1 個 ESATA/ USB 2.0 Combo 連接埠
 - 2 個區域網路連接埠
 - 2 個 USB 3.0 連接埠
- 內建接頭
 - 2 個 USB2.0 接頭
 - 1 個 IEEE 1394 接頭
 - 1 個機殼開啟警告開關接頭
 - 1 個 TPM 接頭
 - 1 顆重開機按鈕
 - 1 顆電源按鈕
 - 1 個 GreenPower Genie 接頭 (選配)
 - 1 個超電壓開關
 - 1 組 voltage check point
 - 1 顆 OC Genie 按鈕
 - 2 顆 Base clock 控制按鈕
 - 1 組除錯 LED 面板

插槽

- 6 個 PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCI_E2 & PCI_E5 支援最高達 PCIE x16 速度, PCI_E4 & PCI_E6 支援最高達 PCIE x8 速度, PCI_E3 & PCI_E7 支援最高達 PCIE x4 速度)
- 1 個 PCI Express 1.1 x1 插槽

尺寸

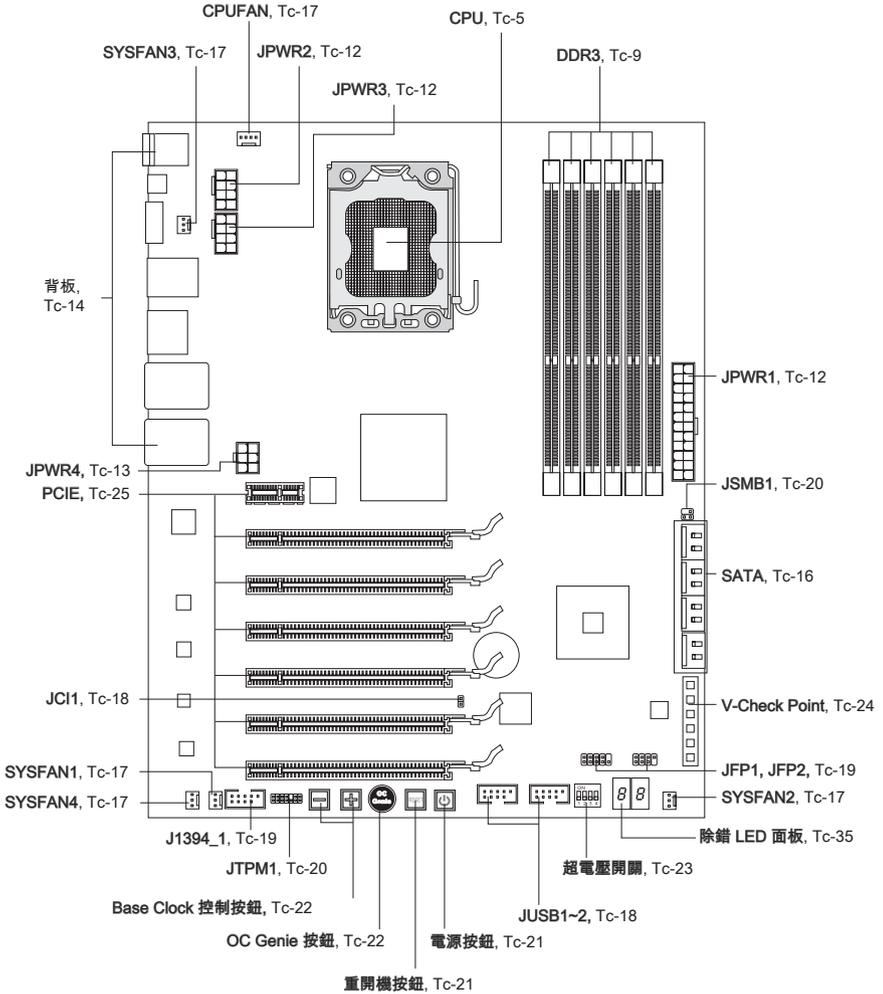
- ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)

裝機

- 9 個裝機孔

*如須了解附件之型號以便進行選購，請至以下網頁依產品名稱搜尋：
<http://tw.msi.com>

快速零組件指南



CPU (中央處理器)

安裝 CPU 時，請確認附有散熱風扇，以避免 CPU 過熱。若無散熱風扇，請向經銷商洽購。並在開機前，先將風扇正確地安裝在主機板上。

有關更多 CPU 的最新訊息，請至微星科技網站

<http://www.msi.com/index.php?func=cputform2>

注意事項

溫度過高

溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及系統。請確保散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。

更換 CPU

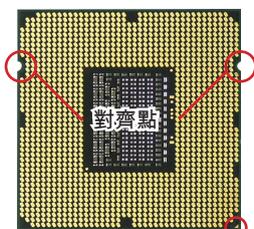
更換 CPU 時，應先關掉 ATX 電源開關或拔掉電源線，以免損壞 CPU。

超頻使用

即使本主機板設計為可超頻運作，但在將其調整為超頻運作時，請確認系統零組件可承受此異常設定。任何在非本產品規格建議下的操作，我們均不保證其造成的損壞及操作時的風險。

LGA 1366 架構中央處理器簡介

LGA 1366 CPU 針腳座



黃色三角標記為 Pin 1 指示器

請於 LGA 1366 CPU 的表面塗上散熱膏
有助 CPU 散熱



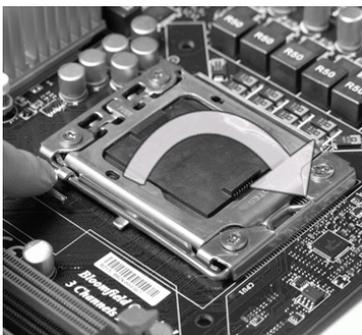
黃色三角標記為 Pin 1 指示器

安裝中央處理器與散熱風扇

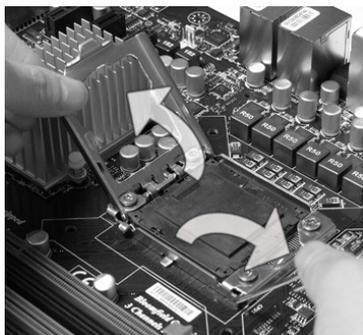
在安裝中央處理器時，為避免過熱，請確認購買的中央處理器，是否隨附一顆散熱風扇。安裝前先於中央處理器上塗抹散熱膏以助散熱。

請依下列步驟，正確地安裝中央處理器與散熱風扇。錯誤的安裝會使中央處理器與主機板受損。

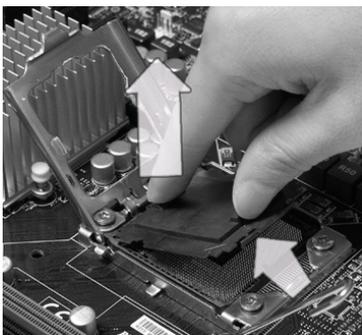
1. 鬆開拉桿。



2. 提起拉桿後打開固定蓋。



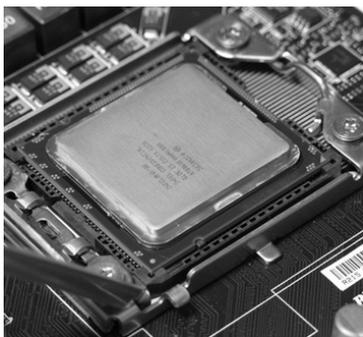
3. CPU 插座上面有個塑膠保護蓋以免 CPU 插座受損。安裝 CPU 前，請勿取下。由腳座側邊將保護蓋取下 (如箭頭所示)。



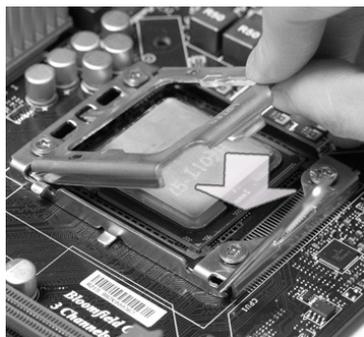
4. 確認好 CPU 正確安裝方向後置入插座。以手指抓住處理器邊緣並請注意對準對齊點。



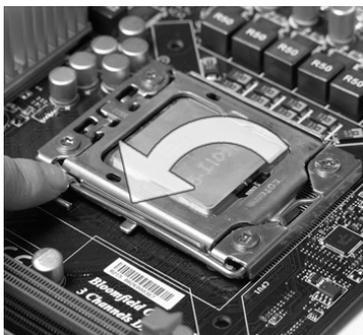
5. 由外觀檢視 CPU 是否已安裝好。若未安裝好，請垂直拿出 CPU 後再重新放入。



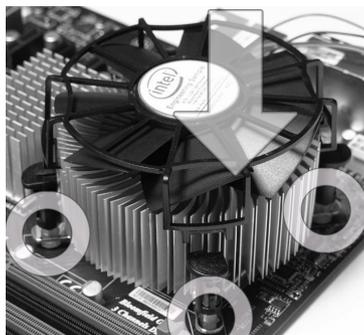
6. 將拉桿往固定蓋方向輕壓。



7. 然後把拉桿尾端扣住。



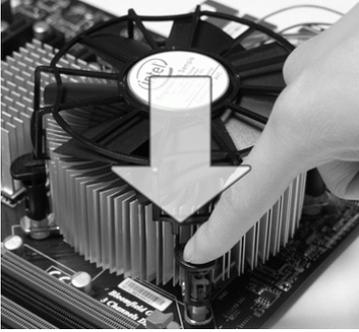
8. 在安裝風扇前先確認四個卡榫均位於正確位置。



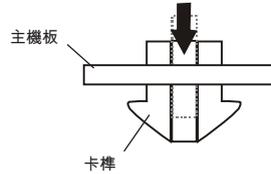
注意事項

- 請在開機前先確認散熱風扇已確實安裝。
- 請勿觸摸 CPU 插座針腳，以免受損。

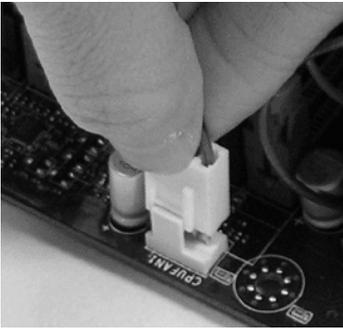
9. 將四個卡榫壓下固定風扇。



10. 再檢查主機板背面，確認四個卡榫已正確插入即可。



11. 最後將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇電源接頭即完成。

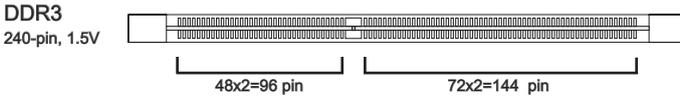


注意事項

- 請於 BIOS 設定一節檢視 CPU 狀態。
- 未安裝 CPU 時，請用塑膠蓋保護 CPU 插座以免受損 (如圖 1 所示)。
- 本節主機板圖示僅為安裝中央處理器及散熱風扇示範用。該圖示可能會與您購置的主機板外觀有所差異。
- 有關 CPU 風扇安裝細節請參閱 CPU 風扇包裝內文件說明。

記憶體

主機板上的 DIMM 插槽，是用來裝記憶體模組。有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站：<http://www.msi.com/index.php?func=testreport>



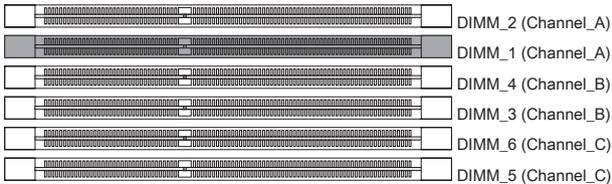
記憶體規則

請參照以下圖示來了解記憶體規則。

單通道模式配置規則

只有一條記憶體模組，請務必插到 DIMM_1 (PCB v1.0 版本內為 DIMM_A0)。

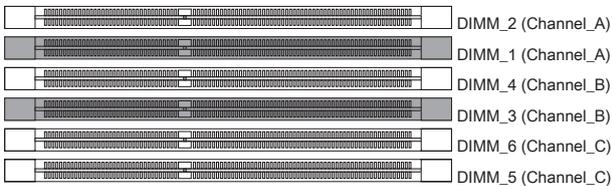
①



雙通道記憶體規則

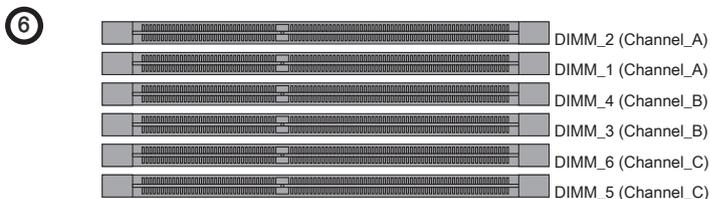
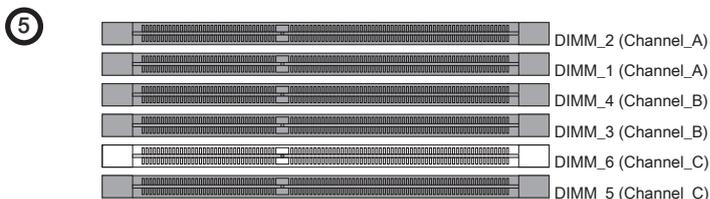
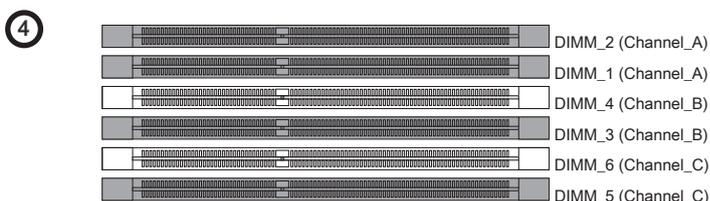
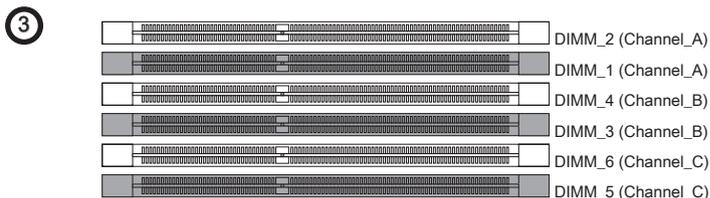
雙通道模式下，記憶體模組可用 2 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。請依下表指示來安裝記憶體模組以開啟雙通道模式。

②



3 通道記憶體規則

3 通道模式下，記憶體模組可用 3 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟 3 通道模式可將系統效能發揮到極致。若有 3 條或多條記憶體，請依下表指示插入模組中。



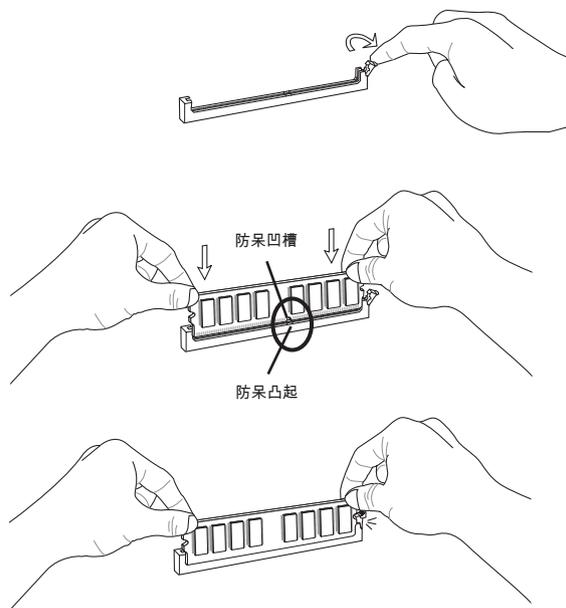
注意事項

- DDR3 記憶體模組，無法與 DDR2 互換且無法向下相容。因此請在 DDR3 插槽內，插入 DDR3 記憶體模組。
- 要使用 3 通道或雙通道模式，請確認已於不同通道的記憶體插槽，安裝同密度容量及同廠牌的記憶體。

- 請優先將記憶體插入 DIMM1 插槽 (PCB v1.0 版本內為 DIMM_A0)，以確保系統正常開機。
- 因晶片配置的緣故，在每個 DIMM 模組安裝 4GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 23+ GB 的容量 (而非 24 GB 整)。

安裝記憶體模組

1. 記憶體模組上只有一個防呆凹槽。模組只能以一種方向安裝。
2. 將記憶體模組垂直插入插槽，直到記憶體模組上的金手指，牢固地插入插槽內。當記憶體模組正確的被固定後，上槽兩側的塑膠卡榫會自動卡上。
3. 手動檢查是否記憶體模組已經固定在適當的位置。



注意事項

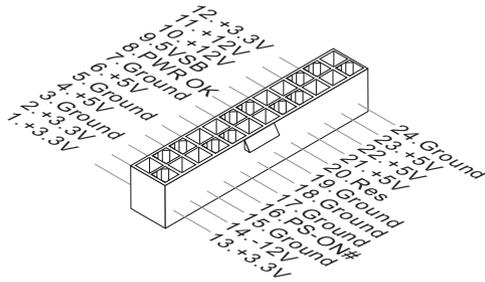
若已正確地將記憶體模組插入該插槽的話，應看不見金手指。

電源供應器

ATX 24-pin 電源接頭：JPWR1

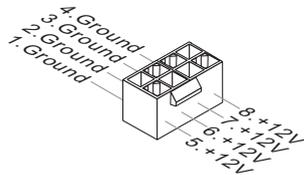
本接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接該電源時，請確認電源接頭插入的方向正確且對準腳位，再將電源接頭緊密地壓入接頭內。

您亦可使用 ATX 20-pin 電源，安裝該電源時，請確認電源插頭插入腳位對準 pin1 及 pin13。



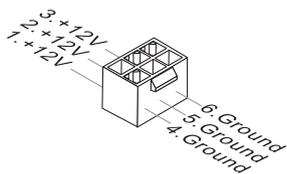
ATX 8-pin 電源接頭：JPWR2/ JPWR3

本電源接頭提供 12V 電壓給 CPU 使用。



ATX 6-pin 電源接頭：JPWR4

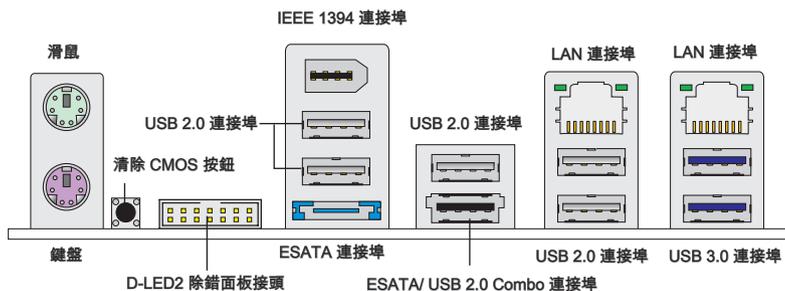
本電源接頭提供 12V 電壓給顯卡使用。



注意事項

- 確認所有接頭均接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。
- 建議使用 450 瓦或以上電源，有助系統穩定性。

背板



▶ 滑鼠/鍵盤

標準 PS/2[®] 滑鼠/鍵盤的 DIN 接頭，可接 PS/2[®] 滑鼠/鍵盤。

▶ 清除 CMOS 按鈕

主機板上有一個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。請使用本鈕來清除系統設定。

注意事項

請在清除 CMOS 資料前，先確認已關機。

在電源關閉狀態 (G3) 按下本鈕清除 CMOS 資料後，系統會自動開機。

▶ D-LED2 除錯面板接頭

本接頭接到一顆 D-LED2 (除錯-LED2) 面板 (選配)，該面板會顯示已連接系統的現況或模式之訊息。請參閱 D-LED2 快速指南 (選配) 以得知使用詳情。

▶ IEEE 1394 連接埠

位於主機板的背板的 IEEE1394 埠，可連接 IEEE1394 裝置。

▶ USB 2.0 連接埠

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的設備。USB 2.0 連接埠最高可支援每秒 480 Mbit 的傳輸速率 (Hi-Speed)。

▶ **ESATA 連接埠**

ESATA (外接 SATA) 連接埠是用以外接 ESATA 硬碟。

▶ **ESATA/ USB 2.0 Combo 連接埠**

ESATA/ USB 2.0 combo 連接埠可用來外接 ESATA 硬碟或是 USB 裝置。

▶ **USB 3.0 連接埠**

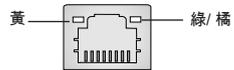
USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 設備，最高支援每秒 5 Gbit 傳輸速率 (SuperSpeed)。

注意事項

要使用 USB 3.0 設備，請以 USB 3.0 連接線將設備連接到電腦的 USB 3.0 連接埠。

▶ **LAN 連接埠**

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。您可直接將網路線接到本連接埠。

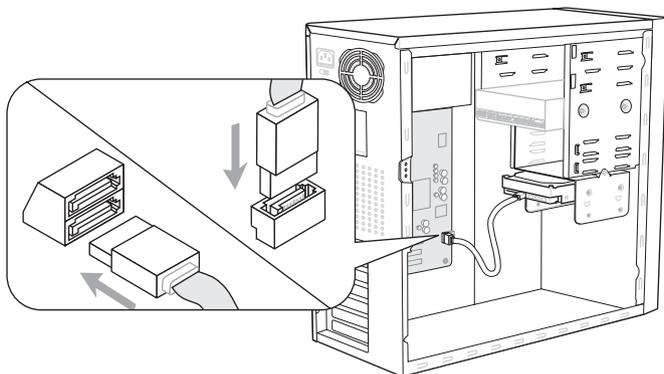


LED	顏色	LED 狀態	說明
左	黃	Off	LAN 連線未建立
		On (穩定狀態)	LAN 連線已建立
		On (發亮且閃爍中)	電腦正透過網路連到另一台電腦
右	綠	Off	資料傳輸速率為每秒 10 Mbit
		On	資料傳輸速率為每秒 100 Mbit
	橘	On	資料傳輸速率為每秒 1000 Mbit

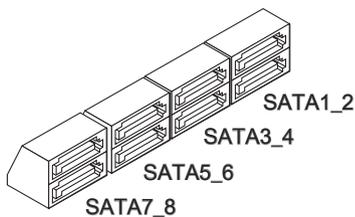
接頭

Serial ATA 接頭：SATA1~8

本接頭為高速 Serial ATA 介面，可各接一台 Serial ATA 裝置。



* 本圖中的主機板配置僅供參考



由 Intel® ICH10R 支援
SATA1~6 (3Gb/s)

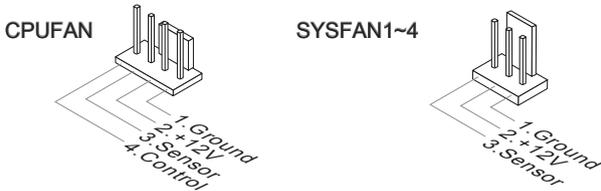
由 Marvell® 88SE9128 支援
SATA7/ SATA8 (6Gb/s)

注意事項

請勿摺疊 Serial ATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。

風扇電源接頭：CPUFAN, SYSFAN1~4

電源風扇接頭均支援 +12V 散熱風扇。在將電線接到接頭時，請切記紅線是正極，一定要連接到 +12V；而黑線是接地線，須連接到 GND。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，須使用具速度感應器設計之風扇，方能使用 CPU 風扇控制功能。

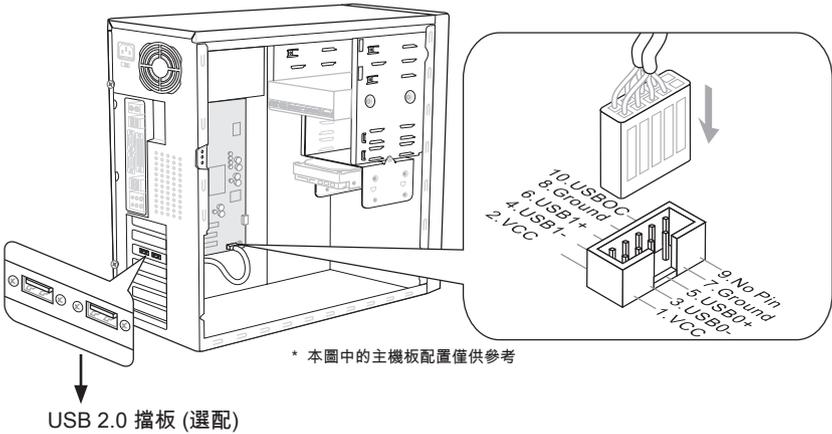


注意事項

- 請上處理器之官方網站參考建議之 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇合適的 CPU 散熱風扇。
- CPUFAN 支援風扇控制功能。請安裝 **Control Center** 工具程式，會根據 CPU 的實際溫度，來控制 CPU 散熱風扇的速度。

USB 接頭：JUSB1 / JUSB2

本接頭規格符合 Intel® 面板輸入/輸出連接設計規格，適用於高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。

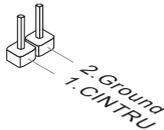


注意事項

請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。

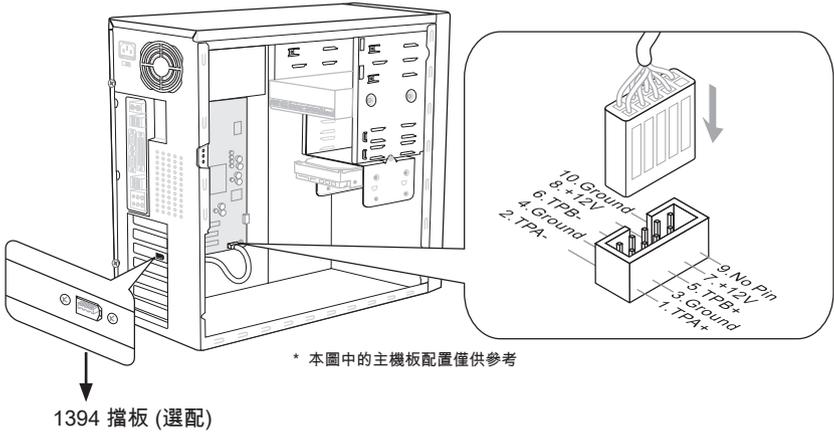
機殼開啟警告開關接頭：JCI1

本接頭接到機殼開啟開關排線。在機殼被打開時，會啟動機殼開啟機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。



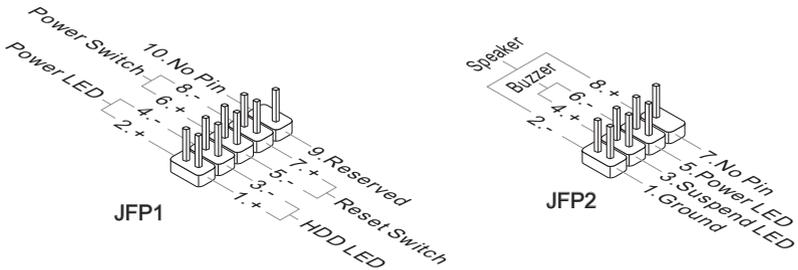
IEEE1394 接頭：J1394_1

本連接器是透過另行選配的 IEEE1394 擋板，來連接 IEEE1394 裝置。



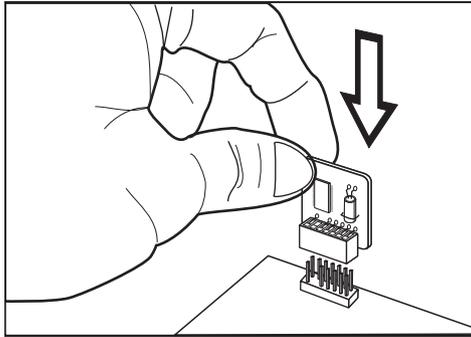
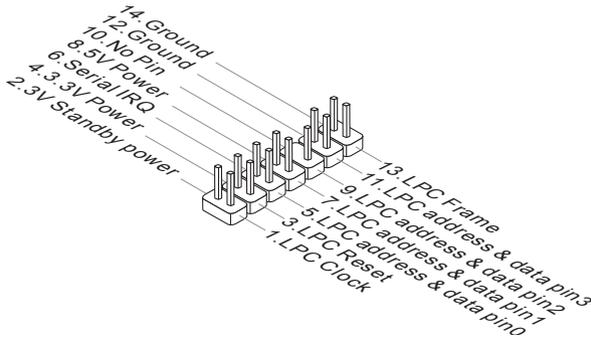
面板接頭：JFP1, JFP2

這些接頭接到面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/輸出連接設計規格。



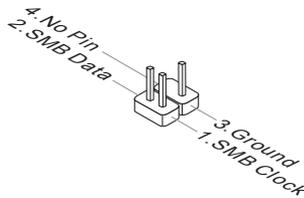
TPM 接頭 : JTPM1

本接頭接到可信任安全模組(選配)。更多詳情請參閱 TPM 安全平台使用手冊。



GreenPower Genie 接頭 : JSMB1 (選配)

本接頭是接到 GreenPower Genie (選配)。



按鈕

本主機板提供以下按鈕，來設定電腦功能；本節會說明如何使用按鈕來調整主機板功能。

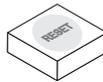
電源按鈕

本鈕是用來開機或關機。



重開機按鈕

本鈕是用來重新開機。



OC Genie 易超頻按鈕

本鈕是讓系統自動超頻的按鈕。在電源關閉狀態下按本鈕開啟以 OC Genie 易超頻功能後，本鈕會亮後鎖住，接著系統會在開機後自動偵測出超頻最佳數值。若要關閉本功能，在開機後再按一次，本鈕亮光就會消失再解鎖。這樣一來，系統在下次開機時就會回復預設設定。

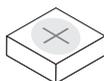


注意事項

- 要使用 OC Genie 易超頻功能，建議安裝 DDR3 1333 及其以上等級記憶體，並配備較優良的散熱風扇。
- 我們無法保證 OC Genie 超頻範圍以及由 OC Genie 超頻動作所可能衍生的損壞和風險亦無法提供保固。
- 您可於 BIOS 設定關閉 OC Genie 易超頻功能。另外，為方便您未來使用，建議您將 OC Genie 設定儲存到 BIOS 設定選單下的“Overclocking Profile”「超頻概述」選項。
- OC Genie 易超頻功能的使用風險請自行承受。微星科技無法保證超頻成功與否。

Base Clock 控制按鈕

這些按鈕用來增加或減少 Base clock 頻率。在系統正常運作狀態下，每按一次 Plus 或 Minus 控制鈕就會增加或減少 0.5 MHz 的 Base clock 頻率。



Plus 按鈕



Minus 按鈕

開關

本主機板提供下列開關，來設定電腦功能；本節會說明如何使用開關來調整主機板功能。

超電壓開關

切換本開關可在 BIOS 提高 CPU / QPI/ 記憶體/ IOH 的電壓調整範圍。再來就於 BIOS 設定下超頻這些選項。



請依以下指示提高 CPU / QPI/ 記憶體/ IOH 的電壓調整範圍。



開關 1：用來超 CPU 電壓，切換到“ON”可在 BIOS 增加 CPU 電壓調整範圍。



開關 2：用來超 QPI 電壓，切換到“ON”可在 BIOS 增加 QPI 電壓調整範圍。



開關 3：用來超記憶體電壓，切換到“ON”可在 BIOS 增加記憶體電壓調整範圍。



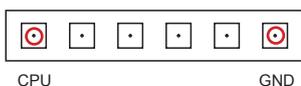
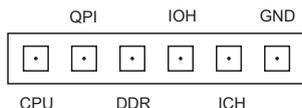
開關 4：用來超 IOH 電壓，切換到“ON”可在 BIOS 增加 IOH 電壓調整範圍。

注意事項

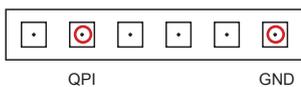
- 開啓 OC Genie 偵測系統設定時，請勿同時開啓本開關內的任一部份，以免提供過多電壓造成裝置損壞。
- 在 BIOS 設定完 CPU / QPI/ 記憶體/ IOH 電壓後，可用萬用電表插入電壓量測座檢查電壓。請依以下說明以量測這些電壓值。

電壓量測點：V_Check Point

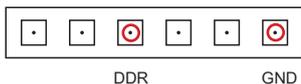
電壓量測點是用來測量目前 CPU / QPI/ 記憶體/ IOH/ ICH 電壓。



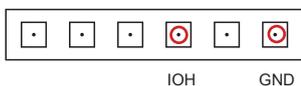
CPU 電壓：將萬用電表插入如左圖的 CPU 和 GND 量測點即可測得。



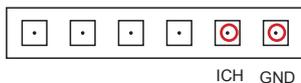
QPI 電壓：將萬用電表插入如左圖的 QPI 和 GND 量測點即可測得。



記憶體電壓：將萬用電表插入如左圖的 DDR 和 GND 量測點即可測得。



IOH 電壓：將萬用電表插入如左圖的 IOH 和 GND 量測點即可測得。

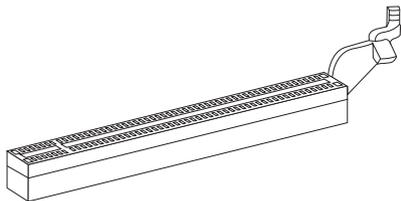


ICH 電壓：將萬用電表插入如左圖的 ICH 和 GND 量測點即可測得。

插槽

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

PCI Express 插槽支援 PCI Express 介面的擴充卡。



PCI Express x16 插槽



PCI Express x1 插槽

注意事項

新增或移除擴充卡時，請確認已將電源線拔掉。另外，請詳讀擴充卡的使用說明，確認在使用擴充卡時所需變更如跳線、開關或 BIOS 設定等軟體設定。

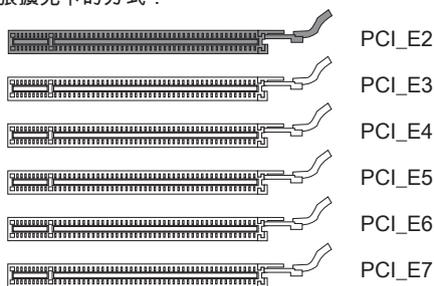
PCIe x16 插槽配置規則

請參照以下圖示來了解 PCIe x16 配置規則。下表詳列出安裝或未安裝擴充卡時，PCIe x16 通道速率的配置。

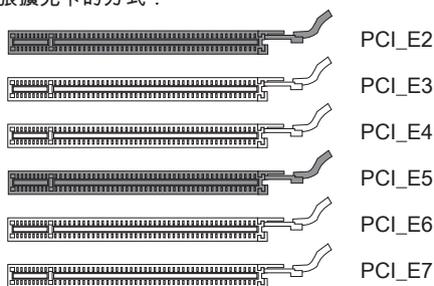
	1 張擴充卡	2 張擴充卡	3 張擴充卡		4 張擴充卡	5 張擴充卡	6 張擴充卡
PCI_E2 通道	x16 @	x16 @	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E3 通道	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @	x4 @
PCI_E4 通道	x0	x0	x0	x8 @	x8 @	x4 @	x4 @
PCI_E5 通道	x16	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E6 通道	x0	x0	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x4 @
PCI_E7 通道	x0	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @

@ 表擴充卡安裝插槽

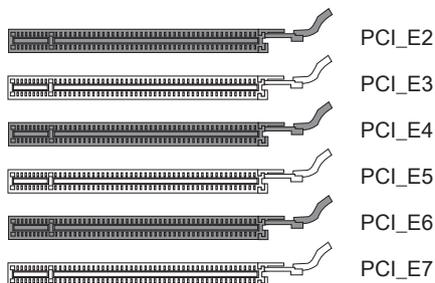
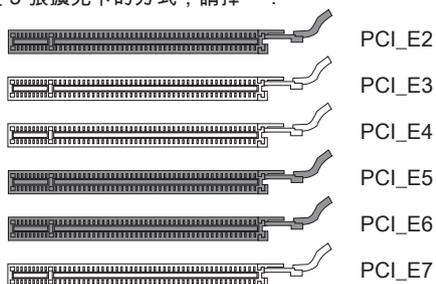
■ 安裝 1 張擴充卡的方式：



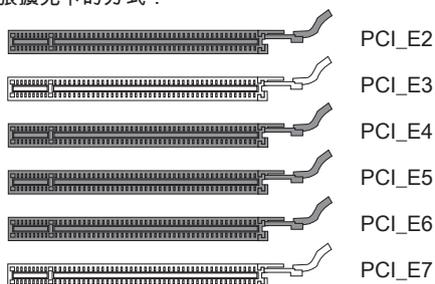
■ 安裝 2 張擴充卡的方式：



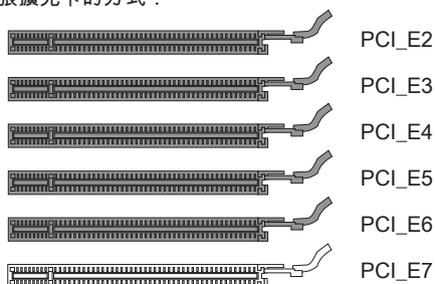
■ 安裝 3 張擴充卡的方式，請擇一：



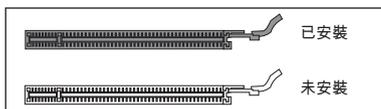
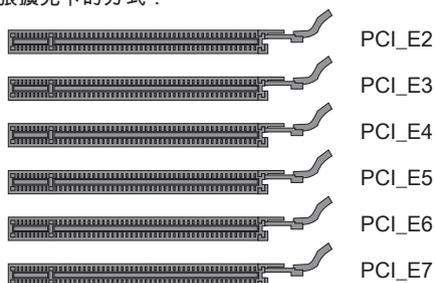
■ 安裝 4 張擴充卡的方式：



■ 安裝 5 張擴充卡的方式：



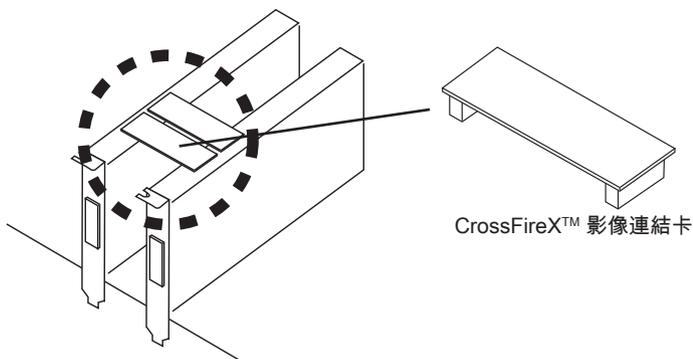
■ 安裝 6 張擴充卡的方式：



ATI CrossFireX™ (Multi-GPU) 技術

ATI CrossFireX™ 技術是可將多個 GPU 發揮極致效能的遊戲平台。開啟遊戲主控電源，本技術即同時執行兩個或兩個以上獨立繪圖處理器以提升整體效能。除了可擴充系統繪圖性能，在有需要時加強繪圖馬力，並支援兩張或兩張以上的 ATI Radeon™ HD 顯卡，無庸置疑是最具擴充性的遊戲平台。本主機板可由軟體自動偵側 CrossFireX™ 模式，因此您不需在 BIOS 開啟 CrossFireX™ 功能。請依以下步驟完成 CrossFireX™ 的硬體安裝。

1. 將 2 張 ATI Radeon™ HD 顯卡分別安裝到 PCI_E2 以及 PCI_E5 插槽。
2. 在兩張顯卡都裝好的情況，請以 CrossFireX™ 影像連結卡將兩張顯卡上方的金手指連接起來(如下圖所示)。請注意，即使已安裝兩張顯卡，但僅有裝在第一張 PCIE x16 插槽的顯卡才有影像輸出，因此僅需將螢幕接到該顯卡即可。



注意事項

- 若要安裝兩張顯卡執行 CrossFireX™ 模式，請確認：
 - a. 兩張顯卡須為同品牌插且同規格；
 - b. 兩張顯卡已安裝在可支援達 PCIE x16 速度的插槽 (PCI_E2 & PCI_E5) 中
- 請於 JPWR4 接頭 (或顯卡上的電源接頭) 接上適合的電壓，以確保顯卡穩定運作。
- 僅限內含 Service Pack (SP2) 的 Windows®XP 版本 & Windows®XP Professional x64 版本以及 Windows® Vista / Windows® 7方可支援 CrossFireX™ 功能。

3. 在所需軟硬體均設定並安裝完成後，請重開機。進入作業系統後，點選桌面上的“Catalyst™ Control Center”圖示。請勾選下圖以啟用 CrossFireX™ 功能。

選擇「檢視」下的「進階檢視」。



注意事項

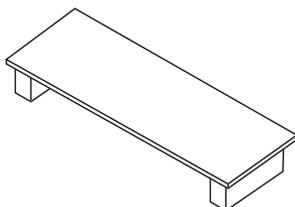
CrossFireX™ 有以下四種顯示模式：

- SuperTiling
- Scissor Mode
- Alternate Frame Rendering
- Super Anti-aliasing

欲知詳情，請參考廠商所提供的顯卡使用手冊。

NVIDIA® SLI 技術

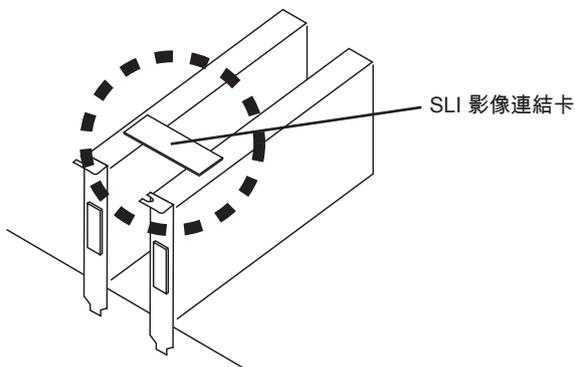
NVIDIA® SLI (Scalable Link Interface) 顯卡串聯傳輸介面技術，讓兩顆 GPU 於同系統中串聯，以達單一顯卡雙倍效能。欲達到該效能，顯卡間須以 SLI 影像連結卡連接。



SLI 影像連結卡

若要使用 SLI 模式達到較佳顯卡效能，請參照下列指示：

1. 在 PCI_E2 & PCI_E5 插槽安裝兩張顯卡。再用 SLI 影像連結卡，將兩張顯卡上方的金手指連接起來(如下圖)。請注意，即使已安裝兩張顯卡，但僅有第一張顯卡會輸出訊號，因此僅需將螢幕接到該顯卡即可。



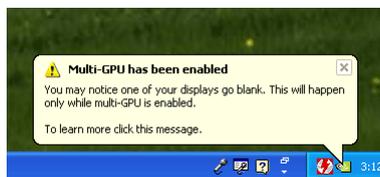
注意事項

- 本節出現的主機板照片僅供參考。外觀會因所購買的主機板型號不同而有所差異。
- 若是安裝兩張 x16 顯卡，請確認兩張顯卡須為同品牌且同規格。
- 請於 JPWR4 接頭 (或顯卡上的電源接頭) 接上適合的電壓，以確保顯卡穩定運作。

2. 完成硬體安裝後，請重新啟動系統，並在顯卡安裝 NV SLI 驅動程式或工具。再來會出現如下之畫面，以設定 Multi-GPU。請勾選 Enable multi-GPU 方塊，以啟用內建顯卡的 SLI 功能 (有關於 Multi-GPU 設定細節，請參閱顯卡隨附的使用手冊)。



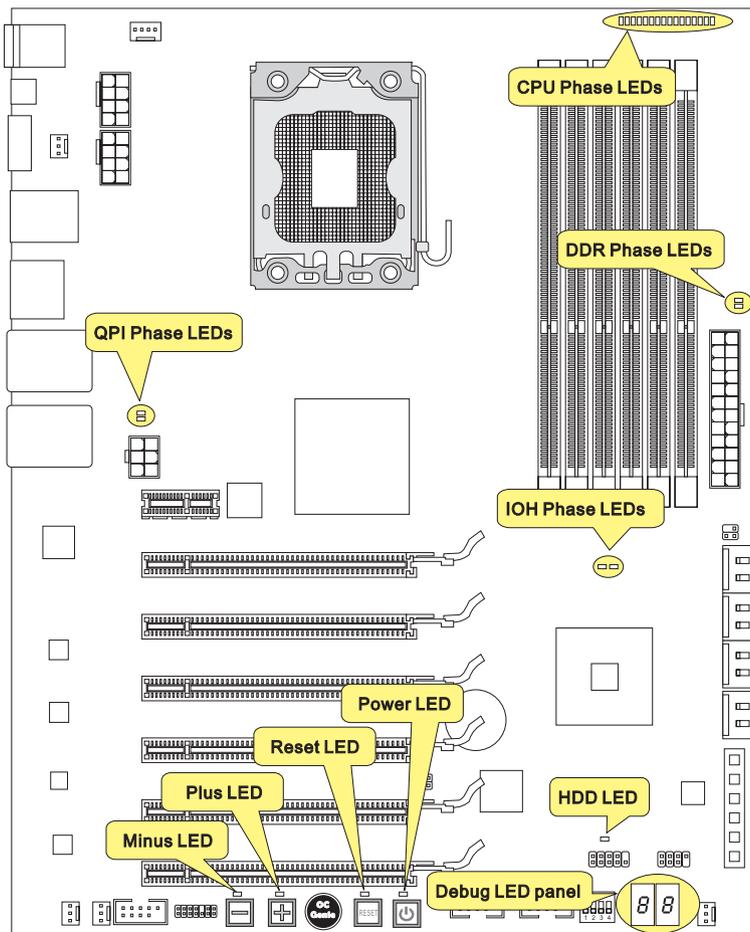
3. 重新啟動系統後，工作列會跳出如下畫面，表示 Multi-GPU 功能已啟用。



注意事項

要移除一張顯卡並跳出 SLI 模式，請確認已關閉“Multi-GPU”功能。

LED 燈號說明 (選配)



CPU 相位燈號 (CPU Phase LEDs)

燈號表目前 CPU 電源相位模式。請依以下說明讀取狀態。

■ 亮 □ 熄滅

■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在單相電源模式
■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在雙相電源模式
■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 3 相電源模式
■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 4 相電源模式
■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 5 相電源模式
■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 6 相電源模式
■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 7 相電源模式
■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 8 相電源模式
■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 9 相電源模式
■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 10 相電源模式
■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 11 相電源模式
■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 12 相電源模式
■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 13 相電源模式
■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 14 相電源模式
■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 15 相電源模式
■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□	表 CPU 在 16 相電源模式

QPI 相位燈號 (QPI Phase LEDs)

以下燈號表目前 QPI 電源相位模式，請參照以下說明：

■ 亮 □ 熄滅

□	表 QPI 在單相電源模式	■	表 QPI 在雙相電源模式
■		■	

IOH 相位燈號 (IOH Phase LEDs)

以下燈號表目前 IOH 電源相位模式，請參照以下說明：

■ 亮 □ 熄滅

■ □	表 IOH 在單相電源模式	■ ■	表 IOH 在雙相電源模式
-----	---------------	-----	---------------

記憶體相位燈號 (DDR Phase LEDs)

以下燈號表目前記憶體電源相位模式，請參照以下說明：

■ 亮 □ 熄滅

□ ■	表記憶體在單相電源模式	■ ■	表記憶體在雙相電源模式
-----	-------------	-----	-------------

硬碟 (HDD LED)

亮燈表硬碟運作中。

電源燈號 (Power LED)

每次按下電源鈕後，燈號閃一下表正常運作。

重開機燈號 (Reset LED)

每次按下重開機鈕後，燈號閃一下表正常運作。

Minus 燈號 (Minus LED)

每次按下 Minus 鈕後，燈號閃一下表正常運作。

Plus 燈號 (Plus LED)

每次按下 Plus 鈕後，燈號閃一下表正常運作。

除錯燈號面板 (Debug LED Panel)

請參閱下表以了解除錯 LED 燈號顯示訊息。

顯示	說明
FF	電源開啟並初始化 CPU
C0, C1, C2	初期初始化 CPU
C4, C6	初始化晶片組
D4, D5	初始化記憶體
08	初始化鍵盤
2A, 31	初始化內建裝置。從 BIOS 下載 Option ROM (VGA 及 RAID option ROM) 到記憶體
37	顯示登入訊息、CPU 資訊、設定主要訊息及所有 OEM 細節
38	初始化 USB 裝置及其它裝置
3C	晶片登記廠商中期 POST 初始化。偵測到其它裝置 (平行埠、序列埠及 CPU 內的協同處理器等)
75, 78	初始化 INT 13 裝置及 IPL 裝置 (包括 SATA/ PATA 硬碟及 CD/DVD 光碟機)
87	進入設定畫面。必要時設定 BIOS
A4	必要時等待使用者於設定畫面輸入
A7	啟用時可顯示系統組態畫面
B1	儲存關於 ACPI (進階組態及電源介面)的系統內容。準備將控制權移轉給 INT 19H 的作業系統載入程式
00	將控制權移轉給 INT 19H 的作業系統載入程式
AA	進入作業系統

BIOS 設定

本章節提供關於 BIOS 設定程式的資訊，讓您將系統效能最佳化。如有下列狀況，請執行此 BIOS 設定程式：

- 系統開機時出現錯誤訊息，並要求執行 BIOS 設定程式。
- 使用者欲改變 BIOS 預設值，另作個人化設定。

注意事項

- 為達最佳效能，我們會持續更新 BIOS 的內容和項目。因此，本章所描述的內容，可能和實際主機板上的所見的 BIOS 內容有所出入。故本章中所提及的設定項目僅供參考。
- 開機後，系統在完成記憶體容量計算後，會在第一行顯示如下訊息：

A7666IMS V1.0 042210 where:

第一個字元 A 表示此程式源頭由 AMI 公司提供; W 表示此程式源頭由
AWARD 公司提供; P 表示此程式源頭由 PHOENIX 公司提供

第二~五字元 表本主機板型號

第六字元 I 表示 Intel 晶片; N 表 NVIDIA 晶片; A 是 AMD 晶片 V 是 VIA 晶片

第七~八字元 MS 表示一般客戶

V1.0 表 BIOS 版本

042210 表 BIOS 發行日期

進入設定

開機後，系統就會開始POST（開機自我測試）程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 鍵，進入設定程式。

Press DEL to enter SETUP (按 DEL 鍵進入設定)

若此訊息在您反應前就已消失，而您還想要進入設定時，請將系統關閉，再重新啟動，或是按 RESET 鍵。亦可同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵重新開機。

操作說明

在進入設定程式後，首先出現主選單的畫面。

主選單

主選單顯示 BIOS 支援的設定類別。請使用方向鍵 (↑↓) 來選擇項目。螢幕下方會顯示反白設定功能的線上說明。

子選單

若看到往右的指標出現，表示仍有相關設定的子選單於其下可供選擇。

請使用方向鍵 (↑↓) 來選取欄位，並按 <Enter>，叫出該子選單。然後用控制鍵，於子選單中輸入數值及移動欄位。若想回到主目錄，只需按下 <Esc> 即可。

一般求助 <F1>

BIOS 設定程式提供一般求助的畫面，你可於任何選單中，按下 <F1> 叫出。求助畫面會列出反白欄位的可用選項及按鍵供您選擇。按 <Esc>，即可跳出求助視窗。

主選單

進入 BIOS CMOS 設定公用程式後即出現主選單。您可利用方向鍵於下列設定選項中選擇，再按下<Enter>鍵接受該選項後進入子選單。



▶ **Standard CMOS Features (標準 CMOS 功能)**

使用本選單設定基本的系統組態，例如時間、日期等。

▶ **Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能)**

使用本選單設定特殊的進階功能。

▶ **Integrated Peripherals (整合型週邊)**

使用本選單設定整合型週邊裝置。

▶ **Power Management Setup (電源管理設定)**

使用本選單設定電源管理。

▶ **H/W Monitor**

本選單顯示 PC 狀態。

▶ **Green Power**

本選單可指定電源相位。

▶ **BIOS Setting Password (設定 BIOS 密碼)**

使用本選單設定 BIOS 密碼。

▶ **Cell Menu**

本選單可指定頻率、電壓控制以及超頻。

▶ **M-Flash**

使用本選單由儲存裝置 (FAT 或 FAT32 格式) 讀取或 flash BIOS。

▶ **Overclocking Profile (超頻概述)**

使用本選單儲存自訂設定到 BIOS CMOS 或由 BIOS CMOS 載入。

▶ **Load Fail-Safe Defaults (載入安全預設值)**

本選單載入由 BIOS 廠商設定的穩定效能預設值。

▶ **Load Optimized Defaults (載入最佳預設值)**

使用本選單載入由主機板廠商設定的最佳效能預設值。

▶ **Save & Exit Setup (儲存後離開設定)**

將變更儲存到 CMOS 後離開設定程式。

▶ **Exit Without Saving (離開但不儲存)**

放棄所有變更後離開設定程式。

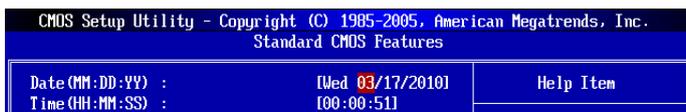
要執行一般使用，請在進入 BIOS 設定公用程式後，請依下列步驟進行。

1. 載入最佳預設值: 使用上下鍵 (↑↓) 反白「載入最佳預設值」欄位，再按 <Enter> 會出現下面的訊息：



選擇 [Ok]，再按<Enter>，即可載入展現系統最佳效能的預設值。

2. 設定日期及時間: 選擇「標準 CMOS 功能」，再按<Enter>進入該選單來調整日期及時間。



3. 儲存後離開設定: 使用上下鍵反白「儲存後離開設定」欄位，再按 <Enter> 會出現下面的訊息：

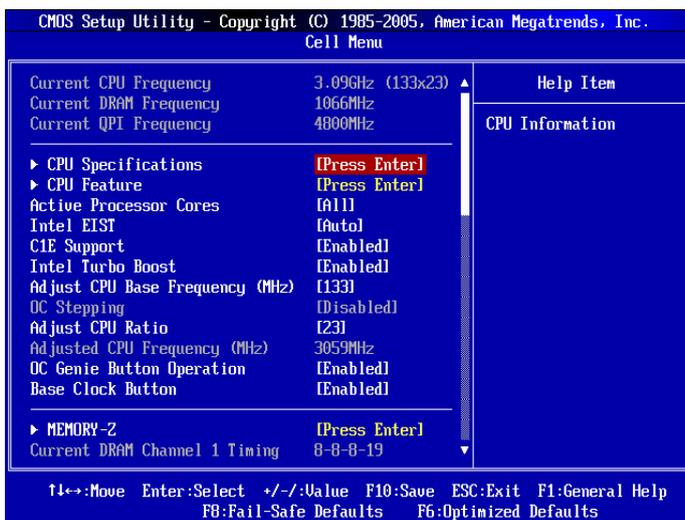


選擇 [Ok]，再按<Enter>，即可儲存設定後離開 BIOS 設定公用程式。

注意事項

上述設定僅供一般設定使用，若需詳細 BIOS 設定，請參閱微星科技網站上之英文手冊內容。

4. Cell Menu 簡介: 本選單提供給要超頻主機板的進階使用者。



注意事項

除非對晶片組功能非常熟悉，否則請勿任意變更設定。

▶ Current CPU / DRAM / QPI Frequency (目前 CPU/ 記憶體/ QPI 頻率)

上述選項顯示 CPU、記憶體以及 QPI 的頻率。唯讀。

▶ CPU Specifications (CPU 規格)

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。本子選單顯示已安裝的 CPU 訊息。

▶ CPU Technology Support (CPU 支援技術)

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。

▶ CPU Feature (CPU 功能)

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。

▶ Intel EIST (Intel 節電技術)

Intel Enhanced Intel SpeedStep 技術依電腦使用電池或接 AC 交流電源的情況，來設定微處理器的效能表現。本項在安裝支援 Intel SpeedStep 技術的 CPU 才會顯示。

▶ Intel C-STATE (Intel C-STATE 技術)

C-state 是可於處理器閒置時大幅減低耗電的一種電源管理狀態。本欄位需安裝支援 c-state 技術的處理器才會顯示。

▶ C State Package Limit Setting

本項選擇 C-state 等級，建議值為自動 [Auto]。

▶ C1E Support (支援 C1E 功能)

開啟本功能會在 CPU 閒置時，減低電量的耗損。並非所有處理器均支援 Enhanced Halt state (C1E) 功能。

▶ OverSpeed Protection (超速保護)

超速保護可監控目前 CPU 流量以及電源耗損狀況。在超出特定範圍時，處理器會自動減低時脈速度。若要超頻 CPU，請將本項設為關閉 [Disabled]。

▶ Hyper-Threading Function (超執行緒功能)

當處理器使用超執行緒功能時，可增加並提升效能。本技術可於一顆實體的處理器上，偵測到二個虛擬處理器，並同時執行兩個執行緒。若關閉本功能，處理器只會使用一個核心來運作。若作業系統不支援，請設為關閉以免系統不穩。

注意事項

要開啟「超執行緒技術」功能，需符合下列「所有」系統需求：

- CPU：支援「超執行緒技術」的 Intel® 處理器；
- 晶片組：支援「超執行緒技術」的 Intel® 晶片組；
- BIOS：支援「超執行緒技術」的 BIOS 並已設為「開啟」；
- 作業系統：支援「超執行緒技術」的作業系統。

欲知更多關於「超執行緒技術」功能的資訊，請上網查詢：

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm

▶ Execute Bit Support (支援病毒防護技術)

本項功能可保護記憶體緩衝區溢位，避免病毒擴散。在作業系統支援本功能時，保護記憶體緩衝區溢位避免病毒擴散。本功能讓處理器定義記憶體中可執行與不可執行應用程式碼之處。在病毒試著於緩衝區內置入病毒碼時，處理器即可關閉該碼執行以免病毒擴散。

▶ Set Limit CPUID MaxVal to 3

Max CPUID Value Limit 本設定針對處理器於較舊的作業系統中限制速度。

▶ Intel Virtualization Tech (Intel 虛擬化技術)

本項開啟或關閉 Intel 虛擬化技術的最高值設定。細節請參閱 Intel 官方網站。

▶ **Intel VT-d (Intel VT-d 技術)**

本項開啟或關閉 Intel 的直接輸入/輸出控制的虛擬技術 (Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d))。細節請參閱 Intel 官方網站。

▶ **Active Processor Cores (Active Processor 核心數)**

本項選擇 active processor 的核心數。

▶ **Intel EIST (Intel 節電技術)**

Intel Enhanced Intel SpeedStep 技術依電腦使用電池或接 AC 交流電源的情況，來設定微處理器的效能表現。本項在安裝支援 Intel SpeedStep 技術的 CPU 才會顯示。

▶ **C1E Support (支援 C1E 功能)**

開啟本功能會在 CPU 閒置時，減低電量的耗損。並非所有處理器均支援 Enhanced Halt state (C1E) 功能。

▶ **Intel Turbo Boost (Intel Turbo Boost 技術)**

本項在安裝支援本技術的處理器時方會出現，用來開啟或關閉本技術。Intel Turbo Boost 技術可於程式有效能需求且指定 TDP 時，動態逐步提升處理器頻率。本技術還可呈現流暢的電源效能 (動態提升或 Speed-Step 下降)。

▶ **Adjust CPU Base Frequency (MHz) (調整 CPU Base 頻率)**

本項設定 CPU base clock (以 MHz 計)。您可調整本數值來超頻處理器。注意我們不保證超頻的成功與否。

▶ **OC Stepping**

本項在「調整 CPU Base 頻率」設好超頻頻率後即會開啟，且以下項目均可調整。本項有助系統在開機後按部就班的超頻。

▶ **Start OC Stepping From (MHz)**

本項設定初始 base clock。系統會先以初始 base clock 來開機後，再以初始 base clock 漸進超到您剛才於「調整 CPU Base 頻率」選項所設定的超頻頻率為止。

▶ **OC Step (超頻漸進值)**

本項設定到 base clock 數值前的漸進值。

▶ **OC Step Count Timer (超頻漸進值緩衝時間)**

本項設定每個漸進值的緩衝時間。

▶ **Adjust CPU Ratio (調整 CPU 倍頻比率)**

本項調整 CPU 倍頻比率。

▶ **Adjusted CPU Frequency (MHz) (調整後 CPU 頻率)**

本項顯示調整後 CPU 的頻率 (Base clock x 倍頻比率)。唯讀。

▶ **OC Genie Button Operation (易超頻按鈕操作)**

本項開啟或關閉 OC Genie 易超頻按鈕功能。

▶ **Base Clock Button (Base Clock 按鈕)**

本項用以開啓或關閉 base clock 按鈕的功能。

▶ **MEMORY-Z**

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。

▶ **DIMM1~6 Memory SPD Information (DIMM1~6 記憶體 SPD 訊息)**

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。本項顯示已安裝記憶體訊息。

▶ **Current DRAM Channel 1/2/3 Timing (目前記憶體通道 1/2/3 時序)**

本項顯示已安裝的記憶體時序。唯讀。

▶ **DRAM Timing Mode (記憶體時序模式)**

選擇 DRAM 的時序，是否由 DRAM 模組上的 SPD EEPROM 裝置來控制。設為 [Auto] 開啟記憶體時序，而「進階記憶體設定」下的子選單即可由 BIOS 依 SPD 上的組態來設定。設為 [Manual] 時，則以手動方式更改 DRAM 時序及「進階記憶體設定」子選單相關項目。

▶ **Advance DRAM Configuration (進階記憶體設定)**

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 1T/2T Memory Timing
(通道 1/2/3 或通道 1~3 1T/ 2T 的記憶體時序)**

本項控制 SDRAM 指令速率。若選 [1]，則 SDRAM 信號控制器會以 1 個週期速率執行 (N 表時序週期)，選 [2]，則以 2 個週期執行。

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 CAS Latency (CL)**

本項控制行位址信號 (CAS) 延遲，也就是於 SDRAM 接收讀取指令後，開始進行讀取前的延遲時間 (以時脈計)。

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRCD**

在 DRAM 更新時，列和欄位址是分開處理的。本項設定列位址 (RAS) 到行位址 (CAS) 之間的過渡時間。時脈數越少，記憶體的效能越好。

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRP**

本項控制列位址 (RAS) 預充電的時脈。若未累積足夠時間，讓列位址在記憶體更新之前預充電，更新可能會不完全，且記憶體可能漏失資料。本項僅適用於系統安裝同步動態隨機存取記憶體時。

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRAS**

本項指定 RAS 由讀取到寫入記憶體所需時間。

▶ **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRFC**

本項決定 RFC 由記憶體讀取及寫入記憶體所需時間。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tWR

本項是寫入資料結束到預充電指令開始間的最短間距。本項透過感覺放大器 (sense amplifier) 回復資料。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tWTR

本項是寫入資料脈衝結束到列讀取指令開始間的最短時間。輸出入開道會先驅動感覺放大器，再開始讀取指令。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRRD

本項設定不同記憶體間 (active-to-active) 的延遲時脈。讀取到預充電指令間的時間差。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRTP

本項設定讀取到預充電間的時間。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tFAW

本項設定 tFAW 時序。

▶ Current CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRdTWr/ tdrRdTWr/ tddRdTWr/ tsrWrTRd/ tdrWrTRd/ tddWrTRd/ tdrWrTWr/ tddWrTWr/ tsrRdTRd/ tsrWrTWr

這些選項顯示進階記憶體時序。

▶ Channel 1/ Channel 2/ Channel 3 or Channel 1-3 Advance Timing
(通道1/2/3 或通道1~3 進階時序設定)

設為自動 [Auto] 時，自動由 BIOS 來設定進階記憶體時序。設為手動 [Manual] 時，則可自行設定進階記憶體時序。

▶ Extreme Memory Profile (X.M.P.)

本項開啟或關閉 Intel XMP 技術。(X.M.P.)。細節請參閱 Intel 官方網站。

▶ Memory Ratio (記憶體倍頻比率)

本項設定記憶體倍頻比率。

▶ Adjusted DRAM Frequency (MHz) (調整後記憶體頻率)

本項顯示調整後記憶體的頻率。唯讀。

▶ Uncore Ratio (開核倍頻比率)

本項設定開核倍頻比率。

▶ Adjusted Uncore Frequency (MHz) (調整後開核頻率)

本項顯示調整後開核頻率。唯讀。

▶ QPI Links Speed (QPI 連結速度)

本項用以選擇 QPI 連結速度的模式。

▶ QPI Frequency (QPI 頻率)

本項可設定 QPI 頻率。

▶ Adjusted QPI Frequency (MHz) (調整後 QPI 頻率)

本項顯示 QPI 頻率。唯讀。

▶ ClockGen Tuner

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。

▶ CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control

這些選項是用來選擇 CPU/ PCI Express 時脈振幅。

▶ CPU CLK Skew/ MCH CLK Skew

這些選項是用來選擇 CPU/ MCH 晶片組時脈 skew，有助於將 CPU 超頻效能推至更高層次。

▶ Adjust PCI-E Frequency (MHz) (調整 PCI-E 頻率)

本項設定 PCIE 頻率 (MHz)。

▶ VDroop Control

本項用來避免在系統高負載時大量電壓暴降。

▶ CPU Voltage (V)/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ IOH Voltage (V)/ IOH PCIE Voltage (V)/ ICH Voltage (V)

上述選項用來調整 CPU、記憶體、晶片組等的電壓。

▶ Spread Spectrum (展頻)

主機板的時脈產生器開展到最大時，脈衝的極大值突波，會引起電磁波干擾(EMI)。展頻功能，可藉由調節脈衝以減少 EMI 的問題。

注意事項

- 若無電磁波干擾 (EMI) 的問題，請設為關閉 [Disabled]，以達較佳的系統穩定性及效能。但若符合 EMI 規範，請選擇要減少電磁波的範圍。
- 展頻的數值越大，可減少較多電磁波，但相對系統就越不穩定。欲知展頻適當數值，請查詢當地規範。
- 如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，均足以引起時脈速度的增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。

注意事項

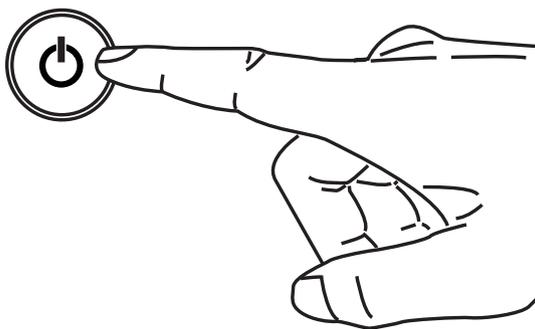
超頻失敗的解決方法

本主機板的設計可支援超頻的功能。但前提是需確認零件可承受超頻此異常設定。基本上，我們不建議任何超出產品規格的操作設定。對於不當操作或超出產品規格的模式所引起的損壞及危險，我們亦不提供任何保固。

將系統由超頻失敗救回的二個方法...

• 重新開機

按電源鈕將系統重開三次。請務必注意，每次開機均須間隔十秒以上，以避免電流影響其它裝置或零組件。



在第四次開機時，BIOS 會認定先前的超頻失敗，並自動恢復原設定。請在下列訊息出現時，按任意鍵正常開機。

```
Warning !!! The previous overlocking had failed,  
and system will restore its defaults setting,  
Press any key to continue.....
```

• 清除 CMOS

請參閱本手冊中「清除 CMOS 資料」的方法。

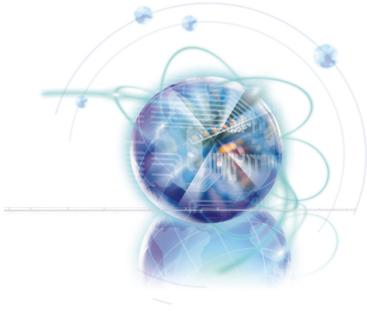
軟體訊息

請取出隨附的驅動程式或公用程式光碟片，並放入光碟機中。該軟體會自動執行，請點選該驅動程式或公用程式，接著照跳出視窗指示即可完成安裝。驅動程式或公用程式光碟片內含：

- 驅動程式選單：本選單顯示所有可用驅動程式。請依個人需求安裝啟用裝置。
- 公用程式選單：本選單列出主機板支援的軟體程式。

注意事項

若要取得最新驅動程式及 BIOS 以獲較佳系統效能，請上微星科技網站取得相關訊息。



简体中文

XPower 系列

Asia version

主板规格

处理器支持

- LGA1366 封装支持 Intel® Bloomfield™ 处理器
(要了解CPU的最新信息, 请访问
<http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2>)

QPI

- 高达每秒 6.4 GT

芯片组

- 北桥: Intel® X58 芯片
- 南桥: Intel® ICH10R 芯片

内存支持

- 6 条 DDR3 DIMM 支持 DDR3 2133*(超频)/ 1800*(超频) /1600*(超频)/ 1333/ 1066 / 800 DRAM (最大 24GB)
- 支持双通道/ 三通道模式
*(要了解更多模组兼容性问题, 请访问
<http://www.msi.com/index.php?func=testreport>)

LAN

- 通过 Realtek® RTL8111DL 支持两组 10/100/1000 快速以太网

IEEE 1394

- 通过 VIA® VT6315N 支持 1 个 IEEE 1394 端口

QuantumWave 声卡

- 由 Realtek® ALC889 芯片集成
- 兼容 Azalia 1.0 规范
- 带插口侦测的 8 声道高清晰度音频编解码器
- 支持 1x S/PDIF 输出端头
- 支持后置同轴及光纤 S/PDIF 输出端口

SATA

- 通过 Intel® ICH10R 支持 6 个 3Gb/s SATA (SATA1~6) 端口
- 通过 Marvell® 88SE9128 支持 2 个 6Gb/s SATA (SATA7~8) 端口
- 通过 JMicron® JMB362 支持 1 个 ESATA 及 1 个 ESATA/ USB 2.0 组合端口 (后置面板)
- 支持热插拔和异步通知

USB 3.0

- 通过 NEC® uPD720200F1 支持 2 个 USB 3.0 端口

RAID

- 通过 Intel® ICH10R 芯片 SATA1~6 支持 Intel® 阵列存储技术 (AHCI/ RAID 0/1/5/10)
- 通过 Marvell® 88SE9128 芯片 SATA7~8 端口支持 RAID 0/ 1 模式

接口

- 后置面板
 - 1 个 PS/2 键盘端口
 - 1 个 PS/2 鼠标端口
 - 1 个 清除 CMOS 按钮
 - 1 个 D-LED2 面板接口
 - 1 个 IEEE1394 端口
 - 5 个 USB 2.0 端口
 - 1 个 ESATA 端口
 - 1 个 ESATA/ USB 2.0 组合端口
 - 2 个 LAN 端口
 - 2 个 USB 3.0 端口
- 板载周边接口
 - 2 个 USB 2.0 接口
 - 1 个 IEEE1394 接口
 - 1 个 机箱入侵检测接口
 - 1 个 TPM 模组接口
 - 1 个 重启按钮
 - 1 个 电源按钮
 - 1 个 节能精灵接口 (选配)
 - 1 个 超电压开关
 - 1 组 电压检测点
 - 1 个 超频精灵按钮
 - 2 个 基频控制按钮
 - 1 组 调试指示灯面板

插槽

- 6 个 PCI Express 2.0 x16 插槽 (PCI_E2 & PCI_E5 支持高达 PCIE x16 速率, PCI_E4 & PCI_E6 支持高达 PCIE x8 速率, PCI_E3 & PCI_E7 支持高达 PCIE x4 速率)
- 1 个 PCI Express 1.1 x1 插槽

出厂规格

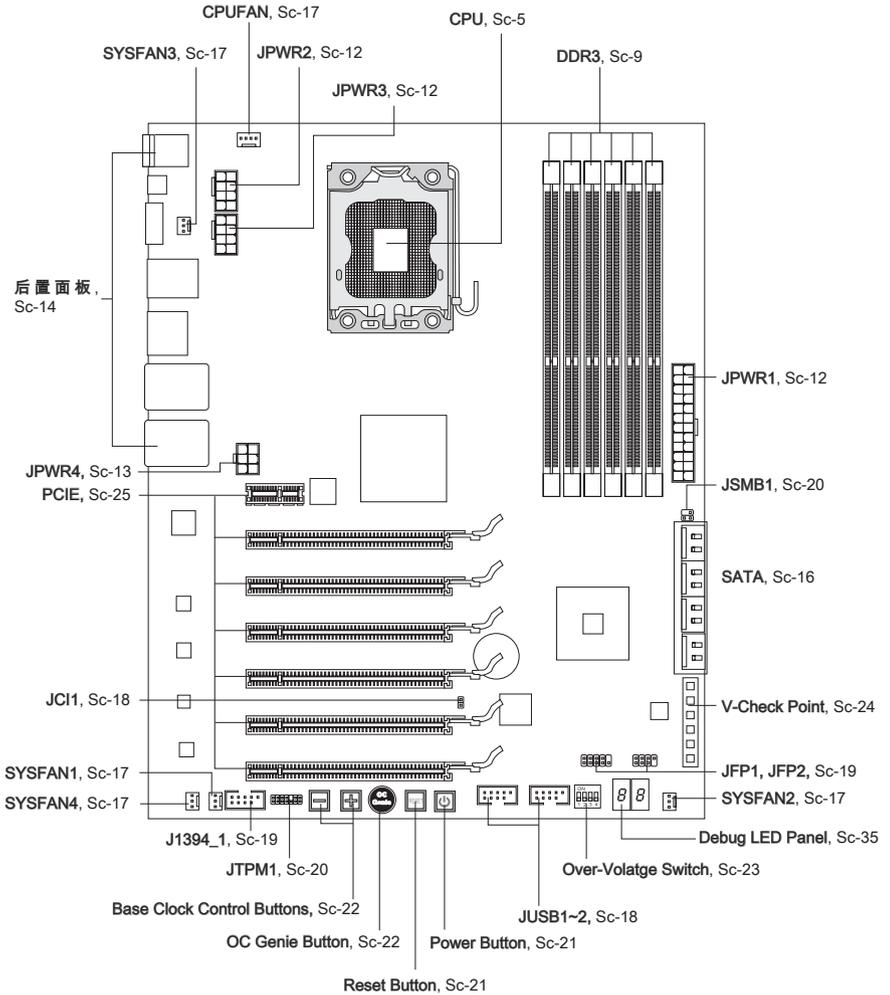
- ATX (24.4 公分 X 30.5 公分)

固定孔

- 9 个固定孔

*如果您需要购买配件,并要求零件号码,您可以搜索该产品的网页来获得详细说明。
网址为: <http://www.msi.com/index.php>

组件快速指南



CPU (中央处理器)

当您在安装CPU时,请务必确认您使用的CPU带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的CPU没有散热片和降温风扇,请与销售商联系,并在开机之前妥善安装。

要了解CPU的最新信息,请访问

<http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2>

注意

过热

温度过高会严重损害CPU和系统,请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作,保护CPU以免过热烧毁。确认,您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带)以增强散热。

更换 CPU

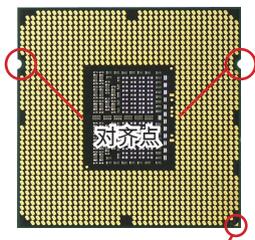
更换CPU时,请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。

超频

主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设置。在超频时,不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不承担损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。

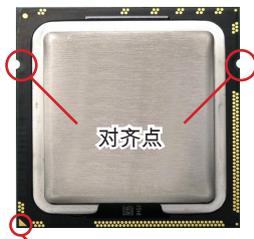
LGA 1366 CPU 简介

LGA 1366 的CPU针脚面。



黄色的三角指示为Pin1

LGA 1366 CPU 的表面,使用一些散热胶涂在 CPU 表面,使它更好的散热。



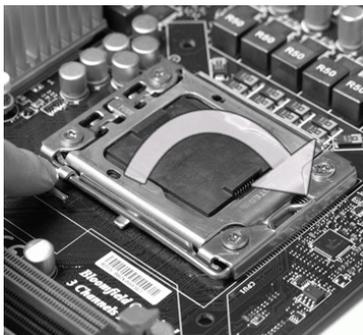
黄色的三角指示为Pin1

CPU和风扇的安装

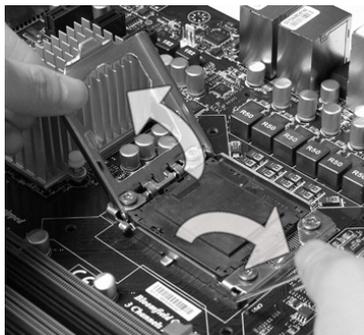
当您安装CPU时，确认CPU带有散热片和风扇放置在CPU的顶部，以防止CPU过热。如果您没有散热片和风扇，请联系经销商以购买并安装前先关闭计算机。请不要忘记使用一些散热胶涂在CPU的表面，使它更好的散热。

请根据以下步骤正确安装CPU和风扇，错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

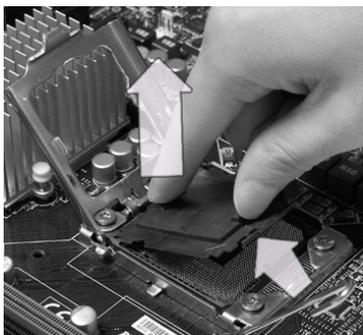
1. 开启钉钩。



2. 开启拉杆，再打开CPU盖盘。



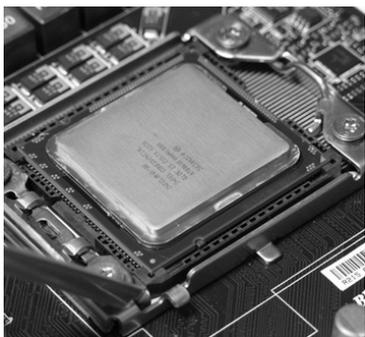
3. CPU插槽上面有一个塑料保护盖，以保护CPU避免受损。您在安装CPU之前，请不要取下此塑料保护盖，以防止触点受损。取下塑料保护盖（如箭头所示）。



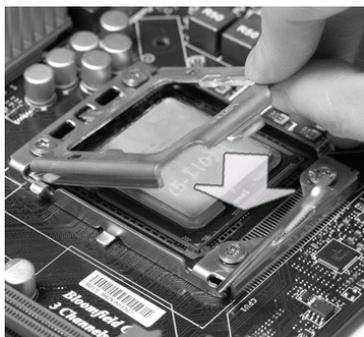
4. 在确定了CPU正确安装方向后，将CPU插入插槽中，抓紧CPU的底部边缘。注意，一定要与CPU的缺口相对应。



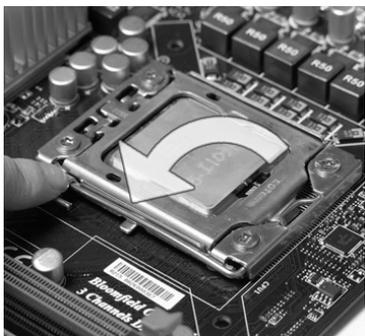
5. 目测CPU是否已经安装于插槽中，如果没有安装，垂直的取出CPU并重新安装。



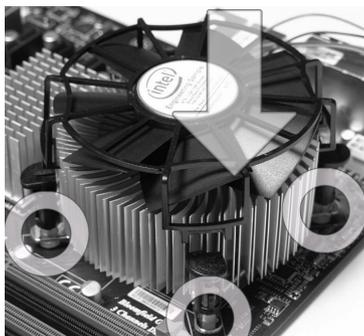
6. 合上盖盘。



7. 轻轻按下拉杆，然后用底座边的钩子勾住压杆。



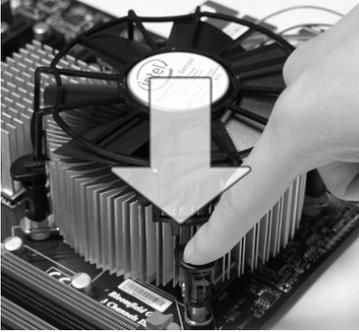
8. 对齐风扇和主板上的安装孔。将风扇用力向下压，直到四个挂钩卡进主板的四个孔里。



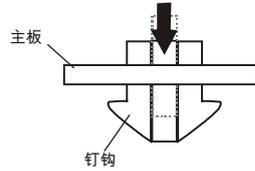
注意

- 在您开机之前，请确认CPU风扇已经正确安装。
- 请勿触摸CPU插槽触点，以避免受损。

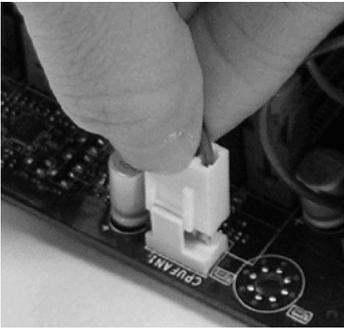
9. 压下四个钉钩以固定风扇。



10. 翻转主板，以确认四个钉钩是否正确插入。



11. 最后，将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。



注意

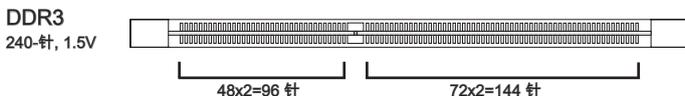
- 请在BIOS中查看关于CPU的信息。
- 只要CPU尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在CPU插槽上，以避免插槽受损（如图1所示）。
- 显示在这部分的主板图片仅作为CPU/散热装置安装的示范。您的主板可能因为购买的型号而不同。
- 关于CPU风扇安装详细描述，请参考CPU风扇包装里的文档说明。

内存

DIMM插槽用来安装内存模块。

要了解内存模组支持的更新信息，请访问

<http://www.msi.com/index.php?func=testreport>



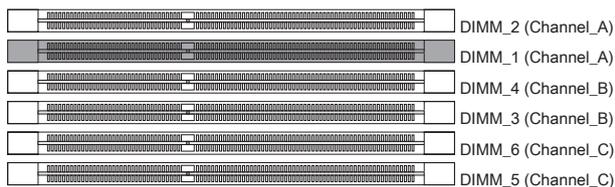
内存插入规则

请参阅下列关于内存插入规则说明。

单通道模式

当您只有一条内存模块时，请首先插入 DIMM_1 (在PCBV1.0版本，名称为DIMM_A0) 内存插槽中。

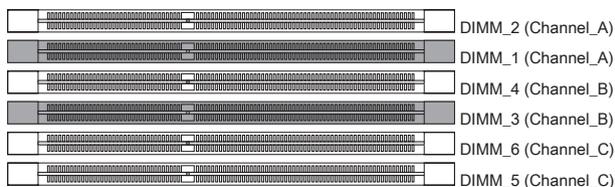
①



双通道模式

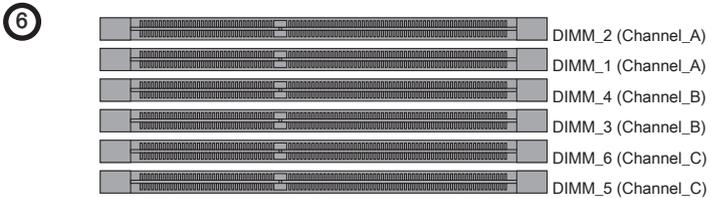
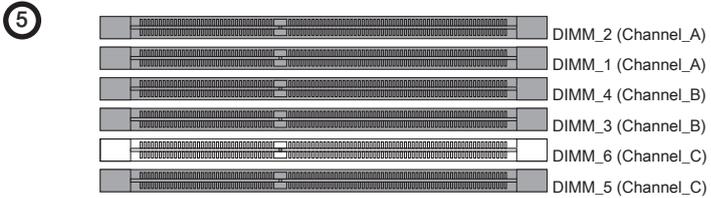
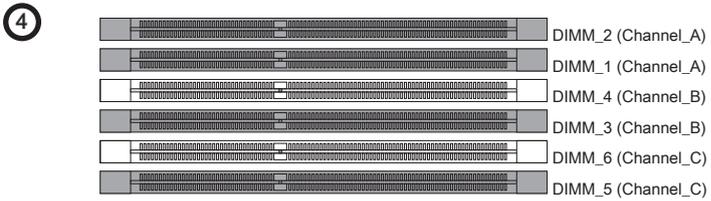
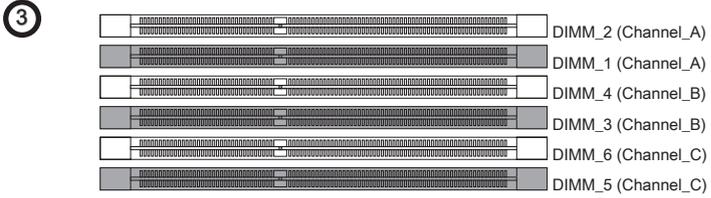
在双通道模式，内存模块能够在二组数据总线下同时传输和接收数据。打开双通道模式可以提高系统性能。当您有两条内存条时，请按照下图显示来插入内存。

②



三通道模式

在三通道模式下，内存条能够同时使用三条数据总线发送或接收数据。三通道模式可以增强系统性能，当你有三条以上的内存模块时，请按照下图显示来插入内存。



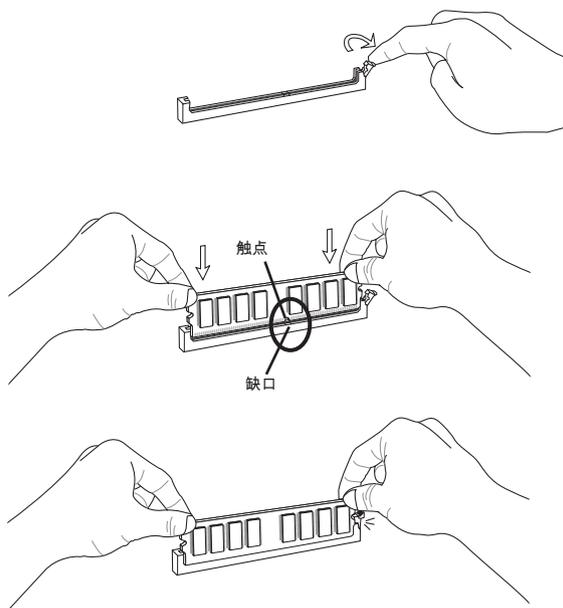
注意

- 由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。
- 在双/三通道模式下，请确认，不同通道的内存插槽中，一定要使用同类型同密度的内存。

- 要成功的启动系统，必须首先将内存模块插入DIMM_1(在PCBV1.0版本，名称为DIMM_A0) 插槽中。
- 由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根4GB内存时，系统仅能检测出最高大于23+GB (不足24GB)。

安装内存模组

1. 内存模组的中央仅有一个缺口，内存将被正确的安装到插槽中。
2. 垂直插入内存模组到DIMM插槽，然后将其推入，直到内存模块金手指部分完全插入。当内存模组完全到位，二边塑料卡口将自动闭合。
3. 手动检查内存模块是否由内存槽孔夹完全锁定。



注意

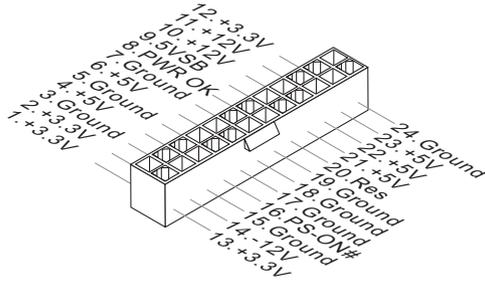
如果您正确的插入了内存，您将看不到金手指部分。

电源适配器

ATX 24-pin 电源接口: JPWR1

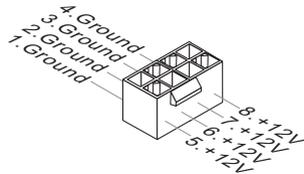
此接口可以连接ATX 24-pin电源适配器。在与ATX 24-pin电源适配器相连时，请务必确认，电源适配器的接头安装方向正确，针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入，并使其与主板电源接口稳固连接。

若您喜欢，可以使用20-pin ATX电源适配器，如果您使用20-pin ATX电源适配器，请顺着pin1和pin13插上电源适配器。



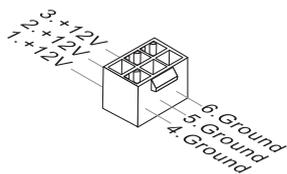
ATX 8-pin 电源接口: JPWR2/ JPWR3

此接口用来为CPU提供12V电源。



ATX 6-pin 电源接口: JPWR4

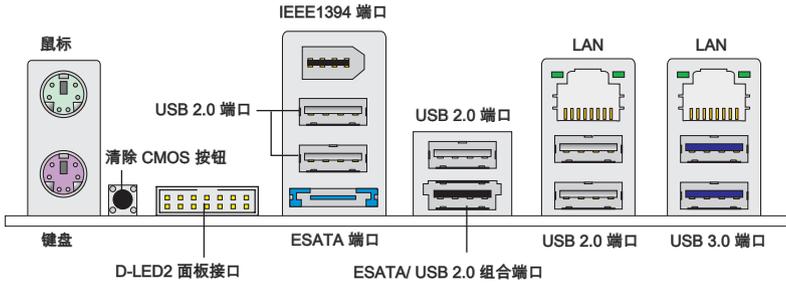
此接口用来为显卡提供电源。



注意

- 确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板提供稳定的工作电流。
- 为了系统稳定，强烈建议您使用450瓦(或更大功率)的电源适配器。

后置面板



▶ 鼠标/ 键盘

主板提供一个标准的 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口。可连接一个 PS/2® 鼠标/键盘。

▶ 清除 CMOS 按钮

此主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候引导操作系统的。如果您想清除系统配置，可使用按钮清除数据。按下按钮清除数据。

注意

在清除 CMOS 数据前请确保已关闭系统电源。

在关机(G3)状态，按下此按钮清除 CMOS 数据后系统将自动重新启动。

▶ D-LED2 面板接口

此接口用来连接一个 D-LED2 (调试-LED2) 面板 (选配)，这样可以为您显示出面板上的信息，并且可以指示被连接系统的当前状态或工作模式。请参阅D-LED2 快速指南 (选配) 了解更多详细信息和用法。

▶ IEEE 1394 端口

后置面板 IEEE1394 端口用于连接 IEEE1394 设备。

▶ USB 2.0 端口

USB(通用串行总线)端口用于连接USB设备，如键盘，鼠标或其他USB兼容设备。支持数据传输速率高达每秒 480Mbit (高速)。

▶ ESATA 端口

此 ESATA (External SATA) 端口用于连接外置ESATA设备。

▶ ESATA/ USB 2.0 组合端口

此 ESATA/USB 2.0 组合端口用于连接外置ESATA硬盘或USB设备。

▶ USB 3.0 端口

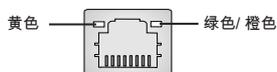
此USB 3.0向后兼容USB 2.0设备。支持数据传输速率每秒5 Gbit (超高速)。

注意

如果您打算使用 USB 3.0 设备，必须使用 USB 3.0 电缆线连接 USB 3.0 端口。

▶ LAN

标准的RJ-45插孔以连接到局域网(LAN)，
你可以将一个网络线缆连接其上。

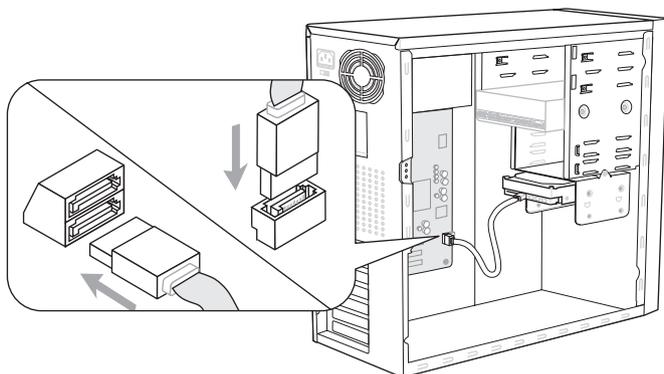


LED	颜色	LED 状态	状况
左边	黄色	关	网络未连接。
		开(稳定状态)	网络连接正常。
		开(闪烁)	此计算机与其他计算机使用网络通信中。
右边	绿色	关	10 Mbit/秒数据传输。
		开	100 Mbit/秒数据传输。
	橙色	开	1000 Mbit/秒数据传输。

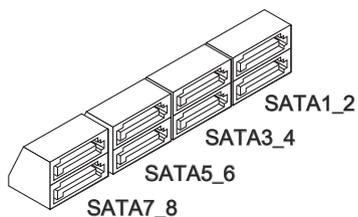
接口

串行 ATA 接口: SATA1~8

此接口是高速传输的Serial ATA界面端口。每个接口都可以连接 1 个Serial ATA设备。



* 此主板图片布局仅供参考。



Intel® ICH10R 支持 SATA1~6
(3Gb/s)

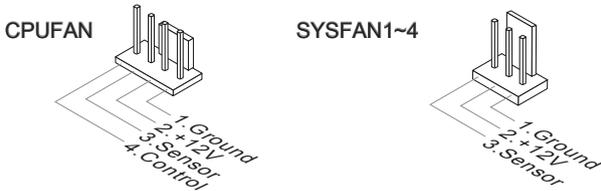
Marvell® 88SE9128 支持 SATA7/
SATA8 (6Gb/s)

注意

请勿将Serial ATA数据线对折成90度，否则，会造成在传输过程中的数据丢失。

风扇电源接口: CPUFAN, SYSFAN1~4

风扇电源支持+12V的系统散热风扇。当您将接线接到风扇接头时请注意红色线为正极，必须接+12V，而黑色线是接地，必须接到GND。如果您的主机板有系统硬件监控芯片。您必须使用一个特别设计的支持风扇速度侦测的风扇方可使用此功能。

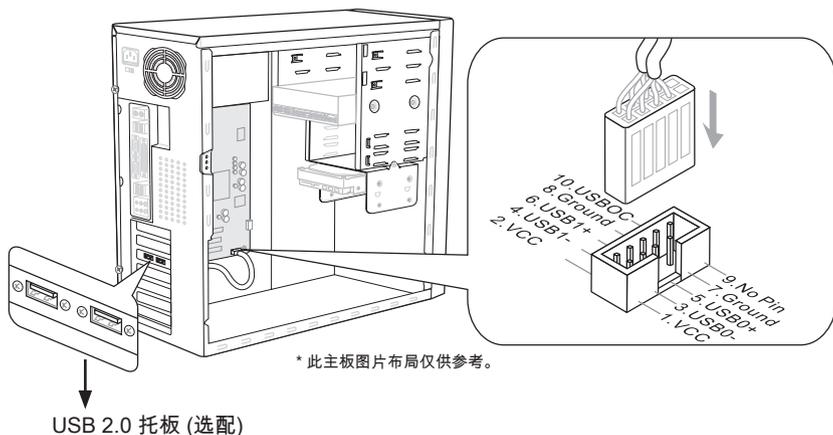


注意

- 请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。
- CPUFAN 支持风扇控制，您可以安装 Control Center 工具以根据当前 CPUFAN 温度自动控制 CPUFAN 的速度。

前置 USB 接口: JUSB1 / JUSB2

此接口与 Intel® 的 I/O 面板连接规格兼容。可以连接高速的 USB 界面周边，例如 USB HDD，数码相机，MP3 播放器，打印机，调制解调器等。

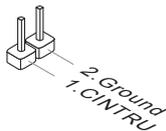


注意

请注意，VCC和GND的针脚必须安插正确，否则可能引起主板零件的损坏。

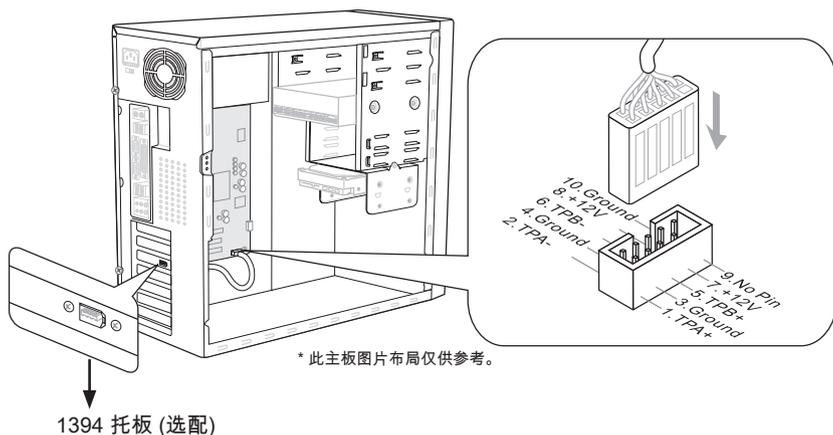
机箱入侵开关接口: JCI1

此接头与机箱开关相连。如果机箱被打开了，此接头会短接，系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。



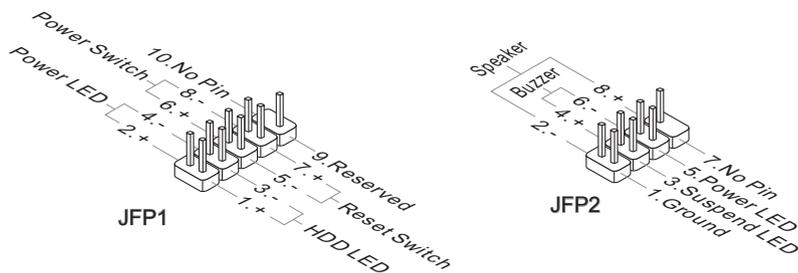
IEEE1394 接口: J1394_1

此接口允许您使用选配的 IEEE1394 挡板连接 IEEE1394 设备。



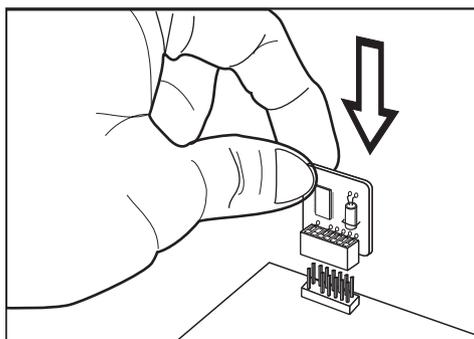
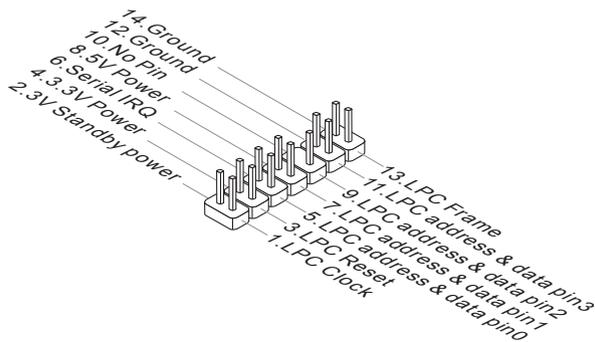
前置面板接口: JFP1, JFP2

此接口用于连接前置面板开关、指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。



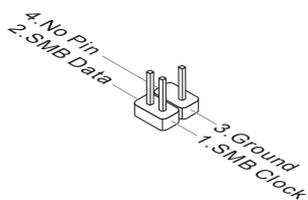
TPM 模组接口: JTPM1

此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。



GreenPower Genie 接口: JSMB1 (选配)

此接口用来连接 GreenPower Genie (选配)。



按钮

此主板提供如下的按钮用于您设定计算机功能。此节将介绍如何通过使用按钮改变您的主板功能。

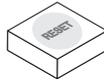
Power Button (电源按钮)

电源按钮用于打开或关闭系统。按此按钮打开或关闭系统。



Reset Button (重启按钮)

重启按钮用于重启系统。按重启按钮重新启动系统。



OC Genie Button (超频精灵按钮)

这个按钮用来为系统自动超频。在系统处于关机状态时，按下这个按钮可以启动自动超频功能。此时，这个按钮会变亮并锁定。系统启动后，会自动侦测并超频到最优值。在关机后，再次按下这个按钮，就可以关闭自动超频功能。这时，这个按钮会变暗并解锁，到下次系统重启时系统会恢复默认值。



注意

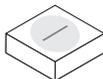
- 在使用超频按钮功能时，请安装DDR3 1333 或以上内存并配置更好的散热片/散热器。
- 我们将不承诺OC Genie超频达到的范围，任何OC Genie超频行为所导致的损坏和风险得不到保障。
- 我们可以在 BIOS设置中关闭OC Genie功能。我们建议您去保存OC Genie 配置到 BIOS 的超频简介中为将来所用。
- OC Genie 的使用您个人承担风险。MSI 对于超频将不提供任何保障。

Base Clock Control Buttons (基频控制按钮)

此加减按钮用来增加和减少基础时钟频率。当系统在正常使用状态下，按加/减按钮一次将增加/减少 0.5MHz 基础时钟频率。



加按钮



减按钮

开关

此主板提供如下的开关用于您设定计算机功能。此节将介绍如何通过使用开关改变您的主板功能。

Over-Voltage Switch (超电压开关)

通过改变此开关，我们可以在 BIOS 中调整 CPU/ QPI/ DDR/ IOH 的电压值来达到高峰值。在 BIOS 设置中对 CPU/ QPI/ DDR/ IOH 超电压。



依照下列说明来调整 CPU/ QPI/ DDR/ IOH 电压值。



开关1：用于升高CPU电压，切换至“ON”开关后可在BIOS里增加CPU的电压范围值。



开关2：用于升高QPI电压，切换至“ON”开关后可在BIOS里增加QPI的电压范围值。



开关3：用于升高DDR电压，切换至“ON”开关后可在BIOS里增加DDR的电压范围值。



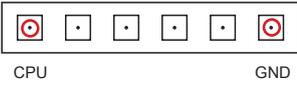
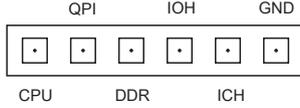
开关4：用于升高IOH电压，切换至“ON”开关后可在BIOS里增加IOH的电压范围值。

注意

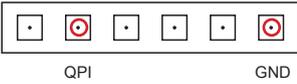
- 当您在使用 OC Genie 来检测您的系统配置时，请不要开启任何 V-switch 部分功能。否则此做法将为设备提供过多电压。并且可能导致一些设备的损坏。
- 当在 BIOS 里设置 CPU/ QPI/ DDR/ IOH 电压后，你可以用万用表测量电压检测点来核实刚刚设置的电压值，请参考如下步骤来测量这些电压。

电压检测点: V-Check Point

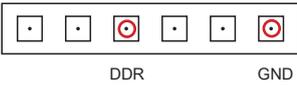
该电压检查点用于测量当前的 CPU/ QPI/ DDR/ IOH/ ICH 电压值。



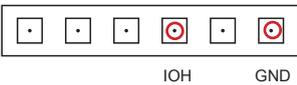
CPU电压:将万用表连接CPU点和GND点来测量当前CPU电压。



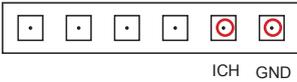
QPI电压:将万用表连接QPI点和GND点来测量当前QPI电压。



DDR电压:将万用表连接DDR点和GND点来测量当前DDR电压。



IOH电压:将万用表连接IOH点和GND点来测量当前IOH电压。

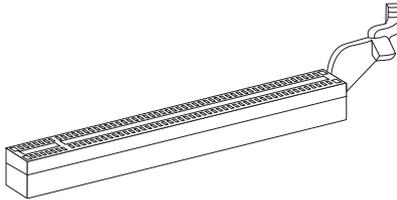


ICH电压:将万用表连接ICH点和GND点来测量当前ICH电压。

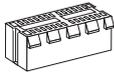
插槽

PCIe (周边设备连接) 插槽

此 PCI Express 插槽支持 PCI Express 界面扩展卡。



PCI Express x16 插槽



PCI Express x1 插槽

注意

在增加或移除扩展卡时，确认首先已拔除电源。同时查看关于扩展卡的文档为扩展卡配置必要的硬件或软件，比如跳线，开关或 BIOS 配置。

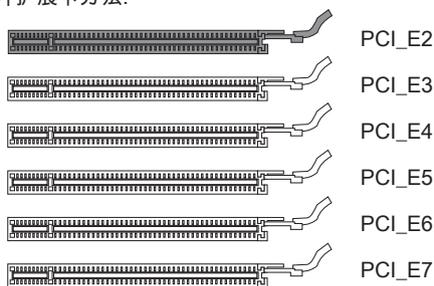
PCIe x16 插槽入口规则

PCIe x16 入口规则请参考下列说明。下列图表详细说明了安装或未安装扩展卡的排列配置 (PCIe x16)。

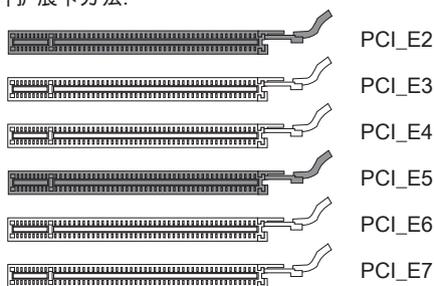
	1 扩展卡	2 扩展卡	3 扩展卡		4 扩展卡	5 扩展卡	6 扩展卡
PCI_E2 Lane	x16 @	x16 @	x16 @	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E3 Lane	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @	x4 @
PCI_E4 Lane	x0	x0	x0	x8 @	x8 @	x4 @	x4 @
PCI_E5 Lane	x16	x16 @	x8 @	x8	x8 @	x8 @	x8 @
PCI_E6 Lane	x0	x0	x8 @	x8 @	x8 @	x8 @	x4 @
PCI_E7 Lane	x0	x0	x0	x0	x0	x0	x4 @

@ : 安装扩展卡插槽

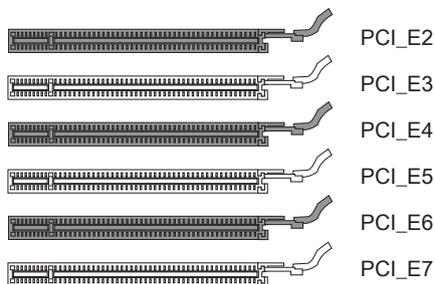
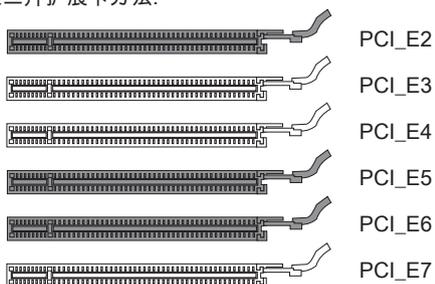
■ 安装一片扩展卡方法:



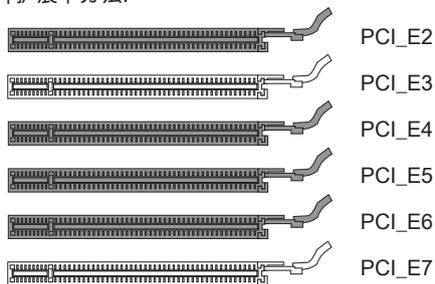
■ 安装两片扩展卡方法:



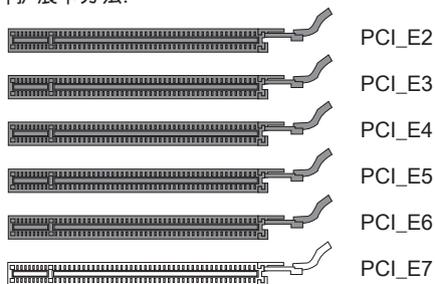
■ 安装三片扩展卡方法:



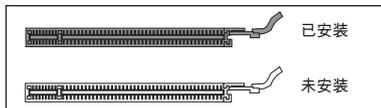
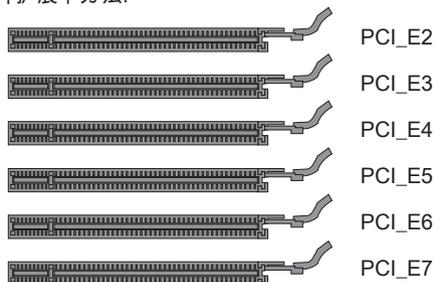
■ 安装四片扩展卡方法:



■ 安装五片扩展卡方法:



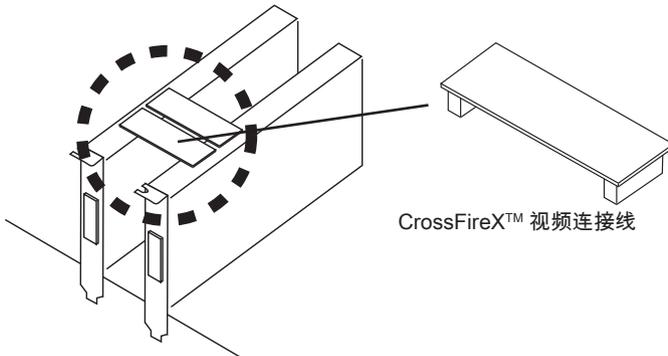
■ 安装六片扩展卡方法:



ATI CrossFireX™ (多GPU) 技术

ATI CrossFireX™ 是一款终极多GPU性能游戏平台。打开游戏控制开关，ATI CrossFireX™ 技术通过使两颗或更多分离的图形处理器共同工作来提高系统性能。ATI CrossFireX™ 技术允许您扩展系统的图形处理能力。它允许您根据实际需要设定系统图形处理能力。它支持两块或更多的ATI Radeon™ 高清显卡，从而成为最顶级游戏平台。主板可以通过软件自动侦测CrossFireX™的模式，所以您不必手动在BIOS中启用CrossFireX™技术。以下为两路CrossFireX™安装步骤详解。

1. 在 PCI_E2 和 PCI_E5 插槽中安装两块 ATI Radeon™ 高清显卡。
2. 当两块显卡已经安装好后，这两块显卡顶部的金手指需要用CrossFireX™视频连接线连接起来（如下图所示）。请注意，虽然您安装了两块或更多显卡，但只有安装在第一个PCI E x16插槽上的显卡的视频输出工作。因此，您只需要连接显示器到这块显卡上即可。



注意

- 如果您想要安装两块显卡启用CrossFireX™模式，请确认：a. 这两块显卡品牌规格相同；b. 这两块显卡都安装在支持PCI E x16速度的PCI E x16 (PCI_E2 & PCI_E5) 插槽上。
- 为确保显卡稳定工作，请确认您在JPWR4(或在显卡上的电源接口)接口上提供一个充足的电源。
- 只有Windows® XP with Service Pack 2 (SP2)和Windows® XP Professional x64 Edition，Windows® Vista 和 Windows® 7操作系统支持CrossFireX™功能。

3. 当所有的硬件和软件都已经被正确地装配和安装后，重新启动系统。进入操作系统后，点击桌面上的“Catalyst™ Control Center”图标。要使CrossFireX™工作需要启用Catalyst™ Control Center中一个设置项。Catalyst™ Control Center显示下图：

在view下拉菜单中选择Advanced View。



注意

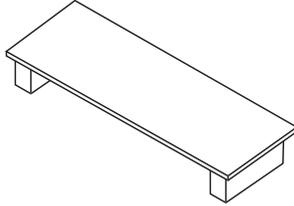
一个CrossFireX™ 系统有四种可能的显示模式：

- SuperTiling (方块分离渲染模式)
- Scissor Mode (分割帧渲染模式)
- Alternate Frame Rendering (交替帧渲染模式)
- Super Anti-aliasing (超级全屏抗锯齿渲染模式)。

要获得更多详细信息，请咨询厂商显卡手册。

NVIDIA® SLI 技术

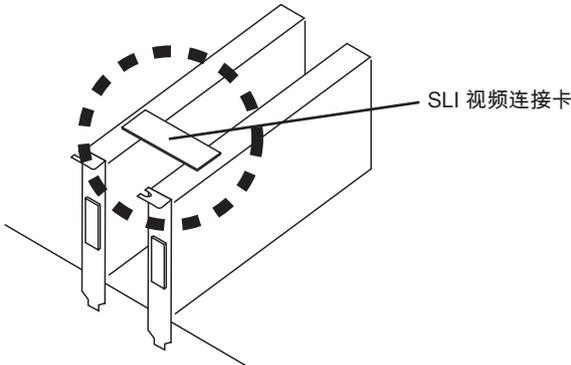
NVIDIA® SLI (可弹性连接介面) 技术, 允许两个GPU在同一个系统中结合运行来实现单独一块显卡的双倍性能。为了使用此项技术,两个GPU卡必须连接在同一个SLI 视频率连接卡上。



SLI 视频连接卡

如果您打算更好的使用SLI模式图形处理性能, 请按照下面步骤完成设置。

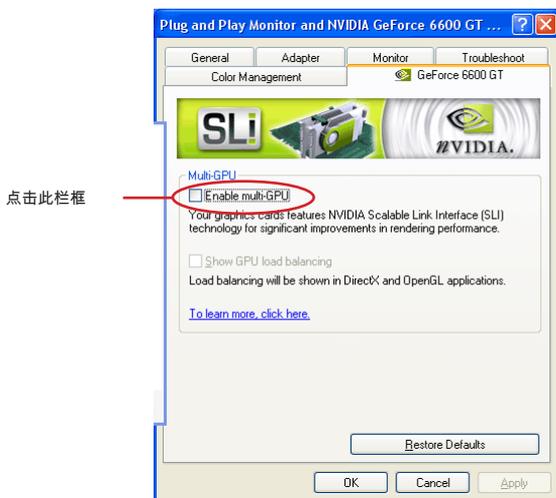
1. 安装两块显卡在 PCI_E2 和 PCI_E5 插槽上。其中一块SLI视频连接卡必须连接在上部的金手指部位(参考下面的图片)。注意, 虽然您已经安装了两块显卡, 但仅有第一块显卡上的视频输出在工作。因此, 你只需要连接一个显示器到第一个PCI Express 卡上面。



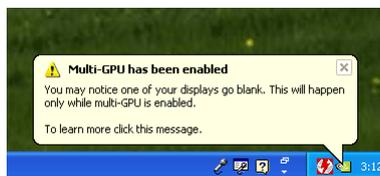
注意

- 该主板在此显示的图片仅供演示。主板的显示根据您所购买主板型号不同而变化。
- 如果您想安装两块 x16 显示卡, 请确认这两块显卡为同一个型号和同一品牌。
- 为确保显卡稳定工作, 请确认您在JPWR4(或在显卡上的电源接口)接口上提供一个充足的电源。

2. 当您把所有的硬件都正确的安装好后，重新启动系统并安装 NV SLI 驱动/工具。一个配置面板 将提供多个GPU 控制界面。点击 Enable multi-GPU 栏框来启用板载显卡上 SLI 功能 (更多有关多GPU设置细节，请参阅您的显卡手册)。



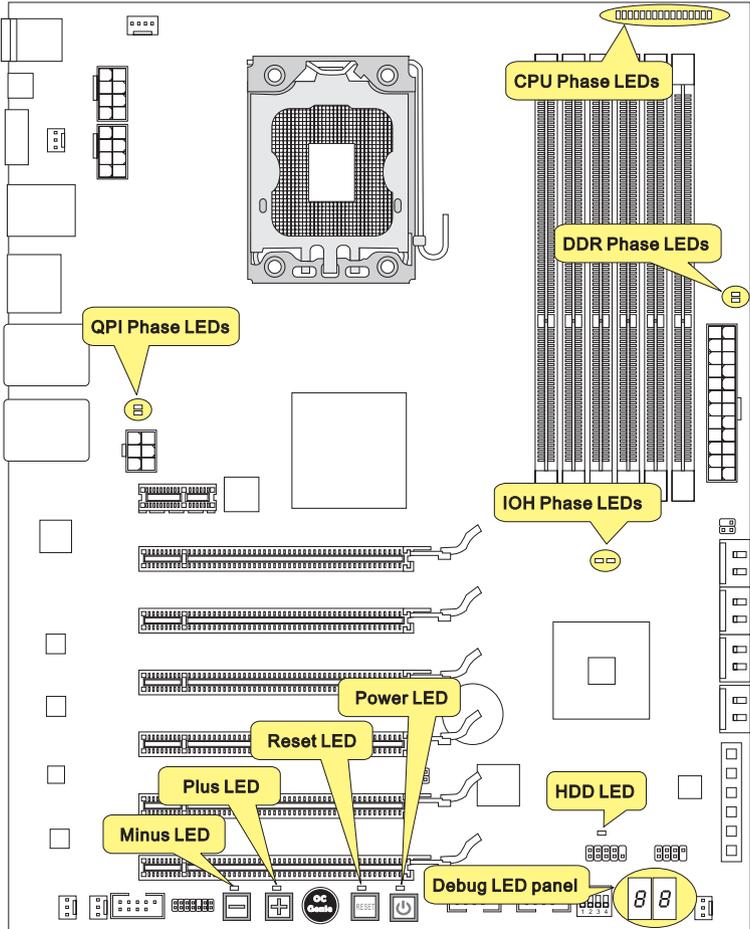
3. 重新启动系统，在系统任务栏上将弹出一条显示多个GPU已启用的信息。



注意

如果您想移除一块显示卡并且退出SLI功能，请确保“MultiGPU”功能选项为关闭状态。

LED 状态说明 (选配)



CPU Phase LEDs (CPU 相位指示灯)

这些指示灯指明当前CPU电源相位模式。根据下表解读CPU电源相位模式。

■ 亮 □ 灭

■□□□□□□□□□□□□□□	CPU在 1 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 2 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 3 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 4 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 5 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 6 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 7 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 8 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 9 相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 10相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 11相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 12相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 13相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 14相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 15相位电源模式下。
■□□□□□□□□□□□□□	CPU在 16相位电源模式下。

QPI Phase LEDs (QPI 相位指示灯)

这些指示灯指明当前QPI电源相位模式。根据下表解读QPI电源相位模式。

■ 亮 □ 灭

□	QPI 在 1 相电源模式。	■	QPI 在 2 相电源模式。
■		■	

IOH Phase LEDs (IOH 相位指示灯)

这些指示灯指明当前IOH电源相位模式。根据下表解读IOH电源相位模式。

■ 亮 □ 灭

■ □	IOH 在 1 相电源模式。	■ ■	IOH 在 2 相电源模式。
-----	----------------	-----	----------------

DDR Phase LEDs (DDR 相位指示灯)

这些指示灯指明当前DDR电源相位模式。根据下表解读DDR电源相位模式。

■ 亮 □ 灭

□	DDR 在 1 相电源模式。	■	DDR 在 2 相电源模式。
■		■	

HDD LED (硬盘指示灯)

当硬盘运行时，硬盘指示灯亮。

Power LED (电源指示灯)

当您每次按下电源按钮，且按钮有发挥作用时。指示灯将闪烁一次。

Reset LED (重启指示灯)

当您每次按下重启按钮，且按钮有发挥作用时。指示灯将闪烁一次。

Minus LED (减指示灯)

当您每次按下减按钮，且按钮有发挥作用时。指示灯将闪烁一次。

Plus LED (加指示灯)

当您每次按下加按钮，且按钮有发挥作用时。指示灯将闪烁一次。

Debug LED Panel (调试指示灯面板)

请参照下表格获得更多关于调试指示灯的信息。

灯号显示	状态
FF	加电并初始化 CPU。
C0, C1, C2	早期初始化 CPU。
C4, C6	初始化芯片组。
D4, D5	初始化内存。
08	初始化键盘。
2A, 31	初始化板载设备，加载 BIOS 中的 Option ROM (VGA 和 RAID option ROM) 到内存。
37	显示 sign-on 信息，CPU 信息，setup 热键信息和 OEM 厂商特定信息。
38	初始化 USB 设备和其它设备。
3C	POST中期阶段的芯片组初始化，探测其它设备(并口，串口和其它协处理器等..)
75, 78	初始化 INT 13 设备和 IPL 设备。(包括 SATA/ PATA HDD 和 CD/DVD 光驱)。
87	BIOS如有需要进入 setup 画面。
A4	等待用户输入所需要的配置显示。
A7	显示系统配置界面。
B1	保存系统上下文到 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)中，准备将控制权交给OS加载器 (INT 19H)。
00	将控制权交给OS加载器 (typically INT 19H)。
AA	进入操作系统。

BIOS 设置

此章节提供BIOS设置程序基本信息，允许您为最佳应用配置系统。您可能在以下情形要运行设置程序：

- 系统启动时屏幕上显示错误信息，要求您运行 BIOS SETUP。
- 您希望改变缺省设定到定制特性。

注意

- BIOS中的每一项都是在不断更新，以提高系统性能。所以此章节中描述的BIOS跟最新的BIOS有些细微的差异，仅供参考使用。
- 在启动时，BIOS版本出现在内存数目后面的第一行。它的常见格式为：

A7666IMS V1.0 042210 此处：

第1位说明了BIOS的制造者 A = AMI，W = AWARD，P = PHOENIX。

第2-5位代表产品编号。

第6位代表了芯片组 I = Intel，N = NVIDIA，A = AMD 和 V = VIA。

第7-8位代表客户，MS=所有普通用户。

V1.0 表示 BIOS 版本。

042210 表示 BIOS 的更新日期。

BIOS 设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按 键即可进入设定程序。

Press DEL to enter SETUP (按 DEL 键进入设定)

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

获得帮助

进入setup程序之后，第一个屏幕就是主菜单。

主菜单

主菜单显示了BIOS所提供的设定项目类别。您可用方向键(↑↓)选择不同的条目。对选定项目的提示信息显示在屏幕的底部。

子菜单

如果您看到向右的指示箭头符号(如右图所示)出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位(↑↓)以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单。然后您可使用控制键位来进入选值，并在子菜单中进行选择。如果您要返回到主菜单，请按<Esc>键位。

主题帮助 <F1>

BIOS设置菜单提供您主题帮助的屏幕。您可在任一菜单中按<F1>以唤出此幕。此帮助屏幕列出了高亮显示项目的使用控制键位和相关选项。按<Esc>以退出帮助屏幕。

主菜单

一旦您进入 BIOS CMOS设置工具，屏幕上将显示主菜单。主菜单允许您从功能设置项和两个退出选择项做出选择。使用方向键选定项并按<Enter>接受或进入子菜单。



▶ **Standard CMOS Features (标准CMOS特性)**

使用此菜单可对基本的系统配置进行设定。如时间，日期等。

▶ **Advanced BIOS Features (高级BIOS特性)**

使用此菜单可以进行设置特别增强的特性。

▶ **Integrated Peripherals (整合周边)**

使用此菜单可对周边设备进行特别的设定。

▶ **Power Management Setup (电源管理设置)**

使用此菜单可以对系统电源管理进行特别的设定。

▶ **H/W Monitor (硬件监视)**

此菜单用来显示计算机的健康状态。

▶ **Green Power**

此菜单用来设定电源相位。

▶ **BIOS Setting Password (BIOS密码设置)**

使用此项可设置 BIOS 的密码。

▶ **Cell Menu (核心菜单)**

使用此菜单可以对频率/电压控制进行设定。

▶ **M-Flash**

使用此菜单可以从存储装置读取或刷新 BIOS (仅支持 FAT/FAT32 装置)。

▶ **Overclocking Profile (超频简介)**

用此菜单到/从BIOS里的CMOS中保存/ 加载您的设定。

▶ **Load Fail-Safe Defaults (载入故障保护缺省值)**

使用此菜单可以载入BIOS厂商为稳定系统性能而设定的缺省值。

▶ **Load Optimized Defaults (载入优化设置缺省值)**

使用此菜单可以为稳定系统操作性能载入系统优化性能设置的BIOS值。

▶ **Save & Exit Setup (保存后退出)**

保存对CMOS的修改，然后退出Setup程序。

▶ **Exit Without Saving (不保存退出)**

放弃对CMOS的修改，然后退出Setup程序。

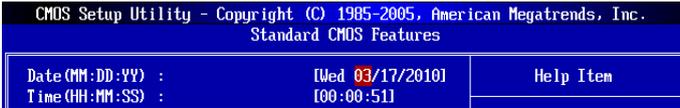
当进入BIOS设置工具，下列步骤用于一般应用。

1. Load Optimized Defaults : 使用控制键 (↑↓) 高亮 Load Optimized Defaults 区域并按 <Enter>键，显示下面的信息:

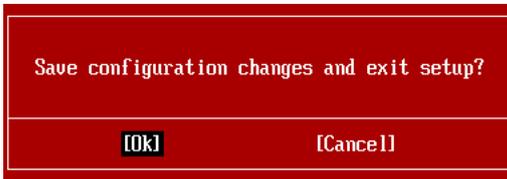


选择[Ok]并按Enter键为优化系统性能载入缺省设置。

2. Setup Date/ Time : 选择 Standard CMOS Features 并按<Enter>进入 Standard CMOS Features 菜单。调整日期，时间选项。



3. Save & Exit Setup : 使用控制键 (↑↓) 高亮 Save & Exit Setup 区域并按 <Enter>键，显示下面的信息:

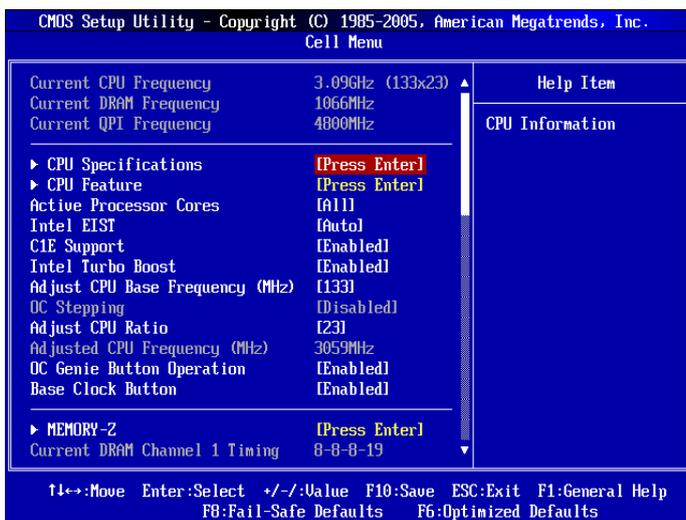


选择[Ok]并按Enter键保存配置并退出BIOS设置工具。

注意

以上配置仅用于一般应用。如果您需要BIOS设置详细设定，请查阅MSI网站英文版说明书。

4. Cell Menu 介绍：此菜单用于希望超频主板的高级用户。



注意

仅当您熟悉芯片组时，才可以更改这些设定值。

▶ Current CPU / DRAM / QPI Frequency (当前 CPU / DRAM / QPI 频率)

此项用来显示当前 CPU，内存和 QPI 频率。只读。

▶ CPU Specifications (CPU 属性)

按<Enter>键进入子菜单。此子菜单显示已安装CPU的信息。

▶ CPU Technology Support (CPU 技术支持)

按<Enter>键进入子菜单。此子菜单显示已安装CPU所支持的技术。只读。

▶ CPU Feature (CPU 特性)

按<Enter>键进入子菜单：

▶ Intel EIST (增强型英特尔 SpeedStep 动态节能技术)

此增强型英特尔SpeedStep动态节能技术允许您设置微处理器的性能水平，无论计算机是工作在电池下或是AC电源下。此项将在您安装了增强型英特尔SpeedStep 动态节能技术的CPU后出现。

▶ Intel C-State (英特尔深度节能技术)

C-state是一种电源管理状态。当CPU空闲时，它有效地减少处理器供电。此项将在您安装了支持C-state技术的CPU后出现。

▶ **C State Package Limit Setting (C State 组限制设置)**

此项允许您选择C-state水平。我们推荐您设置此项为Auto (自动)。

▶ **C1E Support (增强停机状态支持)**

启用此项可在空闲时读取CPU的能耗。不是所有的处理器都支持增强停机状态 (C1E)。

▶ **OverSpeed Protection (超速保护)**

超速保护 (Overspeed Protection) 功能可以监视当前的CPU频率和它的能耗。如果它超过一定水平，处理器自动降低它的时钟频率。如果您想对您的CPU超频，请设置此项为[Disabled]。

▶ **Hyper-Threading Function (超线程功能)**

处理器使用超线程 (Hyper-Threading) 技术增加CPU处理事务吞吐率和减少终端用户响应时间。此项技术把处理器的两个内核当做两个逻辑处理器，使它们可以同时执行指令。用这种方法，系统性能得到了极大的提高。如果您关闭此项功能，处理器只会使用一个内核来执行指令。如果您的操作系统不支持超线程 (HT) 技术，请关闭此项功能，否则您的系统可能不稳定不可靠。

注意

要为您的计算机启用超线程功能，您的计算机需要具备以下所有组件：

- CPU：支持超线程 (HT) 技术的 Intel® 处理器；
- 芯片组：支持超线程 (HT) 技术的 Intel® 芯片组；
- BIOS：支持超线程 (HT) 技术的 BIOS 并启用此功能；
- 操作系统：支持超线程 (HT) 技术的操作系统。

要获得更多超线程技术的信息，请访问：

http://www.intel.com/products/ht/hyperthreading_more.htm

▶ **Execute Bit Support (执行位支持)**

英特尔的执行关闭位 (Execute Disable Bit) 功能结合支持此功能的操作系统可以阻止某些类的恶意的“缓冲区溢出”攻击。此功能允许处理器把内存空间按‘哪里代码可以执行’和‘哪里代码不可以执行’做分类。当一个恶意的蠕虫病毒试图在缓冲区中插入代码时，处理器关闭代码执行，阻止破坏和蠕虫繁殖。

▶ **Set Limit CPUID MaxVal to 3 (设置 CPUID 最大限值为3)**

CPUID最大值限制是用来为旧操作系统限制处理器频率的。

▶ **Intel Virtualization Tech (英特尔虚拟技术)**

此项用来启用/禁用英特尔虚拟技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▶ **Intel VT-d (英特尔输入/输出虚拟技术)**

此项用来启用/禁用英特尔输入/输出虚拟技术(VT-d)。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▶ **Active Processor (活跃的处理器的)**

此项用来选择活跃处理器内核数目。

▶ **Intel EIST (增强型英特尔 SpeedStep® 动态节能技术)**

此增强型英特尔 SpeedStep® 动态节能技术允许您设置微处理器的性能水平, 无论计算机是工作在电池下或是AC电源下。此项将在您安装了增强型英特尔 SpeedStep® 动态节能技术的CPU后出现。

▶ **C1E Support (增强停机状态支持)**

启用此项可以在空闲时读取CPU电源能耗。不是所有的处理器都支持增强停机状态 (C1E)。

▶ **Intel Turbo Boost (英特尔智能加速技术)**

当您安装的CPU支持英特尔智能加速 (Turbo Boost) 技术时, 此项会出现。此项用来启用/禁用英特尔智能加速 (Turbo Boost) 技术。当应用程序要求更高的CPU性能并且热设计功耗 (TDP) 净值空间还存在时它可以动态地把处理器频率按比例调高。它也提供了无缝的供电伸缩性控制 (此技术动态上调, 智能降频技术下调)。这是 i5/ i7 CPU 中英特尔新技术。

▶ **Adjust CPU Base Frequency (MHz) (调整 CPU 基础频率, 单位MHz)**

此项用来调整CPU基础频率, 单位MHz。您可以通过调整此项值对CPU进行超频。请注意超频行为不受保护。

▶ **OC Stepping (超频步骤)**

您在“Adjust CPU Base Frequency (MHz)” 选项中设置超频频率后, 此项将会被启用。以下相关选项将会出现。此项将会帮助系统在启动后一步一步超频。

▶ **Start OC Stepping From (MHz) (初始 CPU 基础频率, 单位MHz)**

此项用于设置CPU初始基础频率。系统将会以此初始基础频率启动。然后从此频率开始一步一步超频至您在“Adjust CPU Base Frequency (MHz)” 选项中设置的频率。

▶ **OC Step (超频步数)**

此项用于设置超频步骤数目。

▶ **OC Step Count Timer (超频步骤缓冲时间)**

此项用于设置超频时每步缓冲时间。

▶ **Adjust CPU Ratio (调整 CPU 倍频)**

此项允许您调整CPU倍频。设置此项为[Startup]使CPU工作在系统侦测到的最快频率下。

▶ **Adjusted CPU Frequency (MHz) (调整后的 CPU 频率, 单位MHz)**

此项显示调整后的CPU频率(基础频率 x 倍频)。只读。

▶ **OC Genie Button Operation (超频精灵按钮操作)**

此项用来启用/禁用超频精灵按钮功能。当关闭此项时, 超频精灵功能不可用。

► **Base Clock Button (基频按钮)**

此项用来打开/ 关闭基频按钮功能。

► **MEMORY-Z (内存检测)**

按<Enter>键进入子菜单。

► **DIMM1~6 Memory SPD Information (DIMM 1~6 内存 SPD 信息)**

按<Enter>键进入子菜单。此子菜单显示已安装内存的信息。

► **Current DRAM Channel1/2/3 Timing (当前内存通道1/2/3时序)**

此项显示已安装内存时序。只读。

► **DRAM Timing Mode (高级内存配置)**

选择内存时序是否由内存模组上的 SPD EEPROM 控制。设置此项为[Auto]，内存时序和接下来的“Advance DRAM Configuration”子菜单中相关项都由BIOS根据SPD中的配置信息自动设置。设置此项为[Manual]，您可以手动配置内存时序和接下来的“Advance DRAM Configuration”子菜单中相关各项。

► **Advance DRAM Configuration (高级内存配置)**

按<Enter>键进入子菜单。

► **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 1T/2T Memory Timing (CH1/ CH2/ CH3 或 CH1-3 1T/2T 内存时序)**

此项控制SDRAM命令速率。选择[1]，SDRAM信号控制器运行在1N (N=时钟周期) 速率下。选择[2]，SDRAM信号控制器运行在2N速率下。

► **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 CAS Latency (CL) (CH1/ CH2/ CH3 或 CH1-3 潜伏时间)**

此项控制列地址选通 (CAS) 延迟。即SDRAM接到读命令后，开始进行读取前的延迟时间 (以时钟周期为单位)。

► **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRCD**

在DRAM刷新时，行地址寻址和列地址寻址是分开的。此项用来设定从行地址选通 (RAS)到列地址选通(CAS)之间的过渡时序。时钟周期数越少，DRAM的性能越好。

► **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRP**

此项控制行地址选通(RAS)时允许的预充电的周期数。若无足够时间，让行地址选通在DRAM刷新之前累积足够电荷，刷新可能会不完全，而且DRAM可能不能保持数据。此项仅适用于系统安装同步DRAM时。

► **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRAS**

此项设置行地址选通(RAS)从内存读和写内存所需时间。

► **CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRFC**

此项设置RFC需要的读内存单元和写内存单元的时间。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tWR

此项设置写数据突发结束到预充电命令开始的最小时间间隔。允许读出放大器恢复数据到内存单元。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tWTR

此项设置写数据突发结束到读某列命令开始的最小时间间隔。它允许输入输出 (I/O) 选择门在读命令开始前超速驱动读出放大器。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRRD

此项设置不同模块间活跃到活跃 (active-to-active) 的延迟。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tRTP

此项设置读命令和预充电命令间的时间间隔。

▶ CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tFAW

此项设置tFAW时序

▶ Current CH1/ CH2/ CH3 or CH1-3 tdrRdTRd/ tddRdTRd/ tsrRdTWrr/ tdrRdTWrr/
tddRdTWrr/ tsrWrTRd/ tdrWrTRd/ tddWrTRd/ tdrWrTWrr/ tddWrTWrr/ tsrRdTRd/
tsrWrTWrr

这些项目显示高级DRAM时序。

▶ Channel 1/ Channel 2/ Channel 3 or Channel 1-3 Advance Timing (通道 1/通道 2
或通道 1-3 高级内存设置)

设置此项为[Auto]，高级内存时序由BIOS自动设置。设置此项为[Manual]，您可以手动设置高级内存时序。

▶ Extreme Memory Profile (X.M.P.) (X.M.P 技术)

此项用来启用/禁用英特尔极端内存剖面(XMP)技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▶ Memory Ratio (内存倍频)

此项设置内存倍频。

▶ Adjusted DRAM Frequency (MHz) (调整后的内存频率，单位MHz)

此项显示调整后的内存频率。只读。

▶ Uncore Ratio (设置 uncore 倍频)

此项允许设置 uncore 的倍频。

▶ Adjusted Uncore Frequency (MHz) (调整后的 uncore 频率)

此项显示调整后的 uncore 频率。只读。

▶ QPI Links Speed (QPI 连接速度)

此项用来选择 QPI 连接速度模式。

▶ QPI Frequency (QPI 频率)

此项可以设置 QPI 频率。

▶ Adjusted QPI Frequency (MHz) (调整后的 QPI 频率)

此项显示调整后的 QPI 频率。只读。

▶ ClockGen Tuner (时钟发生器调整)

按<Enter>进入子菜单。

▶ CPU Amplitude Control/ PCI Express Amplitude Control (CPU/ PCI Express 时钟振幅)

此项用来设定 CPU/ PCI Express 时钟振幅。

▶ CPU CLK Skew/ MCH CLK Skew (CPU/ MCH 时钟偏移)

此项用来设置CPU/ MCH芯片组时钟偏移。它可以帮助CPU达到更高的超频性能。

▶ Adjust PCI-E Frequency (MHz) (调整 PCI-E 频率, 单位MHz)

此项用来选择PCI-E频率, 单位MHz。

▶ VDrop Control (电压下降控制)

此项用来阻止系统在负担重时大量电压下降。

▶ CPU Voltage (V)/ CPU PLL Voltage (V)/ QPI Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ DDR_VREF_CA_A (V)/ DDR_VREF_CA_B (V)/ DDR_VREF_CA_C (V)/ DDR_VREF_DQ_A (V)/ DDR_VREF_DQ_B (V)/ DDR_VREF_DQ_C (V)/ IOH Voltage (V)/ IOH PCIE Voltage (V)/ ICH Voltage (V)

这些项用来调整CPU, 内存和芯片的电压。

▶ Spread Spectrum (频展)

当主板上的时钟发生器工作时, 脉冲的极值 (尖峰) 会产生电磁干扰 (EMI)。频展功能可以调制脉冲, 使脉冲波的尖峰衰减为较为平滑的曲线, 降低时钟发生器所产生的电磁干扰。

注意

- 如果您没有任何电磁干扰 (EMI) 方面的问题, 要使系统获得最佳的稳定性和性能, 请设置此项为[Disabled]。但是, 如果您被电磁干扰 (EMI) 问题所困扰的话, 请选择频展 (Spread Spectrum) 的值, 以减少电磁干扰 (EMI)。
- 频展 (Spread Spectrum) 的值越高, 电磁干扰 (EMI) 会越小, 系统的稳定性也相应的降低。要为频展 (Spread Spectrum) 设定一个最合适的值, 请参考EMI规章。
- 当您超频时, 请关闭频展 (Spread Spectrum) 功能, 因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂突发, 这样会导致您超频的处理器锁死。

注意

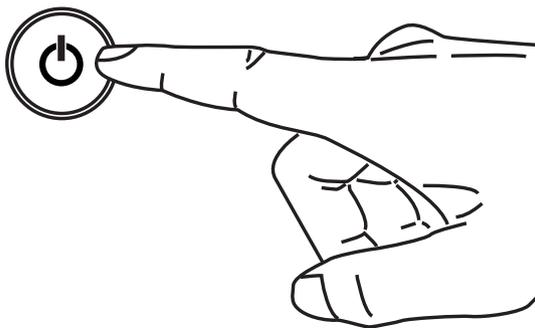
超频失败后的解决方案

此主板支持高超频性能。然而，请确保您的外围设备和组件能承受一些特殊的设置。任何超过产品规格外的动作不推荐。任何因操作不当造成的危险和损坏将不在我们的产品保修之内。

超频失败后，两种方法保存您的系统....

- 重启

按下电源开关重启系统三次。请注意，为了避免电流对其它设别和部件的影响。我们建议重启动作间隔超过10秒。



在第四次重启之后，BIOS 将判断以前的超频是失败的并自动恢复默认值设置。当下列信息显示在屏幕上时，请按任意键正常启动您的系统。

Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....

- 清除 CMOS

请参考本手册中关于如何清除 BIOS 的信息。

软件信息

从主板包装中取出驱动/工具光盘，放到光驱中。将自动运行安装，单击屏幕驱动或工具完成安装。此驱动/工具光盘内容包括：

- Driver menu：驱动菜单显示可用的驱动。安装您需要的驱动使设备可用。
- Utility menu：工具菜单显示主板支持的软件应用程序。

注意

请访问 [MSI 官方网站](#) 以获得最新驱动和 BIOS 以得到最佳系统性能。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板	○	○	○	○	○	○
结构件	○	○	○	○	○	○
芯 片	×	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

附记：请参照

- 含铅的电子组件。
- 钢合金中铅的含量达 0.35%，铝合金中含量达 0.4%，铜合金中的含量达 4%。
- -铅使用于高熔点之焊料时(即铅合金之铅含量大于或等于 85%)
-铅使用于电子陶瓷零件。
- 含铅之焊料，用于连接接脚(pins)与微处理器(microprocessors)封装，此焊料由两个以上元素所组成且含量介于 80~85%。
- 含铅之焊料使用于集成电路覆晶封装(Flip Chippackages)内部；介于半导体芯片和载体间，来完成电力连结。